

Geschäftsbericht 2006



Vorwort

- 02 Vorwort des Vorstands
- 04 Bericht des Aufsichtsrats

06 Highlights 2006

Investor Relations

- 10 Die SÜSS MicroTec-Aktie
- 12 Corporate Governance Bericht

Über uns

- 18 SÜSS MicroTec-Produkte
- 20 Einfach SÜSS
- 24 Trends und Perspektiven

Lagebericht

- 28 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
- 29 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
- 30 Forschung und Entwicklung
- 32 Überblick über den Geschäftsverlauf
- 37 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- 42 Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB
- 43 Vergütungsbericht
- 43 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
- 44 Umwelt
- 44 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- 44 Risikobericht
- 46 Prognosebericht
- 51 Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns
- 51 Vorausschauende Aussagen

Konzernabschluss

- 52 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
- 53 Konzernbilanz
- 54 Konzern-Kapitalflussrechnung
- 56 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
- 58 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2006
- 60 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2005
- 62 Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern
- 62 Segmentinformationen nach Regionen
- 64 Anhang
- 103 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Service

- 104 Glossar
- Finanzkalender
- Impressum/Kontakt

Visionen und Werte

SÜSS MicroTec – Zukunft gestalten

Fast jeder Mensch kommt mindestens einmal täglich mit einem Produkt in Kontakt, das mit Know-how von SÜSS MicroTec hergestellt wurde. Wir sind einer der führenden Spezialausrüster für die Chip- und Mikrosystemtechnikindustrie. Ob Automobil, Computer und Zubehör, Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Medizintechnik oder komplexe Netzwerke – Halbleiter und Mikrosysteme (MEMS) sind das Herzstück all dieser Geräte und Anwendungen. Sie machen den Alltag der Menschen kommunikativer, komfortabler und sicherer.

Wir tragen dazu bei, dass unsere inzwischen vollelektronische Welt funktioniert. Equipment von SÜSS MicroTec ermöglicht es, mehr und leistungsfähigere Chips zu niedrigeren Kosten herzustellen. Wir haben in unseren Märkten einen erstklassigen Ruf und vertrauensvolle, expandierende Kundenbeziehungen. Kerntechnologien von SÜSS, etwa Advanced Packaging und Wafer Bonding, haben große Wachstumspotenziale. Kooperationen mit bedeutenden Partnern wie IBM eröffnen uns zusätzliche Absatz- und Entwicklungschancen.

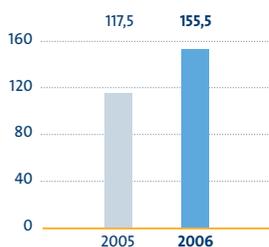
Den künftigen Unternehmenserfolg sichern wir mit innovativen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Unser traditionell hoher Verkaufsanteil an Wissenschaftseinrichtungen und Universitäten sichert uns ein „Ohr am Markt“ und macht SÜSS zum aktiven Mitgestalter von Markttrends, die wir dann in Umsatz und Marktanteile ummünzen.

An der Zukunft wird schon heute gebaut – mit Technologie von SÜSS MicroTec.

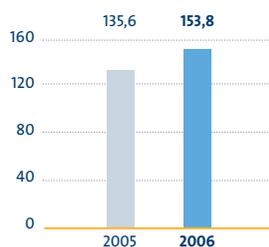
SÜSS MicroTec auf einen Blick

in Mio. Euro	2006	2005	Veränderung
Umsatz und Auftragslage			
Auftragseingang	153,8	135,6	13,5 %
Auftragsbestand zum 31.12.	78,5	85,1	-7,7 %
Umsatz gesamt	155,5	117,5	32,3 %
<i>Umsatz Europa</i>	43,2	41,6	3,9 %
<i>Umsatz Nordamerika</i>	47,7	42,1	13,2 %
<i>Umsatz Japan</i>	17,1	7,7	>100 %
<i>Umsatz sonstiges Asien</i>	47,2	26,1	80,6 %
<i>Umsatz Rest of the World</i>	0,3	0,0	n/a
Umsatzrendite	9,6 %	-7,0 %	-
Rohertrag	69,6	47,0	48,3 %
Rohertragsmarge	44,8 %	40,0 %	-
Herstellungskosten	85,8	70,6	21,7 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	9,5	9,0	5,6 %
EBITDA	22,2	5,8	>100 %
EBITDA-Marge	14,3 %	4,9 %	-
EBIT	16,0	-4,2	>100 %
EBIT-Marge	10,3 %	-3,6 %	-
Ergebnis nach Steuern	14,9	-8,2	>100 %
Ergebnis je Aktie	0,88	-0,52	>100 %
Bilanz			
Eigenkapital	99,2	84,2	17,8 %
Eigenkapitalquote	63,0 %	53,5 %	-
Eigenkapitalrentabilität	15,0 %	-9,8 %	-
Bilanzsumme	157,3	157,3	0,0 %
Net Cash	14,7	7,5	94,6 %
Free Cashflow	7,2	1,9	>100 %
Weitere Kennzahlen			
Investitionen	7,3	6,0	21,4 %
Investitionsquote	4,7 %	5,1 %	-
Abschreibungen und Wertminderungen	6,1	10,0	-38,7 %
Mitarbeiter zum 31.12.	760	674	12,8 %

Konzernumsatz
in Mio. Euro



Auftragseingang
in Mio. Euro

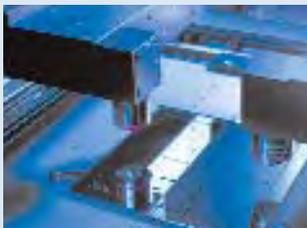


Ergebnis nach Steuern
in Mio. Euro



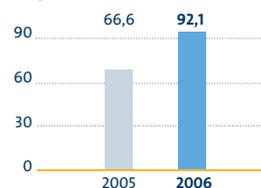
Segmente

Lithografie



Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktionslinien Mask Aligner, Coater und Developer. Dieses Segment stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der SÜSS-Gruppe dar und hat das größte Wachstumspotenzial. Adressierte Märkte: Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter.

Segmentumsatz in Mio. Euro

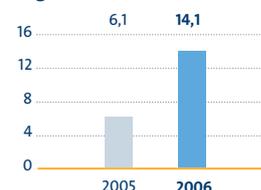


Substrat Bonder



Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Substrat Bondern, die zwei oder mehrere Trägermaterialien (Substrate) – meist Wafer – miteinander verbinden. Derzeit Phase der Marktdurchdringung. Anwendungen des Wafer Bondings werden in Zukunft wachsen. Adressierter Markt: Mikrosystemtechnik.

Segmentumsatz in Mio. Euro

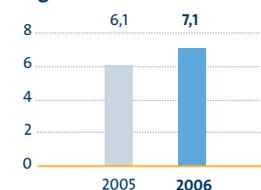


Device Bonder



Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Device Bondern, die einzelne Elektronik-Bausteine hochgenau miteinander verbinden. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Marktgröße schwächstes Segment der SÜSS-Gruppe. Adressierter Markt: Optoelektronik.

Segmentumsatz in Mio. Euro

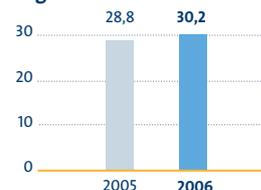


Test Systeme

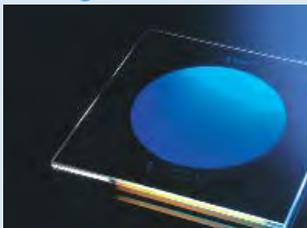


Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Test- und Prüfsystemen. Wenig zyklischer Geschäftsverlauf, moderates, aber nachhaltiges Wachstum. Dieses Segment stellt rund ein Viertel des Geschäftsvolumens der SÜSS-Gruppe dar. Adressierte Märkte: Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter, Forschungsbereiche Chipproduktion.

Segmentumsatz in Mio. Euro

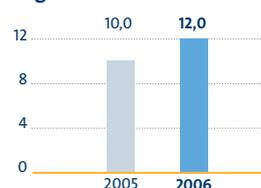


Sonstige



Beinhalten vor allem unser Geschäft mit den Masken für die Halbleiterindustrie in Palo Alto, USA. Daneben sind hier die Aktivitäten in der Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und sonstige Bereiche angesiedelt. Auch das Geschäftsfeld C4NP ist derzeit in diesem Segment berücksichtigt, bis C4NP eine gewisse Umsatzgröße erreicht.

Segmentumsatz in Mio. Euro





V.l.n.r.
Dr. Stefan Schneidewind, Vorstandsvorsitzender
Stephan Schulak, Finanzvorstand

Vorwort des Vorstands

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

das Geschäftsjahr 2006 verlief für unser Unternehmen sehr positiv – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die wichtigste Nachricht lautet: SÜSS MicroTec ist 2006 zum ersten Mal seit fünf Jahren sowohl auf EBIT- als auch auf Nachsteuerergebnis-Basis in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Restrukturierung und strategische Neuausrichtung der vergangenen Jahre haben vollends den gewünschten Erfolg gebracht und werden SÜSS MicroTec auch langfristig eine wertsteigernde Entwicklung ermöglichen. Unsere neue Kostenstruktur und das Break-Even-Modell haben ihre Funktionsfähigkeit bewiesen. Auch andere Finanzkennzahlen haben sich 2006 positiv entwickelt. Zuversichtlich stimmt zudem die Marktentwicklung: Die wichtigsten Absatzbranchen von SÜSS MicroTec weisen eine große Dynamik auf, unsere Produkte bleiben gefragt. Und mit den Fortschritten bei der Zukunftstechnologie C4NP eröffnen sich für unser Unternehmen zusätzliche, attraktive Wachstumschancen. Schließlich hat das Jahr 2006 auch gezeigt, dass der Kapitalmarkt unsere Strategie honoriert; die SÜSS-Aktie entwickelte sich besser als das schon sehr gute Aktienmarktumfeld.

2006 erwirtschafteten wir 155,5 Millionen Euro Umsatz, 32 Prozent mehr als im Vorjahr (117,5 Millionen Euro). Unsere im Jahresverlauf abgegebene Umsatzprognose von mindestens 150 Millionen Euro haben wir zielgenau erfüllt. Der Auftragseingang, der wichtigste Erfolgsindikator in unserer Branche, lag 2006 bei 153,8 Millionen Euro. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr (135,6 Millionen Euro). Besonders erfreulich entwickelte sich die Kundennachfrage in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder; zusätzlich verbesserte sich die Margensituation. Der Auftragsbestand lag am 31. Dezember 2006 bei 78 Millionen Euro (Vorjahreswert: 85 Millionen Euro). „Unsere Pipeline“ für den Umsatz 2007 ist also ebenfalls gut gefüllt.

Beim Ergebnis haben wir einen Meilenstein erreicht. Der im Vorjahr wegen Sondereffekten nochmals verfehlt Break-Even auf Basis des operativen Ergebnisses wurde 2006 erzielt: Das EBIT betrug 16,0 Millionen Euro (Vorjahr: minus 4,2 Millionen Euro). Unsere Prognose einer EBIT-Marge von mindestens zehn Prozent konnten wir damit ebenfalls erfüllen: 2006 beträgt die EBIT-Marge 10,3 Prozent.

In den nächsten Jahren will SÜSS MicroTec beweisen, dass das Unternehmen langfristig profitabel wachsen kann. Als einer der führenden Spezialausrüster für die Chip- und Mikrosystemtechnikindustrie profitieren wir vom ungebrochenen Aufwärtstrend in wichtigen Märkten. Chips und Mikrosysteme (MEMS) sind aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken: Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Automobiltechnik, Computer und Zubehör, Medizintechnik – all diese Bereiche funktionieren mit modernen Chips und Mikrosystemen. SÜSS MicroTec erfüllt mit seinem Produkt- und Lösungsportfolio wichtige Kundenanforderungen: Auch dank SÜSS MicroTec-Equipment sind Halbleiter in immer größerer Zahl bei höherer Leistungsfähigkeit, anhaltender Miniaturisierung und zunehmender Umweltfreundlichkeit verfügbar – und das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Kerntechnologien von SÜSS, etwa Advanced Packaging und Wafer Bonding, haben weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Derzeit läuft die Installation einer ersten C4NP-Anlage zur vollautomatischen Massenproduktion bei IBM in den USA. Sie soll noch 2007 in Produktion gehen. Von diesem Zeitpunkt an hat C4NP das Potenzial, einen bedeutenden Anteil des Wafer-Bumping-Markts zu gewinnen. Potenzielle Kunden haben bereits großes Interesse bekundet.

2007 soll erneut ein gutes Jahr für SÜSS werden: Wir erwarten, dass sich die Umsätze mindestens auf dem hohen Niveau des Jahres 2006 bewegen und die EBIT-Marge abermals mindestens 10 Prozent betragen wird.

Unseren Aktionären, Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir wissen, dass wir dieses Vertrauen in die Zukunft von SÜSS MicroTec jeden Tag aktiv neu gewinnen müssen – durch eine kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswerts, zukunftssichere Arbeitsplätze und, last but not least, erstklassige Produkte.

Garching, im März 2007



Dr. Stefan Schneidewind
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak
Finanzvorstand



Dr. Winfried Süß, Aufsichtsratsvorsitzender

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2006 regelmäßig durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in fünf gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und des SÜSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands überwacht. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen vom 27. März, 19. Juni, 26. September und 18. Dezember 2006 die eingetretenen Abweichungen des tatsächlichen Geschäftsverlaufs einschließlich des Auftragseingangs von der Planung und die dafür maßgeblichen Gründe ausführlich mit dem Vorstand erörtert. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken unterrichtet.

In seiner Sitzung vom 27. März 2006 hat sich der Aufsichtsrat daneben schwerpunktmäßig mit dem Jahresabschluss 2005, der Vorbereitung der Hauptversammlung vom 20. Juni 2006, der Umstellung des Rechnungswesens auf IFRS sowie der Entwicklung des Geschäfts mit Device Bondern und Gebrauchtmaschinen befasst.

In der Sitzung vom 19. Juni 2006 stand neben der laufenden Berichterstattung des Vorstands ein Bericht des Vorstandsvorsitzenden über ein vom Vorstand eingeleitetes Strategieprojekt im Zentrum der Beratungen.

Am 20. Juni 2006 fand eine weitere Aufsichtsratssitzung statt. In ihr bestätigte der Aufsichtsrat seinen Vorsitzenden, wählte Herrn Gerhard Rauter zu dessen Stellvertreter und regelte die Zusammensetzung seiner Ausschüsse.

Am 26. September 2006 bildeten erneut die laufende Geschäftsentwicklung der SÜSS-Gruppe und der Fortgang des vom Vorstand durchgeführten Strategieprojekts den Schwerpunkt der Beratung des Aufsichtsrats. Daneben wurden auch das C4NP-Projekt, die Kursentwicklung der SÜSS-Aktie und Personalangelegenheiten behandelt.

Demgegenüber standen in der Sitzung vom 18. Dezember 2006 der Ausblick auf den Jahresabschluss 2006 und die Diskussion der Unternehmensplanung für 2007 im Mittelpunkt der Diskussion des Aufsichtsrats. Er behandelte in dieser Sitzung zugleich die Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex.

Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 schied der stellvertretende Vorsitzende, Herr Thomas Schlytter-Henrichsen, aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seine jahrelange engagierte Mitarbeit im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen. Die SÜSS-Gruppe verdankt Herrn Schlytter-Henrichsen viele wertvolle Empfehlungen und Hinweise. Die Hauptversammlung hat am 20. Juni 2006 Herrn Gerhard Rauter, Dresden, an Stelle von Herrn Schlytter-Henrichsen zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem Herr Dr. Süß als Vorsitzender sowie nunmehr die Herren Rauter und Görtz als Mitglieder angehören, hat sich in vier Sitzungen mit Personalangelegenheiten des Vorstands befasst, die Entscheidungen des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten vorbereitet und dem Gesamtaufwachtststst über das Ergebnis seiner Beratungen berichtet.

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, dem jetzt Herr Heinz als Vorsitzender sowie die Herren Dr. Schücking und Dr. Süß als weitere Mitglieder angehören, hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in einer Sitzung unter anderem mit dem Auftrag an den Abschlussprüfer, dessen Unabhängigkeit und Vergütung sowie der Umstellung auf IFRS und der Bilanzstruktur befasst. In diesen Angelegenheiten hat der Prüfungsausschuss die Entscheidungen des Gesamtaufwachtststst vorbereitet und den Gesamtaufwachtststst über das Ergebnis seiner Beratungen unterrichtet.

Die Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats haben teilweise in Form von Telefonkonferenzen stattgefunden.

In seiner Sitzung vom 18. Dezember 2006 hat der Aufsichtsrat zum wiederholten Male gemäß Ziff. 5.6 des Corporate Governance Kodex die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft. Interessenkonflikte zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Gesellschaft sind bei der Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2006 nicht zu Tage getreten.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006, der nach den als IFRS bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2006 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 sowie den gemäß § 315 a des Handelsgesetzbuchs nach den als IFRS bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006, den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2006 geprüft. An der Verhandlung des Aufsichtsrats über die genannten Vorlagen haben die beiden zuständigen Wirtschaftsprüfer des Abschlussprüfers teilgenommen. Sie haben dem Aufsichtsrat mündlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Abschlussprüfers mit den Vertretern des Abschlussprüfers und dem Vorstand erörtert und die Vorlagen gebilligt. Der Aufsichtsrat erklärt hiermit, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung gegen die von ihm geprüften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 ist damit festgestellt. Mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006 ist der Aufsichtsrat einverstanden. Seine Prüfung des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2006 hat der Aufsichtsrat insbesondere auch auf die Vollständigkeit und den Inhalt der nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebenen Angaben erstreckt. Dabei haben sich keine Besonderheiten ergeben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften dafür, dass sie im Geschäftsjahr 2006 mit ihrem Einsatz für die Gesellschaft und den SÜSS MicroTec-Konzern maßgeblich zum Erfolg der SÜSS-Gruppe beigetragen haben.

Garching, im März 2007

Der Aufsichtsrat

Dr. Winfried Süß
Vorsitzender

Highlights 2006

1. Quartal

Auszeichnung für Segment Substrat Bonder

Im März erhielt SÜSS MicroTec von Analog Devices, einem weltweit führenden MEMS-Hersteller, eine Auszeichnung für den Beitrag in einem speziellen Projekt. Der „Analog Devices' 2005 Supplier Excellence Award“ zeichnete die Substrat Bonder-Division von SÜSS MicroTec, Waterbury, USA, für die hervorragenden Leistungen aus. Weitere Awards erhielten u.a. Applied Materials, LAM Research und TSMC.

Auch bei Innovative MicroTechnology (IMT) ist man von den Vorzügen der Substrat Bonder von SÜSS MicroTec überzeugt. IMT ist ein führender MEMS-Auftragsfertiger (Foundry), der wöchentlich über eine Million Mikrosysteme fertigt und ausliefert. Gerade bei derart hochvolumiger Produktion sind ein hoher Yield und damit Präzision und Zuverlässigkeit von größter Wichtigkeit. Nachdem sich IMT von der Qualität und der Flexibilität der SÜSS MicroTec-Substrat Bonder überzeugt hatte, wurde ein Folgeauftrag vergeben. Diese zweite Anlage wurde bereits im März in Santa Barbara, Kalifornien, installiert.

2. Quartal

C4NP: Zuverlässigkeits-Testphase erfolgreich abgeschlossen

Im Mai wurde die, gemeinsam mit IBM durchgeführte, umfangreiche erste Testphase auf Zuverlässigkeit erfolgreich abgeschlossen. Es wurden mit der neuen C4NP-Technologie prozessierte 300mm-Wafer getestet. Im C4NP-Prozess ergaben sich keinerlei Fehlfunktionen.

Diese neue Advanced Packaging-Technologie wurde von IBM entwickelt und stellt die nächste Generation des Wafer Bumpings dar. C4NP ermöglicht, dass bereits vorgefertigte Lotkügelchen auf die Oberfläche eines Wafer platziert werden, und ist eine vergleichsweise einfache und kosteneffektive Alternative zum teuren und komplizierten Elektroplating-Prozess: Das Lotmaterial wird mittels einer Injektions-Düse in kleine Mulden auf einer Glasplatte gefüllt und anschließend in einem einzigen Schritt auf den Wafer übertragen. C4NP vereint die Einfachheit und Effektivität des Siebdruckverfahrens mit der extremen Genauigkeit des Elektroplatings und ermöglicht somit das bleifreie 300mm-Wafer Bumping.

SAIT forscht mit SÜSS-Mask Aligner für Samsung

Im Juni hat SÜSS MicroTec einen Auftrag für einen Mask Aligner „MA200Compact“ von SAIT (Samsungs zentrale Forschungs- und Entwicklungsorganisation in Korea) erhalten. SAIT wird den SÜSS Mask Aligner sowohl in diversen Forschungs- und Entwicklungsprojekten als auch in der Herstellung von MEMS- (Mikro-Elektro-Mechanische-Systeme) und Display-Bauteilen einsetzen.

SAIT ist mittlerweile der wichtigste Technologietreiber des weltweiten Samsung-Konzerns. An das hochkarätige Forschungs- und Entwicklungszentrum werden sehr hohe Qualitätsanforderungen gestellt. Daher muss das dort eingesetzte Equipment nicht nur hochpräzise und zuverlässig arbeiten, sondern auch eine attraktive Cost of Ownership aufweisen. Der MA200 Compact von SÜSS MicroTec erfüllt derart hohe Ansprüche voll und ganz. Deshalb arbeitet SAIT mit SÜSS-Equipment.

3. Quartal

Substrat Bonder – sehr gute Perspektiven

Das Segment Substrat (oder auch Wafer) Bonder entwickelt sich sehr erfolgversprechend. Wafer Bonder werden im Markt Mikrosystemtechnik eingesetzt. Die relevanten Endprodukte sind zum Beispiel Sensoren für Airbags, GPS-Systeme, Reifendruck, Einparkhilfen, Regensensoren und Stabilitätssysteme in Kameras, Handys und in mobilen Spielekonsolen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Einsatzgebiete für Mikrosysteme, zum Beispiel: Rückprojektions-Beamer, Tintenstrahl-Druckköpfe und Biochips. Bei der Herstellung dieser Sensoren werden SÜSS MicroTec-Wafer Bonder in der Massenproduktion eingesetzt.

Beim Wafer Bonding-Prozess werden entweder zwei Wafer hochpräzise zueinander ausgerichtet und dann miteinander „verklebt“. Dieser Prozess wird bei der Produktion von Mikrosystemen benötigt, um Hohlräume herzustellen, in denen sich mechanische Teile bewegen können. Oder es wird ein bearbeiteter Wafer zu einer Glasplatte ausgerichtet und dann mit dieser „verklebt“. In diesem Fall dient die Glasplatte sozusagen als Deckel eines Mikrosystems.

Wafer Bonder von SÜSS MicroTec werden zudem in führenden Forschungs- und Entwicklungsinstituten eingesetzt. Kunden wie Nanoworld und Micralyne sind Technologieführer in der

Mikrosystemtechnik. Mit derartigen Kunden hat SÜSS MicroTec das Ohr am Markt und somit die Chance, die Zukunft des Wafer Bondings mitzugestalten. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen Forschungs- und Entwicklungsinstituten wissen wir um die zukünftigen Bedürfnisse unserer Produktionskunden und sind folglich in der Lage, diesen Anforderungen zu entsprechen.

Vor diesem Hintergrund wurde auch der neue „M-Lock“ Wafer Bonder entwickelt und anlässlich der SEMICON West im Juli vorgestellt. Die Besonderheit dieses Geräts ist eine Vakuumschleuse, die Kontaminierungen auf den zu bearbeitenden Wafern weitestgehend beseitigt. Dies ist in der Mikrosystem-Produktion extrem wichtig, da jede Verunreinigung den Yield (Ausbeute) der Produktion senkt. Daher müssen Produktionsgeräte einen möglichst hohen Yield erzielen. Entsprechend positiv wurde dieser „state-of-the-art“ M-Lock Wafer-Bonder auch von unseren Kunden aufgenommen. In diesem Segment erwartet SÜSS MicroTec in den kommenden Jahren eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens.

Erstklassiger Service – zufriedene Kunden – Testsysteme besonders erfolgreich

Zufriedene Kunden sind Voraussetzung für Erfolg am Markt. VLSI Research Inc. führt jedes Jahr eine Umfrage in der Halbleiterindustrie durch. Basierend auf den Antworten werden dann in verschiedenen Kategorien die Equipment-Lieferanten mit der größten Kundenzufriedenheit ermittelt.

Seit vielen Jahren ist SÜSS bei den Gewinnern. So auch dieses Jahr mit einem hervorragenden ersten Platz in der Kategorie „Material Handling Equipment“ und einem siebten Platz in der Kategorie „Best Wafer Processing Equipment – Small Suppliers“.

In der Kategorie „Material Handling Equipment“ sind hauptsächlich die SÜSS Test- und Prüfsysteme vertreten. Dieses Segment führte im Sommer ein neues Produkt in den Markt ein: Das „Blue-Ray Probe System“, ein Wafer-Prober, der bis zu 70.000 Chips in der Stunde testen kann. Diese Schnelligkeit ist insbesondere beim Testen von LEDs wichtig und bietet Kostenvorteile, da sich auf jedem Wafer Zehntausende LEDs befinden. Eine weitere Besonderheit dieses „Blue-Ray Probe Systems“ ist: Er kann beim Kunden vom halb- zum vollautomatischen System aufgerüstet werden. Somit kann das Gerät mit den Produktionsbedürfnissen unserer Kunden „mitwachsen“. Das macht es äußerst effizient und interessant – insbesondere bei unseren asiatischen Kunden.

4. Quartal

SÜSS MicroTec-Produkte gefragt

Auch im vierten Quartal hatte SÜSS die Gelegenheit, die Auftragseingänge namhafter und strategisch wichtiger Kunden zu publizieren:

OSRAM Opto Semiconductors ist einer der führenden Hersteller von innovativen Beleuchtungsmethoden. OSRAM orderte weitere „LithoFab200“ Cluster-Systeme, die insbesondere in der Massenproduktion von „High Brightness/High Power Light Emitting Diodes“ (LEDs) eingesetzt werden.

High Brightness LEDs (Leuchtdioden mit sehr großer Leuchtkraft) werden gerne als die erste wahre Innovation im Bereich Leuchtmittel seit über 30 Jahren angesehen. Bemerkenswerte Fortschritte wurden bezüglich Effizienz, Lebensdauer und erreichte Lumen erzielt. Dies hatte zur Folge, dass diese LEDs in den vergangenen Jahren in viele Konsumprodukte Einzug gehalten haben: Fernseher, PC-Displays, Digitalkameras, Handys, Kfz-Leuchten und Straßenampeln werden zwischenzeitlich mit diesen Leuchtmitteln illuminiert.

Amkor Technology, Inc. Singapore setzt beim Ausbau der 300mm Wafer Bumping-Kapazitäten weiterhin auf SÜSS MicroTec-Lithografie-Equipment. Amkor ist ein führender Auftragsfertiger im Bereich Wafer Bumping. Entscheidend für Auftragsfertiger sind Kosten, Flexibilität, Einfachheit in der Anwendung für verschiedenste Wafer Bumping-Technologien – die Geräte „MA200 Plus“ (Mask Aligner) und „ACS300 Plus“ (Coating Cluster, das mit der patentierten GYRSET-Technologie ausgerüstet ist) werden diesen hohen Anforderungen gerecht und deshalb werden Folgeaufträge platziert.

Gerade ein paar Jahre her und doch kaum noch vorstellbar: fürs Telefonieren anstehen, nach Münzen kramen und dann in der engen Telefonzelle schwitzen. Und wie oft ging das Kleingeld aus, bevor man zu Ende erzählt hatte. Oder der Gesprächspartner hob nicht ab und man musste wenig später schon wieder den nächsten öffentlichen Fernsprecher suchen.

Damals – anstehen und schwitzen





Heute – flanieren und genießen

Heute hat die Mehrzahl der Menschen ein Handy. Das bedeutet: Telefonieren wann und wo man will. Ohne Münzgeld oder Chipkarte. Ohne bohrende Blicke aus der Warteschlange. Und weil dank immer leistungsfähigerer Chips die Handys immer mehr können, bekommt die Freundin noch schnell einen Schnappschuss vom neuen Schwarm geschickt. Auch keine Zukunftsmusik mehr: Handys, mit denen man die aktuellen Hits abspielen und fernsehen kann.

Die SÜSS MicroTec-Aktie

Aktienmärkte weltweit im Aufwind

Vor dem Hintergrund des günstigen weltwirtschaftlichen Umfelds entwickelten sich die Aktienmärkte 2006 insgesamt positiv. Auf deutliche Rückschläge in der ersten Jahreshälfte folgte im zweiten Halbjahr ein stabiler Aufwärtstrend. Wichtige Leitindizes erreichten sogar langjährige Höchststände. Triebfedern der steigenden Notierungen waren unter anderem eine vorübergehende Verschnaufpause bei den Rohstoffpreisen, die durchweg guten bis hervorragenden Jahresabschlüsse wichtiger börsennotierter Unternehmen weltweit sowie die Übernahme- und Fusionswelle, die 2006 einen neuen Höhepunkt erreichte.

Alle wichtigen Indizes verzeichneten Kursaufschläge: Während das Jahresplus des japanischen Nikkei-225 mit 5,7 Prozent das Schlusslicht bildete, legten der Dow Jones um 16,3 Prozent und der EuroSTOXX 50 um 15,1 Prozent zu. Der für SÜSS MicroTec wichtige Vergleichsindex TecDAX verzeichnete auf Jahressicht ein Plus von 25,5 Prozent. Der Deutsche Aktienindex (DAX) schloss am Jahresende mit 6.596 Punkten – einem Zuwachs von 22 Prozent. Da 2006 auch die Erträge deutscher Aktiengesellschaften kräftig wuchsen und einige Gesellschaften historisch hohe Cashflows ausweisen, ist der deutsche Aktienmarkt weiterhin attraktiv für Anlegerkapital: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis vieler Börsenwerte liegt noch immer unterhalb langjähriger Durchschnittswerte.

Aktie der SÜSS MicroTec AG plus 50 Prozent

Die SÜSS MicroTec-Aktie konnte 2006 alle für sie relevanten Vergleichsindizes in den Schatten stellen. Weder der TecDAX noch der Branchenindex Prime Industrial (plus 18,6 Prozent) konnten die Dynamik der SÜSS MicroTec-Aktie erreichen. Dem Eröffnungskurs am 2. Januar 2006 (4,67 Euro) stand am letzten Handelstag ein Kurs von 6,95 Euro gegenüber – ein Jahresplus von 48,8 Prozent. Als zwischenzeitlichen Jahreshöchststand erreichte das Papier im Mai ein Niveau von mehr als neun Euro.

Der Kapitalmarkt verbucht offensichtlich die von SÜSS MicroTec in den vergangenen Jahren durchgeführte und abgeschlossene Restrukturierung und Neuausrichtung als Erfolg. Weiterhin konnte das Unternehmen von der Dynamik im Markt für Halbleiter und Mikrosystemverbindungen profitieren. Hersteller weltweit wollen das Kundenbedürfnis nach immer kleineren und leistungsfähigeren elektronischen Geräten wie Handys oder Laptops erfüllen und brauchen dafür immer leistungsfähigeres Equipment zur Chipherstellung. SÜSS ist hier technologisch führend und verfügt insbesondere durch die in Kooperation mit IBM entwickelte C4NP-Technologie über sehr große Wachstumschancen.

Der durchschnittliche Tagesumsatz der SÜSS MicroTec-Aktie lag 2006 an allen deutschen Börsen bei 98.147 Stück. Die Handelbarkeit ist so auch für institutionelle Anleger gewährleistet. Insgesamt wechselten knapp 24,6 Millionen Aktien den Besitzer.

Investor Relations-Arbeit überzeugte

Auch 2006 legte das Management der SÜSS MicroTec AG besonderen Wert auf eine intensive Investor Relations-Arbeit. Vorstand und IR-Verantwortliche suchten aktiv das Gespräch mit den Kapitalmarktteilnehmern. Im gesamten Jahresverlauf gab es engen Kontakt mit Investoren, Analysten sowie Vertretern der Wirtschaftspresse.

Roadshows, Investorenkonferenzen und zahlreiche Einzelgespräche an verschiedenen Finanzplätzen in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Frankreich und der Schweiz dienten SÜSS MicroTec dazu, die aktuelle Geschäftsentwicklung und die positiven Zukunftsaussichten einem interessierten Fachpublikum zu erläutern. Umgekehrt gewann das Unternehmen aus Feedback, Fragen und Kritik der Financial Community wertvolle Hinweise, um seine Kapitalmarktkommunikation noch weiter zu optimieren. Derzeit veröffentlichen sieben Banken beziehungsweise Researchhäuser regelmäßig Studien zu unserem Unternehmen. Einen aktuellen Stand der Analysen stellen wir unseren Anlegern unter www.suss.com zur Verfügung.

Besonders ermutigt, die intensive IR-Arbeit fortzusetzen, wurde SÜSS MicroTec durch die Auszeichnung beim League of American Communications Professionals Award (LACP), San Diego, USA. Nachdem bereits der Geschäftsbericht 2004 mehrfach ausgezeichnet wurde, erhielt der Geschäftsbericht 2005 wieder die Auszeichnung „Platinum“ in seiner Klasse.

Um weiterhin für einen positiven Verlauf des Aktienkurses zu sorgen, die Aktionärsbasis sowohl um institutionelle wie auch private Anleger zu verbreitern und die Analysten-Coverage zu erhöhen, wird die SÜSS MicroTec AG den offenen Dialog mit der Financial Community auch 2007 mit vollem Einsatz weiterführen. Mittel- bis langfristig ist es das formulierte Ziel von SÜSS MicroTec, wieder in den TecDAX aufzurücken.

Dank an die Aktionäre

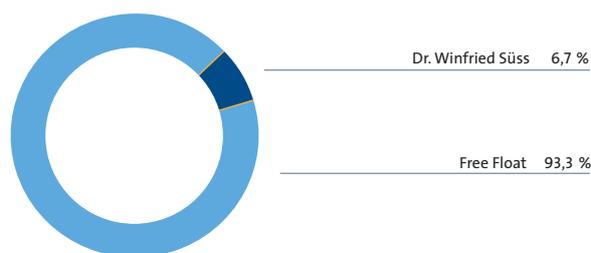
Wir bedanken uns bei allen Aktionären und Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wir ermöglichen unseren Anteilseignern und allen Interessierten gerne jederzeit Einblick in öffentliche Dokumente, die über den Wert und die Zukunftsperspektiven der SÜSS MicroTec AG Aufschluss geben. Informationen zu Aktie und Hauptversammlung, unsere Unternehmensberichte, Directors' Dealings und der Finanzkalender werden in Deutsch und Englisch stets aktuell auf unserer Website www.suss.com veröffentlicht. Auf Wunsch versenden wir aktuelle Informationen auch gerne per E-Mail oder Post.

Aktienkennzahlen

WKN	722670
ISIN	DE0007226706
Reuters-Kürzel	SMHG.F
Bloomberg-Kürzel	SMH GR
Anzahl ausgegebener Aktien (Stand: 29.01.07)	17.006.926
Jahresanfangskurs in Euro	4,67
Jahresschlusskurs in Euro	6,95
Prozentuale Jahresentwicklung	48,8 %
Durchschnittliches Handelsvolumen/Tag 2006	98.147
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Designated Sponsor (ab 01.01.06)	HSBC Trinkaus & Burkhardt
Jahreshoch/-tief in Euro	9,05/4,67

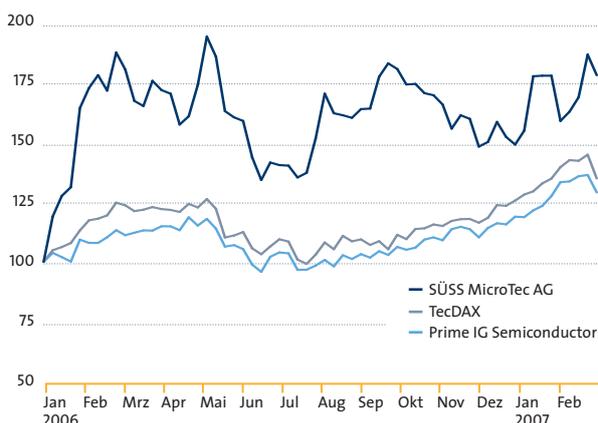
Aktionärsstruktur zum 31.12.2006

in %



SÜSS MicroTec-Aktie indexiert

(TecDax, Prime IG Semiconductor)



SÜSS MicroTec-Aktie in Euro

(38-Tage-Linie)



Corporate Governance Bericht

Das Ziel des Corporate Governance Regelwerks ist eine gute und verantwortliche Unternehmensführung, transparent für den Aktionär und die Öffentlichkeit. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG setzen die Standards des Regelwerks aktiv um und sehen den Deutschen Corporate Governance Kodex als wichtigen Teil der Unternehmenskultur. Bereits 2002 wurde eine Corporate Governance Beauftragte berufen, die direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Seither wird die Corporate Governance in der SÜSS MicroTec AG in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt.

Über die Corporate Governance berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wie folgt:

A. Entsprechenserklärung

Der Corporate Governance Kodex beinhaltet derzeit über 70 Empfehlungen, zu welchen ein Unternehmen gem. § 161 Aktiengesetz jährlich eine Erklärung über etwaige Abweichungen abgeben muss.

Am 19. Dezember 2005 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 2. Juni 2005 mit zwei Ausnahmen (Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung und erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats) entsprochen werde. Am 18. Dezember 2006 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 2. Juni 2005 bzw. nach Inkrafttreten in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit den zwei vorgenannten Ausnahmen entsprochen worden sei und werde. Die Entsprechenserklärung ist unter www.suss.com im Internet abrufbar.

Gemäß dieser Erklärung entspricht die SÜSS MicroTec AG den Empfehlungen des aktuellen Deutschen Corporate Governance Kodex und wird diesen voraussichtlich auch künftig entsprechen – mit den folgenden zwei Ausnahmen (im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Änderungen ergeben):

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in **Ziffer 3.8** bei Abschluss einer Directors and Officers Liability Insurance (Haftpflichtversicherung), einen angemessenen Selbstbehalt für die Organe der AG zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt

bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Handeln aller geschäftsführenden Organe wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert. Es ist deshalb auch keine Vereinbarung eines organspezifischen Selbstbehalts geplant.

In **Ziffer 5.4.7** empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie eine Vergütung für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in Ausschüssen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor. Die Mitgliedschaft in Ausschüssen wird dadurch berücksichtigt, dass für die Teilnahme an Sitzungen eines Ausschusses ein Sitzungsgeld gezahlt wird. Der Vorsitz in Ausschüssen wird nicht besonders vergütet. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt angemessen vergütet wird.

Von den Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex können die Unternehmen auch ohne Erklärungspflicht abweichen. Wir ermöglichen unseren Aktionären und der Öffentlichkeit eine größtmögliche Transparenz und nehmen daher auch zur Umsetzung der Anregungen Stellung. Die SÜSS MicroTec AG befolgt die Anregungen des DCGK mit folgenden Ausnahmen:

- Der Stimmrechtsvertreter ist abweichend von der Anregung in Ziffer 2.3.3 Satz 3 DCGK während der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich erforderlichen Sicherheit gewährleisten lässt.
- Abweichend von Ziffer 2.3.4 DCGK kann die Hauptversammlung bisher noch nicht via Internet verfolgt werden. Im Hinblick auf zusätzliche Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.
- Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nicht mitbestimmt ist, findet keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt, Ziffer 3.6 Abs. 1 DCGK.
- Abweichend von der Anregung in Ziffer 5.4.6 DCGK laufen die Amtszeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht zu unterschiedlichen Terminen aus.

- Der Aufsichtsrat erhält keine auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Vergütungskomponente (Anregung in Ziffer 5.4.7 Abs. 2 Satz 2 DCGK), sondern eine feste Vergütung. Um die Überwachungsaufgaben zweckgemäß und unabhängig durchführen zu können, hält der Aufsichtsrat eine vom Unternehmenserfolg abhängige Vergütung für nicht zielführend.

Auch in diesem Jahr werden Aufsichtsrat und Vorstand der SÜSS MicroTec AG wieder eine Entsprechenserklärung gemäß dem dann aktuell geltenden Kodex abgeben.

B. Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats

Es bestanden keinerlei Interessenkonflikte von Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nach der Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats hinreichend unabhängig.

C. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

An die Mitglieder des Aufsichtsrats hat die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2007 für das Geschäftsjahr 2006 folgende Vergütungen gezahlt:

	Vergütung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 der Satzung in EUR	Vergütung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 der Satzung in EUR	Auslagenersatz und 19 % MwSt/ 30 % AR-Steuer etc. (§ 13 Abs. 4 der Satzung) in EUR
Dr. Winfried Süß	45.000,00	10.500,00	1.152,29 und 10.545 MwSt abzgl. 2.353,00 D&O Versicherung = 9.344,29
Gerhard Rauter*	11.250,00	6.000,00	1.549,87 abzgl. 588,50 D&O Versicherung = 961,37
Dr. h.c. Horst Görtz	15.000,00	10.500,00	3.554,62 plus 4.845 MwSt abzgl. 785,00 D&O Versicherung = 7.614,62
Peter Heinz, MBA	15.000,00	7.500,00	11.294,05 minus 6.750,00 AR-Steuer und 785,00 D&O Versicherung = 3.759,00
Prof. Dr. Anton Heuberger	15.000,00	7.500,00	2.581,96 plus 4.275 MwSt abzgl. 785,00 D&O Versicherung = 6.071,96
Thomas Schlytter-Henrichsen**	11.250,00	3.000,00	990,32 plus 2.707,50 MwSt abzgl. 588,50 D&O Versicherung = 3.109,32
Dr. Christoph Schücking	15.000,00	7.500,00	537,82 plus 4.275,00 MwSt abzgl. 785,00 D&O Versicherung = 4.027,82

* ab 20. Juni 2006

** bis 20. Juni 2006

Darüber hinaus haben die Mitglieder des Aufsichtsrats mit einer Ausnahme keine Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten. Die Rechtsanwaltssozietät CMS Hasche Sigle, deren Partner das Aufsichtsratsmitglied Dr. Christoph Schücking ist, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr für ihre Beratungsleistungen für Unternehmen der SÜSS MicroTec-Gruppe insgesamt EUR 22.886,09 erhalten.

Im Übrigen wird auf die Angaben im Anhang zu den nahestehenden Personen verwiesen.

D. Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats legt die Vorstandsvergütung fest. Das Aufsichtsratsplenum berät und überprüft regelmäßig die Vergütungsstruktur. Sofern die Mitglieder des Vorstands Vergütungen aus Mandaten bei Konzerngesellschaften erhalten, werden diese an die Gesellschaft abgeführt. Vergütungen aus Mandaten in konzernfremden Gesellschaften, die mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernommen werden, verbleiben dem betreffenden Vorstandsmitglied in voller Höhe. Mandate in konzernfremden Gesellschaften bestehen nicht.

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands besteht aus fixen und variablen Komponenten.

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt; sie umfassen auch Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und von Zuschüssen zur Krankenversicherung und zur freiwilligen Rentenversicherung. Den Mitgliedern des Vorstands sind Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherung) gemacht worden. Für Herrn Dr. Schneidewind übernahm SÜSS MicroTec für Januar bis August 2006 die im Zuge der doppelten Haushaltsführung anfallenden Kosten. Weitere geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Neben der festen Vergütung erhalten die Mitglieder des Vorstands einen variablen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen, die nicht nachträglich geändert werden können, orientiert.

Die dritte am langfristigen Erfolg des Unternehmens orientierte aktienbasierte Vergütung besteht aus Aktienoptionen gemäß dem Aktienoptionsplan 2005.

E. Offenlegung der Vergütung des Vorstands

An die Mitglieder des Vorstands hat die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2006 folgende Vergütungen gezahlt:

	Grundgehalt in EUR*	Jahresbonus für 2005 in EUR	Aktienoptionen (Anzahl)	Sonstige Leistungen in EUR	Aufwand für Alters- versorgung in EUR
Dr.-Ing. Stefan Schneidewind	276.501,99	81.605,69	40.000	6.142,56**	2.148,00
Stephan Schulak	225.516,00	65.284,55	40.000	6.142,56** 241.666,50***	2.148,00

* Im Fixgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

*** Teilbetrag der Abfindung

Herr Schulak wird mit Wirkung zum 31. März 2007 sein Amt als Vorstandsmitglied der Gesellschaft niederlegen. Mit der Beendigung der Vorstandstätigkeit wurde Herrn Schulak eine Abfindung in Höhe von insgesamt EUR 483.333,00 zugesagt; im Rahmen dieser Vereinbarung hat Herr Schulak auf insgesamt 80.000 Aktienoptionen verzichtet. Hiervon wurde die Hälfte bereits im Geschäftsjahr ausgezahlt und für die andere Hälfte wurde eine Rückstellung gebildet. Für den Jahresbonus 2006 wurden für Herrn Dr. Schneidewind EUR 91.668,00 und für Herrn Schulak EUR 66.668,00 Rückstellungen gebildet.

Für Pensionsverpflichtungen gegenüber einem ehemaligen Vorstandsmitglied der Gesellschaft wurden EUR 24.291,00 zurückgestellt.

F. Directors' Dealings und Anteilsbesitz von Organmitgliedern und diesen nahe stehenden Personen

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie diesen nahe stehende Personen halten zum 31. Dezember 2006 Aktien und Optionen auf Aktien der SÜSS MicroTec AG wie folgt:

- Herr Dr. Schneidewind: gemeinsam mit seiner Ehefrau 13.278 Aktien. Er hält außerdem 80.000 Optionen.
- Herr Schulak: 25.000 Aktien. Seine sämtlichen Optionen sind verfallen.
- Herr Dr. Winfried Süß: 1.131.000 Aktien.
- Herr Gerhard Rauter: 0 Aktien.
- Dr. h.c. Horst Görtz: 17.216 Aktien.
- Herr Peter Heinz: 1.338 Aktien.
- Herr Prof. Dr. Anton Heuberger: 0 Aktien.
- Herr Dr. Christoph Schücking: 500 Aktien.

Über folgende Erwerbe und Veräußerungen von SÜSS-Aktien durch Organmitglieder und diesen nahe stehende Personen im Geschäftsjahr 2006 sind der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2006 Mitteilungen nach § 15a WpHG zugegangen.

- Dr. h.c. Horst Görtz: Kauf von 2.000 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 13.200,00 am 20.06.2006. Kauf von 1.322 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 6.213,40 am 26.08.2006.



- Dr. Stefan Schneidewind: Erwerb von 20.208 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 69.515,52 (Ausübung von Aktienoptionen) am 8.11.2006; Verkauf von 2.000 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 14.600,00 am 13.11.2006; Verkauf von 4.000 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 29.200,00 am 14.11.2006; Verkauf von 6.000 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 44.560,00 am 15.11.2006; Verkauf von 1.500 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 11.550,00 am 16.11.2006.
- Stephan Schulak: Erwerb von 40.000 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 137.600,00 (Ausübung von Aktienoptionen) am 13.11.2006; Verkauf von 28.000 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 211.079,70 am 16.11.2006.
- Maritta Süß: Verkauf von 147.433 SÜSS-Aktien zum Preis von insgesamt EUR 1.179.544,00 am 19. Mai 2006.

G. Aktienoptionsprogramme

I. Aktienoptionsprogramm 1999

Die Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG hat am 06.04.1999 über ein Aktienoptionsprogramm Beschluss gefasst. Die Optionen konnten an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften ausgegeben werden. Die Anzahl der unter diesem Optionsprogramm ausstehenden 210.669 Optionen hat sich im Laufe des Geschäftsjahres verändert: 142.669 Optionen (davon 6.256 von Mitgliedern des Vorstands) sind verfallen. Zum Ende des Geschäftsjahres standen noch 68.000 Optionen aus. Der Ausübungspreis liegt bei EUR 35,44. Das Ende der Laufzeit ist im Mai 2007. Das Bezugsrecht kann von einem Bezugsberechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktie den Bezugspreis (EUR 35,44) um mindestens 100 Prozent übersteigt.

II. Aktienoptionsprogramm 2002

Die Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG hat am 14. Juni 2002 über ein Aktienoptionsprogramm Beschluss gefasst. Die Optionen konnten an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen i. S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundener Unternehmen i. S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden. Die Anzahl der unter diesem Optionsprogramm ausstehenden 269.358 Optionen, wovon 60.208 an Mitglieder des Vorstands ausgegeben worden waren, hat sich im Laufe des Geschäftsjahres wie folgt verändert: 18.500 Optionen sind verfallen. 10.500 Optionen, die 2003 ausgegeben worden

waren, wurden zum Bezugspreis von EUR 1,11 ausgeübt. 203.458 der 2004 ausgegebenen Optionen wurden zum Bezugspreis von EUR 3,44 ausgeübt, davon entfielen 60.208 Optionen auf Mitglieder des Vorstands. Zum Ende des Geschäftsjahres standen noch 36.900 Optionen aus. Davon können 9.000 Optionen bis Mai 2009 zu einem Ausübungspreis von EUR 1,11 und 27.900 Optionen zu einem Ausübungspreis von EUR 3,44 bis August 2010 ausgeübt werden, wenn eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) wenn der Börsenkurs der SÜSS-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p. a. gestiegen ist und sich der Börsenkurs der Gesellschaft in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax oder sein Nachfolgeindex TecDax oder (ii) wenn der Börsenkurs der SÜSS-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen ist.

III. Aktienoptionsprogramm 2005

Die Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG hat am 21. Juni 2005 über ein weiteres Aktienoptionsprogramm Beschluss gefasst. Die Optionen können an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen i. S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und ihr nachgeordneter verbundener Unternehmen i. S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2006 wurden 209.500 Optionen, davon 80.000 an Mitglieder des Vorstands, ausgegeben. Im Jahr 2006 sind keine Optionen ausgeübt worden. Bis zum Geschäftsjahresende sind insgesamt 93.500 Optionen, von denen 80.000 an Mitglieder des Vorstands ausgegeben worden waren, verfallen. Zum Ende des Geschäftsjahres standen noch 309.000 Optionen aus, von denen 80.000 von Mitgliedern des Vorstands gehalten wurden. Davon können 142.500 Optionen bis August 2010 zu einem Ausübungspreis von EUR 4,95 und 166.500 Optionen zu einem Ausübungspreis von EUR 7,53 bis Juni 2011 ausgeübt werden, wenn eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) wenn der Börsenkurs der SÜSS-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 Prozent p. a. gestiegen ist und sich der Börsenkurs der Gesellschaft in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt hat als der TecDax oder (ii) wenn der Börsenkurs der SÜSS-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 Prozent p. a. gestiegen ist.

Ergänzend wird auf die Ausführungen zu den Aktienoptionen im Anhang des Konzernabschlusses hingewiesen.





Damals – suchen und fluchen

Entnervte Alleinreisende: Beim Versuch, gleichzeitig zu lenken und die Straßenkarte zu lesen, wäre es beinahe zum Crash gekommen. Streitende Paare: „Du hast einfach keinen Orientierungssinn, typisch Frau!“. „Na hör mal! Wenn Du vorhin wie empfohlen abgelenkt wärst, könnten wir längst da sein.“ Bevor es computer- und satellitengestützte Navigationssysteme im Auto gab, hatte jede Fahrt in einer fremden Stadt das Potenzial, zum Abenteuer zu werden – Verspätungen, Stress und Verkehrsrisiken inklusive.

Heute bestellen sich immer mehr Autofahrer ihren Wagen mit eingebautem „Navi“ oder rüsten ein solches System nach. Das kostet nicht mehr viel und ist im Prinzip kinderleicht. Die Sensoren und Chips in dem kleine Bordcomputer erkennen den aktuellen Standort und berechnen in Sekundenschnelle den Weg zur eingegebenen Zieladresse. Das ist praktisch und vor allem sicher. Denn Fahrer, die im Stadtplan suchen oder nach Straßenbezeichnungen fahnden, bauen erwiesenermaßen mehr Unfälle als die, die sich ganz auf den Verkehr konzentrieren können.

Heute – planen und ankommen



SÜSS MicroTec-Produkte

Coater



Beschichtungsgerät

Coater verteilen einen fotoempfindlichen Lack auf dem Wafer. Die SÜSS MicroTec Spin Coater sind auf dicke Fotolacke, die auf Wafer aufgebracht werden, spezialisiert. Die Spray Coater besprühen ein Substrat und können dadurch sogar dreidimensionale Strukturen gleichmäßig belackten.

Mask Aligner



Belichtungsgerät

Mask Aligner richten eine Glasmasken submikrometerngenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

Substrat Bonder



Verbindungsgerät

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können unsere Airbags, Reifendruckensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker etc. funktionieren.

Device Bonder



Verbindungsgerät

Im Gegensatz zum Substrat Bonder verarbeitet der Device Bonder bereits vereinzelte elektronische Bauteile. Das heißt, er integriert mit höchster Genauigkeit die aus einem Wafer herausgesägten Devices in eine Baugruppe, die dann zum Endprodukt weiter verarbeitet wird.

Developer



Entwicklungsgerät

Developer lösen mit Hilfe von Chemikalien das zuvor vom Mask Aligner erzeugte Abbild aus der fotoempfindlichen Schicht auf dem Wafer heraus. Der gesamte Prozess ist mit dem des Fotografierens mit einer konventionellen Kamera gut zu vergleichen: Auf dem Film ist ein fotoempfindliches Material, das beim „Knipsen“ belichtet und anschließend entwickelt wird.

Prober



Test- und Prüfsysteme

Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden, und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexibel, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

Einfach SÜSS

Komfort und Kommunikation – SÜSS-Produkte machen's möglich

Fast jeder Mensch in den Industrieländern kommt mindestens einmal täglich mit einem Produkt in Kontakt, das Komponenten enthält, die mit Know-how von SÜSS MicroTec hergestellt wurden. Wir sind einer der führenden Spezialausrüster für die Chip- und Mikrosystemindustrie. Ohne diese Branche wäre unser modernes Leben gar nicht mehr vorstellbar. Denn heute kommt mit wenigen Ausnahmen kein Privathaushalt, kein Unternehmen, kein Fortbewegungsmittel und kaum eine Freizeitbeschäftigung mehr ohne elektronische Geräte aus. Und deren Herzstück sind Chips, auch Halbleiter oder Mikroprozessoren genannt. So komplex sie technisch sind, so einfach kann ihre Wirkung zusammengefasst werden: Sie machen elektronische Geräte leistungsfähiger und ermöglichen immer neue Anwendungen. SÜSS MicroTec-Produkte sind oft bei der Herstellung dieser Chips, die unseren Alltag Jahr für Jahr bereichern, beteiligt.

Während die heutigen Teenager schon in eine Welt voller Handys, MP3-Player und vollelektronischer Autos hineingeboren sind, können sich ältere Jahrgänge noch gut erinnern, welche rasante Entwicklung es bei all diesen Technologien in den vergangenen 20 bis 30 Jahren gab. Erinnern wir uns an die späten 80er-Jahre: Mobiltelefone waren groß und schwer wie Backsteine und nur etwas für betuchte Geschäftsleute. Der Computer brauchte scheinbar eine Ewigkeit zum Hochfahren, das Internet war außerhalb von Fachkreisen noch reine Zukunftsmusik. Aktuelle Hits nahm man aus dem Radio auf Musikkassette auf – und ärgerte sich dann über die unzulängliche Tonqualität und manchmal über den Bandsalat beim Abspielen. Und die Korrespondenz wurde auf der Schreibmaschine erledigt – samt lästiger Korrekturen mit Tippex-Flüssigkeit.

Rollende Hochtechnologie

Seitdem hat sich sehr viel geändert. Man muss sich nur einmal ein Auto anschauen, das heute vom Band läuft. Kostenbewusste PKW-Besitzer und Tüftler aus Leidenschaft mögen sich darüber beklagen, dass man heute an einem modernen PKW eigentlich kaum noch etwas selbst reparieren kann. Grund ist der Siegeszug der Elektronik. Sie macht unsere Autos zu „Hightech auf Rädern“. Was aber viel wichtiger ist: Moderne Elektronik macht Autos sicherer, komfortabler und umweltschonender. Einige Beispiele: Airbagsensoren sorgen dafür, dass sich das lebensrettende Luftkissen nur dann öffnet, wenn es soll – dann aber

schnell und zuverlässig. Abstands- oder Entfernungsmelder helfen dabei, crashfrei in jede Parklücke zu kommen. Die Elektronische Stabilitätskontrolle (ESP) und Antiblockiersysteme (ABS) erhöhen die Fahrsicherheit. Drucksensoren in den Reifen zeigen an, wenn zu wenig Luft im Pneu ist und dadurch der Spritverbrauch steigt. Mit Navigationssystemen via GPS kommt man schnell und zuverlässig an sein Ziel. Und die moderne Einspritztechnik bei Motoren sorgt für einen effizienten und möglichst schadstoffarmen Antrieb. Alle diese Sensoren enthalten Mikrosysteme, auch MEMS genannt. Und SÜSS-Equipment ist führend bei der Herstellung von diesen sehr kleinen elektro-mechanischen Bauteilen.

Kleine Kraftpakete

Möglich wurde diese elektronische Revolution beim Auto – aber auch in der Computer- und Unterhaltungsindustrie sowie zahlreichen anderen Feldern – durch die Miniaturisierung. Faszinierender Trend: Geräte und Komponenten werden immer leistungsfähiger und trotzdem immer kleiner und leichter. Wer beispielsweise vor zehn Jahren noch unter der Kilolast seines Laptops stöhnte, weiß die heutigen Fliegengewichte zu schätzen, die in jede Aktentasche passen. Die Anforderungen der Endverbraucher sind eindeutig: Jede neue Generation von elektronischen Anwendungen soll mehr „Power“ haben. Gleichzeitig will niemand zu den Größenvolumina der ersten „Dinosaurier“-Geräte zurückkehren. Und genau hier kommt SÜSS MicroTec ins Spiel – mit der Advanced Packaging-Technologie.

Klein, stark, zuverlässig, preiswert – das verlangen die Hersteller von Handys, Fernsehern, Computern & Co heute von Chips. Unsere Lösung: Verdichtung. Waren 1971 erst 2.300 Transistoren auf einem Halbleiter, zählte man in den 90er-Jahren bereits zwischen drei und zehn Millionen. Heute sind es 95 Millionen. Schön längst sind wir in der Sphäre der extrem kleinen Nanotechnologie angekommen. Ein Nanometer entspricht dem Milliardenstel eines Meters bzw. dem Millionstel eines Millimeters. Ein normales Lichtmikroskop kann solche Ministrukturen gar nicht mehr erkennen – und das menschliche Auge schon gar nicht. Das erfreut sich daran, dass heute viele Handys ganz passable Fotos aufnehmen, man über einen Laptopbildschirm und W-LAN unterwegs Filme in guter Qualität anschauen kann und die Tagesschau aufs Handy kommt.



Eine weitere Triebfeder für die Leistungsexplosion bei Chips ist die Integration. Das heißt, dass beispielsweise PDA, Handy und Kamera in einem einzigen mobilen Gerät enthalten sind. Aus drei mach eins – kein Wunder, dass die Nachfrage nach den Packaging-Lösungen von SÜSS MicroTec Jahr für Jahr steigt. Denn das Ende der Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit unserer vielen elektronischen Helfer ist ja noch lange nicht in Sicht.

Von der Siliziumscheibe zum voll funktionstüchtigen Mikrosystem

Die Maschinen aus dem Hause SÜSS sind hochkomplexe Geräte, die ihrerseits bei der Produktion hochkomplexer Bauteile zum Einsatz kommen. Wenn wir jedoch die Herstellung eines typischen MEMS-Bauteils – wie beispielsweise eines Airbag-Sensors – betrachten, können wir vielleicht veranschaulichen, wie stark SÜSS involviert ist:

Am Anfang des Fertigungsprozesses steht die Siliziumscheibe – am Ende wird dieser Wafer Hunderte oder sogar Tausende Sensoren enthalten. Die Scheiben werden mittels Rotations- oder Sprühverfahren mit einem lichtempfindlichem Material beschichtet – dies erledigt ein „Coater“. Nach dem Trocknen wird der Wafer mit dem „Mask Aligner“ bearbeitet, der fast wie eine Kamera funktioniert: Die lichtempfindliche Scheibe wird mit einem vorgefertigten Muster (Chromlinien auf einer Glasmaske) belichtet. Dann werden die Bereiche ohne Muster weggeätzt, wodurch dreidimensionale Linien und Auskerbungen entstehen („Developer“). Diese drei Schritte werden so oft wiederholt, bis die erforderlichen Ebenen elektrischer Leiterbahnen und mechanischer Teile auf dem Wafer entstanden sind. Nun kann der Wafer mit Hilfe eines Messfühlers auf korrekte Funktionalität und seine Parameter geprüft werden – fließen die elektrischen Ströme schnell genug? Entfaltet sich die Mechanik auf die richtige Weise? Diese Test erledigen die „Prober“. Es ist auch möglich, dass Scheiben miteinander verbunden werden müssen – zum Beispiel, um die Mechanik des Bauteils mit einem eigenen Glasdeckel zu versehen, damit ein Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub gewährleistet ist. Dies erfolgt durch einen „Wafer Bonder“. Bei Bedarf kann der „verbundene Wafer“ dann erneut getestet werden, um sicherzustellen, dass bis zu diesem Stadium alles funktionsfähig ist. Nun folgt die Packaging-Phase, bei der wiederum „Coater“ und „Mask Aligner“ eingesetzt werden, um das fast fertige Bauteil mit Strukturen zu versehen. Die Wafer werden anschließend in die einzelnen Mikrosysteme zersägt.

Mit Hilfe eines „Device Bonders“ können die einzelnen Bauteile mit ihren Halterungen oder, zur weiteren Bearbeitung, mit einem anderen Wafer verbunden werden... und da die bedeutendsten Hersteller von Airbag-Sensoren diese SÜSS-Technologie einsetzen, haben Sie eine gut 90-prozentige Chance, dass der Airbag in Ihrem Auto mit Geräten von SÜSS hergestellt wurde.

SÜSS baut an der Zukunft mit

An der Zukunft wird schon heute gebaut – mit Technologie von SÜSS MicroTec. Wenn beispielsweise Physiker die Geheimnisse des Weltraums erforschen, brauchen sie Hochleistungscomputer, ultrastarke Teleskope und feinste Messsensoren. In all diesen Geräten stecken Halbleiter, Mikrosystemmodule (MEMS) oder Optoelektronik-Komponenten, die mit Maschinen und Anlagen von SÜSS MicroTec produziert und kontrolliert werden können. Etwas bodenständiger, aber für unsere öffentliche Sicherheit wichtig, sind biometrische Verfahren zur Personenerkennung oder DNA-Analysen – auch hier gilt oft: „SÜSS inside“.

Worauf viele Handybesitzer warten: Dass ihr Mobiltelefon endlich so gute Fotos schießt wie die Digitalkamera. Immer leistungsfähigere Chips rücken dies in greifbare Nähe, und die ersten Hersteller rühmen sich schon, dass es bald keine Unterschiede zwischen Handycamera und „Digicam“ mehr gibt.

Dass SÜSS-Technologie indirekt auch fit und gesund hält, zeigt ein Blick auf die boomende Sportausrüster-Branche. Besonders ambitionierte Jogger können bereits Schuhe mit eingebautem Sensor kaufen, der Geschwindigkeit und zurückgelegte Distanz misst. Der passende Brustgurt warnt, wenn der Puls zu hoch schlägt, und kann durch Datenabgleich mit dem Schuh die verbrauchten Kalorien ermitteln. Wem der Brustgurt zu unbequem ist, bekommt T-Shirt oder Sport-BH mit eingebautem Sensor. Zuhause überträgt das Equipment die Daten einfach per Infrarotschnittstelle in die persönliche Trainingssoftware. Und für Sportmuffel bietet die nächste Generation der Spielekonsolen bisher nicht gekannte Leistungen: „Strom sparende Prozessoren, winzige Speicherchips, sensible Sensoren und brillante Displays“, schwärmt ein deutsches Wirtschaftsmagazin. Dahinter stehen sehr oft die mit SÜSS-Equipment produzierten, leistungsfähigen Komponenten.



„Das Genie beherrscht das Chaos“ – so sagt man. De facto gehen durch Unordnung im Büro oder im heimischen Arbeitszimmer viel Zeit und Geld verloren. Da werden Steuerbelege nicht rechtzeitig ans Finanzamt geschickt oder die Frist für Fördermittel verstreicht ungenutzt. Und der Chef mahnt schon zum zweiten Mal den Bericht an, der „hier doch irgendwo sein muss, jedenfalls hab ich ihn gestern noch in der Hand gehabt.“

Damals – stapeln und wühlen





Heute – ordnen und klicken

Clevere lassen Hightech für sich arbeiten. Leistungsfähige Chips in einem Computer ermöglichen beste Organisation und Arbeitsergebnisse: Texte schreiben, Präsentationen erstellen, Termine aktuell halten, an Fristen erinnern, alle wichtigen Adressen und Telefonnummern parat haben, mit Kollegen, Kunden und Freunden in aller Welt kommunizieren – und zur Entspannung kurz Musik hören oder ein Video anschauen. All das können heute Laptops, die nicht größer und schwerer als eine DIN-A4-Schreibmappe sind.

Trends und Perspektiven

Dynamik in den SÜSS-Märkten

Als einer der führenden Spezialausrüster für die Chip- und Mikrosystemindustrie profitiert SÜSS MicroTec vom weiterhin intakten Aufwärtstrend in wichtigen Märkten. Viele interessante Wachstumsmärkte konnten sich erst aufgrund von Chips und Mikrosystemen (MEMS) entwickeln. Automobiltechnik, Computer und Zubehör, Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik und Medizintechnik sind aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken und werden im Alltag der Menschen in einer wachsenden Zahl von Ländern weiter an Bedeutung gewinnen.

Für die nächsten Jahre erwarten die Researchinstitute „Yole“ ein weltweites Wachstum von jährlich 13 Prozent für die MEMS-Industrie und „Prismark“ 23 Prozent bei Chipverbindungen (Advanced Packaging). Wachstumstreiber Nummer eins ist der rasante technologische Fortschritt in unseren Märkten, der in immer kürzeren Abständen neue Ausrüstung für Produktion und Qualitätskontrolle erfordert. SÜSS MicroTec erfüllt mit seinem Produkt- und Lösungsportfolio vier wichtige Kundenanforderungen:

- Halbleiter und Mikrosysteme müssen in immer größerer Zahl verfügbar sein, da Laptop, Digitalkamera, Handy & Co. heute alltägliche Gebrauchsgegenstände für jedermann sind und schnell zugunsten des neuesten Modells ausgetauscht werden. Überdies entwickeln Wissenschaftler immer neue Technologien bis zur Serienreife. Entsprechend vermehren sich die Einsatzbereiche für Chips.
- Insbesondere Halbleiter dringen in nie gekannte Leistungsreiche vor. Der Grund: Die Kunden verlangen kleine, handliche Geräte, die immer mehr können – beispielsweise Handys, die Fotos in Kameraqualität schießen, kleine, leichte tragbare Computer, mit denen man telefonieren, Mails verwalten und Kalkulationen erstellen kann, oder Spielekonsolen mit Displays in Kinoqualität. Die Advanced-Packaging-Technologie von SÜSS MicroTec ermöglicht die Produktion von Chips, die wahre Kraftpakete sind.

- Gleichzeitig herrscht enormer Preisdruck. Deshalb müssen die Chip- und MEMS-Produzenten erstklassige Qualität zu sinkenden Stückkosten bieten. Equipment von SÜSS MicroTec sichert den Kunden höchste Präzision und Zuverlässigkeit – was letztendlich zu einem hohen Ausstoß mit geringer Fehlerquote in der Produktion führt. Bei einer solch günstigen Relation dieser beiden Kenngrößen spricht die Fachwelt von hohem „Yield“ bzw. niedriger „Cost of Ownership“ – beides Markenzeichen und Wettbewerbsvorteile von SÜSS MicroTec-Produkten.

- Zunehmendes Umweltbewusstsein führt dazu, dass bleihaltige Elektronikprodukte durch andere ersetzt werden. Blei ist schädlich und giftig, nicht abbau- oder recyclebar. Es verschmutzt erheblich das Grundwasser. In der Europäischen Union und in Japan gibt es die weltweit schärfsten Antibleigesetze, die in Zukunft auch vermehrt umgesetzt werden. Daher haben Produzenten ein Interesse, ihre Produktionsanlagen umzurüsten, um bleifreie Elektronikkomponenten ökonomisch herstellen zu können. Gemeinsam mit IBM hat SÜSS Produktionsgeräte für die C4NP-Technologie entwickelt. Das erlaubt die bleifreie Produktion von Chips – und eine sehr wettbewerbsfähige „Cost of Ownership“.

SÜSS MicroTec hat die Weichen gestellt, um von diesen globalen Trends zu profitieren. Enge, vertrauensvolle Kundenbeziehungen, gefragte Technologien wie Advanced Packaging oder Wafer Bonding und Kooperationen mit bedeutenden Partnern wie IBM eröffnen uns weitere Absatz- und Entwicklungschancen.

F&E-Investitionen zahlen sich aus

Forschung & Entwicklung ist für SÜSS MicroTec von zentraler Bedeutung und legt die Basis für den künftigen Unternehmenserfolg. Jährlich investieren wir erheblich in die Entwicklung neuer Anlagen und Technologien. So können wir uns bei neuen Trends frühzeitig positionieren. Daher schätzen wir auch unseren traditionell hohen Verkaufsanteil an Forschungseinrichtungen und Universitäten, wo heute die Lösungen von morgen entstehen – mit Hilfe von SÜSS-Technologie. Jüngste Erfolge: Die Forschungseinrichtung NanoFab der kanadischen University of Alberta hat unsere neue Wafer-Bonding-Anlage ELAN CB6L ausgewählt.

NanoFab forscht auf den Gebieten Mikro- und Nanotechnik und wird von mehr als 130 Forscherteams aus Hochschulen und der Industrie frequentiert. Das SÜSS-Equipment kommt u. a. in Projekten für Drucksensoren für die Erdölindustrie sowie für drahtlose Übertragungstechnik zum Einsatz. Ein weiterer Vertrauensbeweis einer weltweit anerkannten Forschungseinrichtung kommt aus Südkorea: SÜSS MicroTec liefert einen Mask Aligner MA200Compact an SAIT, die zentrale Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Samsung-Konzerns. Die hohen Qualitätsanforderungen des SAIT erfüllt die SÜSS-Anlage vollständig, etwa eine Justiergenauigkeit von unter 0,5 Mikrometer und eine Durchlaufleistung von mehr als 100 Wafern pro Stunde.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungsinstituten ist SÜSS stets am Puls der Zeit, sieht neue Entwicklungstrends sehr früh und hat so die Chance, die technologische Zukunft seiner Märkte mitzugestalten. In diesem Sinne wurde beispielsweise der neue M-Lock Wafer Bonder entwickelt und bereits der Fachwelt vorgestellt. Die Besonderheit dieses Geräts ist eine Vakuumschleuse, die Kontaminierungen auf den zu bearbeitenden Wafern weitestgehend beseitigt. Dies ist in der Mikrosystem-Produktion extrem wichtig, da jede Verunreinigung die Ausbeute der Produktion senkt. Daher müssen Produktionsgeräte einen möglichst hohen Yield erzielen. Entsprechend positiv wurde die Neuentwicklung auch von unseren Kunden aufgenommen. In diesem Segment erwartet SÜSS MicroTec in den kommenden Jahren eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens.

C4NP – eine erfolversprechende Perspektive

Ein besonderes Ergebnis unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit bietet derzeit Anlass zu hohen Erwartungen: C4NP (Controlled Collapse Chip Connection New Process). IBM hat diese Methode des Wafer Bumpings erfunden und SÜSS MicroTec übernimmt die Entwicklung und den Vertrieb des erforderlichen Produktionsequipments. C4NP hat das Potenzial, zu einem neuen Industriestandard zu werden und das Wafer Bumping in der Halbleiter-Herstellung zu revolutionieren. C4NP ermöglicht den Chipproduzenten, die Chips schneller, effizienter und auch bleifrei herzustellen.

Seit Beginn des gemeinsamen Entwicklungsabkommens mit IBM haben SÜSS MicroTec und IBM an der optimalen Konfiguration für das Produktionsequipment gearbeitet. Vor dem Hintergrund von technologischen Änderungen und der damit einhergehenden Ausweitung des gesamten Projekts wurde im letzten Quartal 2006 mit IBM über diese veränderten Rahmenbedingungen verhandelt. Ein neuer Vertrag trägt nun dem erheblich vergrößerten Projektumfang und den damit verbundenen höheren Aufwendungen von SÜSS Rechnung.

Derzeit läuft die Installation einer ersten Anlage zur vollautomatischen Massenproduktion bei IBM in den USA. Sie soll noch im laufenden Jahr in Betrieb genommen werden. Von diesem Zeitpunkt an hat C4NP das Potenzial, einen bedeutenden Anteil des Wafer-Bumping-Markts zu gewinnen. Die Halbleiterindustrie hat großes Interesse bekundet.

Erfolgreiche Zukunft – auch SÜSS-intern

SÜSS MicroTec investiert in die Leistungsfähigkeit und Motivation seiner Mitarbeiter. Wir überprüfen regelmäßig den Aus- und Weiterbildungsbedarf jedes einzelnen Mitarbeiters in allen Teams und Abteilungen. Auf Basis dieser Ergebnisse entstehen dann konkrete Förderaktivitäten. In 2006 lag unser Hauptaugenmerk nochmals auf der Führungskräfte-Entwicklung und den Mitarbeitern am Standort Garching wurden intensive EDV-Schulungen (Office-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook) angeboten. Die Resonanz war so positiv, dass derartige Schulungen in 2007 auch in Vaihingen durchgeführt werden. Über ein Incentive-System motivieren wir weltweit die Mitarbeiter, so dass bestellte Maschinen schnellstmöglich und genau nach Kundenwunsch ausgeliefert werden können. Zur Sicherung des Nachwuchspersonals arbeitet SÜSS MicroTec erfolgreich mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen: Beispielsweise werden Praktika durchgeführt und Diplomarbeiten begleitet. Außerdem bildet SÜSS MicroTec jedes Jahr Jugendliche in den Berufen Industriekaufmann und Mechatroniker aus.



Damals – schrammen und ärgern

Peinlich, teuer, lästig: Ohne gute Sicht nach hinten kann das Einparken schon einmal böse enden – mit Kratzern und Beulen bei sich und anderen. Da kommen schnell ein paar hundert Euro Schaden zusammen – vom Spott ganz zu schweigen.



Geradezu ein Segen für Besitzer großer Autos ist die elektronische Einparkhilfe, die heute für die meisten PKW serienmäßig oder gegen geringen Aufpreis zu bekommen ist. Sensoren ermitteln den Abstand zum benachbarten Auto und ein Piepsignal ertönt, wenn es langsam eng wird. So gehören Einparkunfälle selbst bei engsten Verhältnissen der Vergangenheit an – schonend für Nerven und Geldbeutel.

Heute – parken und entspannen



Konzernlagebericht und Lagebericht zum 31. Dezember 2006

1. Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

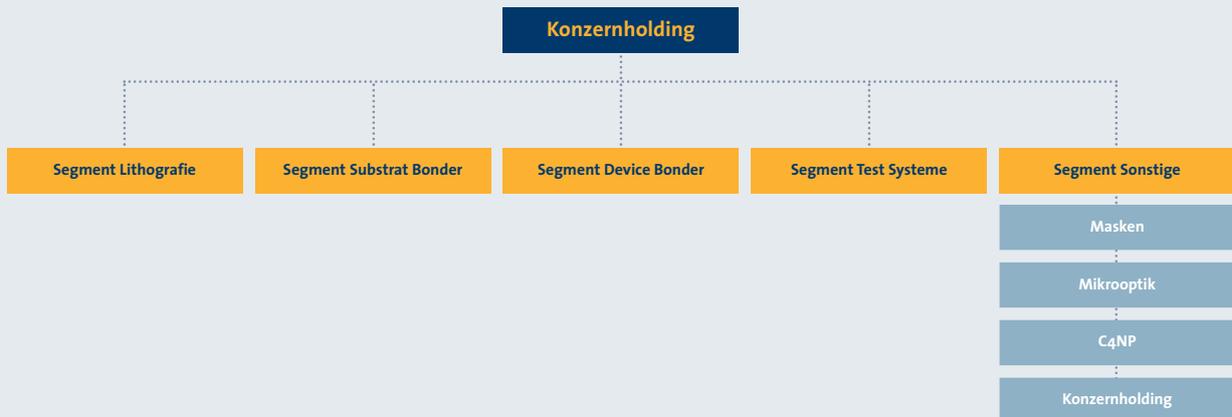
Der SÜSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-systemtechnik.

Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Marktnischen bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem

Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

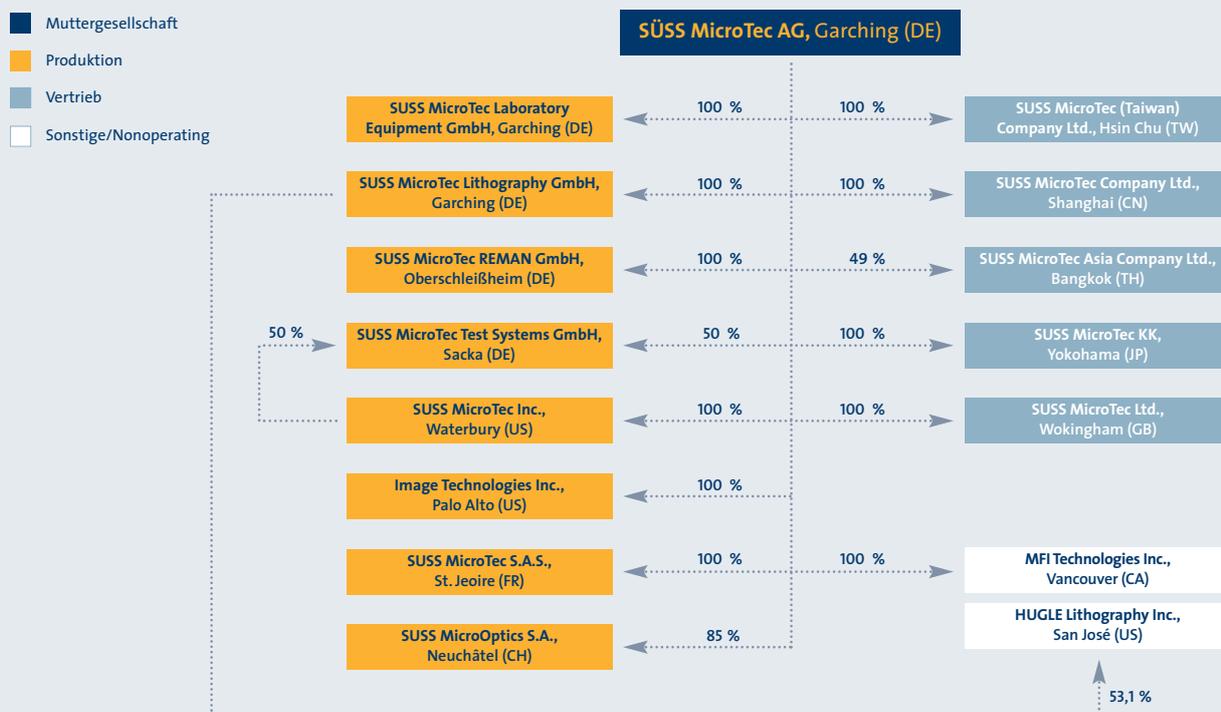
Der Konzern ist in 5 Segmente eingeteilt, wobei das Segment Sonstige aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden.



Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den

Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktions-tätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt unter anderem über Standorte in Deutschland, den USA, Frankreich, Japan, China und Taiwan.

Rechtliche Struktur des Konzerns:



Die SUSS MicroTec REMAN GmbH entstand aus der umfirmierten ehemaligen Karl SÜSS Geschäftsführungs GmbH und beinhaltet das Geschäft mit gebrauchten Produkten der Lithografie. Dieses wurde aus der Gesellschaft SUSS MicroTec Lithography GmbH ausgegliedert.

Daneben bestehen noch geringfügige Beteiligungen bei folgenden Gesellschaften:

- 10 % Zentrum für Technologiestruktur-entwicklung, Glaubitz (DE)
- 10 % ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT)

Diese geringfügigen Beteiligungen haben unwesentliche Bedeutung in Bezug auf das operative Geschäft sowie die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Konzerns.

2. Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und dem Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellkosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Das Segmentergebnis entspricht dabei dem Ergebnis vor Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung und aus Anlagenabgängen, vor Zinserträgen und -aufwendungen sowie vor Ertragsteuern. Es werden keine kalkulatorischen Kostenpositionen verwendet, so dass die Werte für die interne Steuerung direkt auf die veröffentlichten Werte gemäß IFRS-Rechnungslegung übergeleitet werden können.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash-Position (Flüssige Mittel abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Nischen in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Wir wollen durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

3. Forschung und Entwicklung

Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Produkte und Entwicklungen der jeweiligen Segmente bzw. Untereinheiten dargestellt und erläutert.

Lithografie

Der Produktions-Mask Aligner MA200 Compact – 2005 in den Markt eingeführt – erfreute sich 2006 einer starken Nachfrage von Seiten der Produktionskunden. Diese Maschine wurde nun durch ein optionales integriertes „Bake“-Modul erweitert. Das „Bake“-Modul dient dazu, chemisch verstärkte Fotolacke unmittelbar nach der Belichtung durch kontrolliertes Aufheizen zu fixieren, bevor die feinsten Strukturen beginnen können, sich aufzulösen. Im Ergebnis kann nun der Mask Aligner feinere Strukturen erzeugen, welche bislang überwiegend auf den viel teureren Lithografie-Steppern erzeugt wurden.

2006 wurde ebenfalls das optische Prüfgerät DSM200 entwickelt, mit dem SÜSS sein Angebot in Richtung Metrologie und Inspektion erweitert. Das DSM200 ist ein automatisiertes Inspektionsmikroskop für die Fertigungskontrolle. Es ist in der Lage, beide Oberflächen eines strukturierten Wafers abzubilden und die genaue Lage der Muster auf der Vorder- und Rückseite zu vergleichen. Das ist insbesondere wichtig für MEMS-Bausteine wie zum Beispiel Sensoren, wenn beide Seiten des Wafers unabhängig voneinander bearbeitet werden und eine perfekte Lage der auf beiden Seiten erzeugten Muster zueinander für eine hohe Ausbeute in der Produktion wichtig ist.

Wafer Bonder

SÜSS MicroTec hat 2006 die Serie „ELAN“ bei den Wafer Bondern eingeführt – beginnend mit dem ELAN CB6L, der die bisherige SB6e und SB8e ergänzt. Dieses Angebot richtet sich an Forschungseinrichtungen mit kleinem Budget. Diese Produktlinie mit der SÜSS-eigenen „Force Column“-Technologie wird ausgebaut, um auch Hochdruckprozesse für die fortgeschrittene Aufbau- und Verbindungstechnik im Bereich CMOS 3D bereitzustellen. Sie beinhaltet auch das von SÜSS exklusiv entwickelte M-Lock™ Design, das es erlaubt, die Vakuumkammer – in der die Prozesse ablaufen – vollständig gegen die Umgebung in der Produktion abzuschirmen. Das Konzept der „Force Column“ befriedigt gleichzeitig die Anforderungen an hohe Kräfte und homogene Druckverteilung über die Andruckflächen. Dies erlaubt hohe Produktionsausbeuten überall dort, wo Metall mit Metall verbunden werden soll. SÜSS unterstützt auch weiterhin die fortschreitende Fabrikation von MEMS-Bausteinen durch verbesserte Justiergenauigkeit, die für die weitere Verkleinerung der Bausteine unerlässlich wird. Die Strategie von SÜSS bei den Wafer Bondern ist es, die obengenannten Technologien in modularer Form zur Verfügung zu stellen: Dies erlaubt die Übertragung optimierter Prozesse vom Halb- auf den Vollautomaten, der mit der SÜSS MicroTec Dock and Lock™-Technologie zur Verfügung steht.

C4NP

In Kooperation mit IBM hat SÜSS die automatisierte Produktlinie für die Kontaktierung von 300mm-Wafern mit dem C4NP-Prozess bereitgestellt. Dieses System und seine Module machen Gebrauch von SÜSS-eigener Technologie, um Produktionskosten zu senken und Waferkontaktierung in höchster Qualität bei fortlaufendem Betrieb zu ermöglichen. Die C4NP-Methode ist sehr flexibel und erweiterbar, erlaubt den Einsatz bleifreier Legierungen für die Herstellung der Kontakte und vermeidet so die Nachteile, die der Umwelt durch den Gebrauch von herkömmlichen Lötmaterialien entstehen. Die von SÜSS entwickelte Produktionslinie für C4NP bietet das Potenzial der Miniaturisierung von Kontaktabstandsrastern bis weit unter 100 Mikrometer in der Massenproduktion.

Test Systeme

Der Optoprober PA200 BlueRay wurde um ein Loadermodul ergänzt, so dass der Prototyp eines entsprechenden Vollautomaten auf der SEMICON West präsentiert werden konnte. Der Vorteil dieser Konfiguration liegt darin, dass ein Halbautomat zu einem späteren Zeitpunkt zum Vollautomaten ergänzt werden kann. Mit dem Optoprober bedient SÜSS den schnell wachsenden Markt für Leuchtdioden hoher Helligkeit und hat dort eine gute Position bei führenden Herstellern.

Für Zuverlässigkeitstests an Wafern wurde der PM300WLR (WLR steht für Wafer Level Reliability) als Testgerät für 300mm Wafer entwickelt. Mit diesem Gerät kann ein Wafer über lange Zeiten bei hohen Temperaturen elektrisch vermessen werden, um Voraussagen über die Lebensdauer von Bauelementen machen zu können. Für dieses Gerät wurden entsprechende Schutzrechte angemeldet.

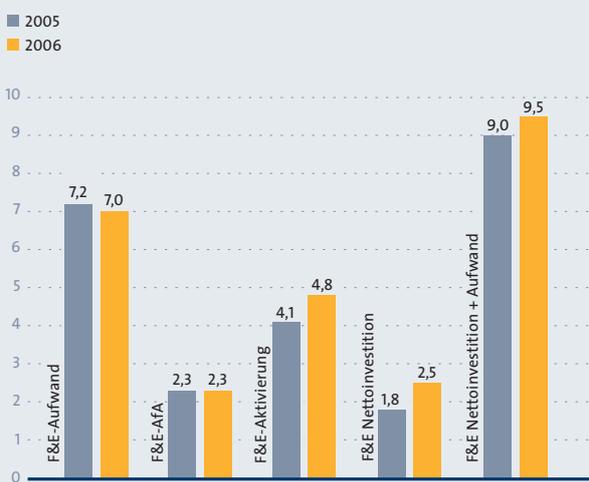
Device Bonder

Die bedeutendste Neuheit, die bei den Device Bondern 2006 in den Markt geliefert wurde, ist der FC300. Er bietet vor allem die Nutzung hoher Andruckkräfte bis zu 400 kg, beginnend bei schon 10 g – abhängig von der Bestückung des Bondkopfes. Diese Maschine kann sowohl als „klassischer“ Bonder als auch mit einer Prozesskammer betrieben werden, die mit einer Säureatmosphäre – auch bei verringertem Druck – gefüllt wird. Die Qualität des Bondprozesses wird dadurch insofern verbessert, als eine bessere elektrische Leitfähigkeit und eine erhöhte mechanische Belastbarkeit der Komponenten zu höherer Zuverlässigkeit führen. Die zulässige Substratgröße schließt Wafer mit 300mm Durchmesser ein. Wird nur der Werkzeugkopf ausgetauscht, ermöglicht die gleiche Maschine die Erzeugung von Strukturen mit Nanoimprinting, sowohl mit der UV-Curing als auch mit der Hot-Embossing-Methode. Dieser modulare Ansatz ermöglicht dem Kunden den schrittweisen Ausbau des Systems und reduziert somit den Aufwand bei der Erstinvestition. Der große Auswahlbereich für die Andruckkraft und die Formate bei den Aufnahmen erlaubt eine enorme Bandbreite in der Auswahl der Komponenten, die bearbeitet werden sollen – kleine Laserdioden für die Optoelektronik genauso wie großflächige Infrarotbildsensoren für modernste Infrarotsichtsysteme.

Der Einsatz einer säurehaltigen Atmosphäre führt zu einer Verringerung der zum Bonden benötigten Kraft und minimiert somit die schädlichen mechanischen Spannungen, die in das Endprodukt eingebracht werden. Dies steigert die Produktionsausbeute und die Qualität jedes einzelnen Endprodukts. Die Nachfrage der Elektro- und Halbleiterindustrie nach der Nutzung einer abgeschlossenen Prozessatmosphäre steigt: SÜSS hat seine prozessorientierte Kompetenz mit diesem innovativen Angebot für eine komplexe Herausforderung in der Produktion erweitert.

F&E-Ausgaben im Jahresvergleich

in Mio. EUR



Die gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen im Jahresvergleich leicht von 9,0 auf 9,5 Millionen Euro. Schwerpunkte innerhalb der Aktivierung von Entwicklungsleistungen sind das Projekt C4NP sowie das Segment Substrat Bonder.

Die Mitarbeiterzahl im Bereich F&E und Prototyping belief sich zum Jahresende 2006 auf 121 Personen (2005: 112; +8 %).

4. Überblick über den Geschäftsverlauf

Im Jahr 2006 konnte die SÜSS-Gruppe nach dem Rekordjahr 2001 erstmals wieder ein positives Jahresergebnis erzielen.

Die Halbleiterindustrie entwickelte sich im abgelaufenen Jahr positiv, sowohl hinsichtlich der Chiphersteller als auch der Chipausrüster. So stieg der Umsatz mit Halbleitern im Vergleich zu 2005 um 9 % auf 248 Mrd. US-Dollar (Quelle: Semiconductor Industry Association – SIA), was einen neuen Rekordwert darstellt. Treiber des Wachstums waren laut SIA vor allem Mobiltelefone, MP3-Player und HDTV-Geräte. Von diesem Wachstum profitierten auch die Chipausrüster: Der Umsatz von Maschinen für die Halbleiterindustrie stieg 2006 ebenfalls an. Hier konnte der Umsatz sogar noch stärker, um 24 % auf 41 Mrd. US-Dollar (Quelle: Semiconductor Equipment and Materials International – SEMI) gesteigert werden. Gestützt wurde der positive Trend von der gesunden Entwicklung der Weltwirtschaft, die, getrieben durch das starke Wachstum in Asien, im Jahr 2006 um 5 % gewachsen ist (Quelle: Deutsche Bank AG).

Darüber hinaus haben sich unsere Produkte für Anwendungen der Mikrosystemtechnik ebenfalls sehr gut entwickelt. Zudem wurden die wichtigsten Restrukturierungsmaßnahmen 2005 abgeschlossen, so dass die operative Performance des Jahres 2006 nicht durch wesentliche Sondereffekte beeinflusst wurde.

Zusammenfassend sind wir mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2006 sehr zufrieden, da neben der sehr guten Entwicklung des angestammten Kerngeschäfts auch in neuen Geschäftsfeldern, insbesondere Substrat Bonding und C4NP, wichtige Fortschritte verzeichnet werden konnten.

Der Umsatz im Konzern stieg um 32,3 % von 117,5 auf 155,5 Mio. EUR. Beim Auftragseingang belief sich die Steigerung auf 13,5 % von 135,6 auf 153,8 Mio. EUR. Hinsichtlich der Währungsentwicklung sind die Effekte auf Umsatz und Auftragseingang, ähnlich wie im Vorjahr, zu vernachlässigen. Der beim US-Dollar verwendete Durchschnittskurs veränderte sich nur geringfügig. Somit spiegeln die Zahlen auch währungsbereinigt die operative Entwicklung wider. Der japanische Yen hat für den SÜSS-Konzern im Vergleich zum US-Dollar eine wesentlich geringere Bedeutung.

Jedoch ergaben sich aufgrund des deutlich schwächeren US-Dollars zum Bilanzstichtag (1,32 USD/1,00 EUR zum 31.12.2006 gegenüber 1,18 zum 31.12.2005) Buchverluste aus der Stichtagsbewertung von USD-Fremdwährungsaktiva bzw. -passiva; eine gegensätzliche Entwicklung im Vergleich zu 2005.

Umsätze und Auftragslage in den Regionen

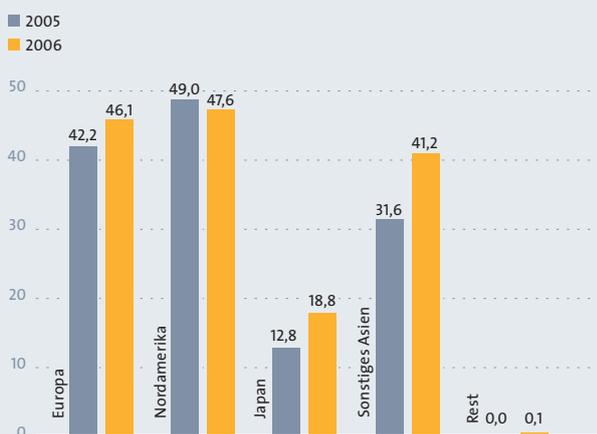
In Europa, Nordamerika und Japan liegen die Schwerpunkte in den Bereichen Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Test Systeme. Die Schwankungen des Geschäftsverlaufs sind hier weniger ausgeprägt als bei dem Markt Advanced Packaging. Hier bedienen wir vor allem asiatische Kunden außerhalb Japans. Diese Unterschiede reflektiert auch die Entwicklung der Umsätze und Auftragseingänge in den Regionen im Geschäftsjahr 2006. Das Wachstum wurde im Wesentlichen in der Region Asien generiert, wo eine erkennbare Ausweitung der Kapazitäten für Advanced Packaging-Applikationen stattfand. Japan entwickelte sich sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang sehr erfreulich.

Auftragseingänge

In Europa konnte der Auftragseingang im Jahresvergleich um 9 % gesteigert werden. Neben Mask Alignern (Segment Lithografie) trugen vor allem die Segmente Device Bonder und Substrat Bonder zu diesem Wachstum bei, während sich die Coater (ebenfalls dem Segment Lithografie zugeordnet) nach einem außergewöhnlich guten Auftragseingang 2005 im abgelaufenen Jahr 2006 deutlich rückläufig entwickelten. In Nordamerika reduzierte sich der Wert neuer Aufträge um 3 %. Steigerungen bei den beiden Bonder-Produktlinien, analog zur Entwicklung in Europa, standen rückläufige Auftragseingänge, insbesondere bei den Mask Alignern und den Test Systemen, gegenüber. Der Zuwachs von 47 % in Japan ist auf die Produktlinien Substrat Bonder und Coater, hier vor allem auf die halbautomatische Lösung „Gamma“, zurückzuführen. Das restliche Asien, als vorrangiger Wachstumstreiber für das gestiegene Auftragsvolumen, erreichte 2006 einen Zuwachs um 31 %. Größtenteils waren die Mask Aligner für diese positive Entwicklung verantwortlich.

Entwicklung der Auftragseingänge nach Regionen

in Mio. EUR

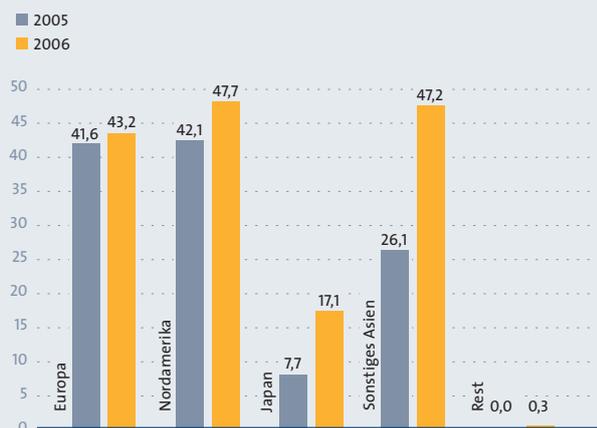


Umsätze

Bedingt durch den hohen Auftragsbestand zu Jahresbeginn fiel die Umsatzsteigerung in den Regionen meist deutlicher aus, als dies beim Auftragseingang der Fall war. Während in Europa die Test Systeme und Mask Aligner hauptsächlich zum Wachstum von 4 % beitrugen, trug in Nordamerika das Umsatzwachstum bei den Substrat Bondern erheblich zu den um 13 % gestiegenen Umsätzen bei. Der Anstieg um 123 % in Japan ist vor allem auf die geringe Umsatzbasis des Jahres 2005 zurückzuführen. Vor allem die Produktlinien des Segments Lithografie, Mask Aligner und Coater, konnten nach schwachen Werten in 2005 wieder angemessene Umsatzgrößen erreichen. Im restlichen Asien erreichte das Umsatzwachstum 81 %. Den größten Anteil daran hatte die Produktlinie Coater, bei der zu Jahresbeginn ein erheblicher Auftragsbestand vorlag, der im Verlauf des Jahres 2006 abgearbeitet wurde.

Entwicklung der Umsätze in den Regionen

in Mio. EUR



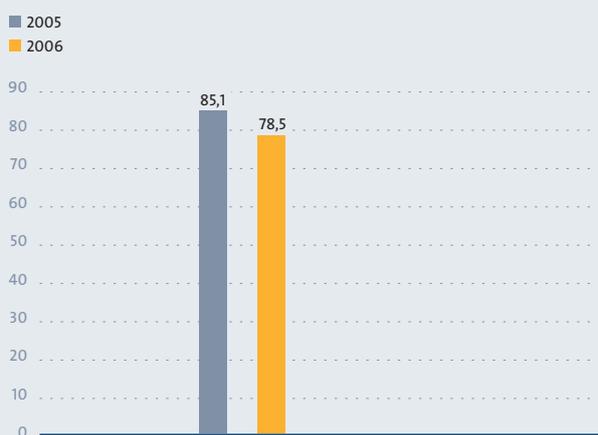
Auftragsbestand in der Gruppe

Das Verhältnis zwischen neu eingegangenen Aufträgen und realisierten Umsätzen (Book-to-bill-Ratio) lag 2006 bei 0,99 (2005: 1,15).

Der Auftragsbestand enthält üblicherweise Aufträge, die in den kommenden 5 bis 9 Monaten umsatzwirksam werden. Diese Zeitspanne beinhaltet neben der reinen Produktionszeit (in der Regel bis zu 6 Monate) auch den Abnahmeprozess (in der Regel bis zu 3 Monate nach Lieferung).

Auftragsbestand der Gruppe

in Mio. EUR



Der Auftragsbestand zum Jahresende 2006 lag um 8 % unter dem Vorjahreswert. Während der Auftragsbestand in Europa im Jahresvergleich anstieg, entwickelte sich dieser insbesondere in Nordamerika und im sonstigen Asien rückläufig.

Im Auftragsbestand per Ende 2006 sind Aufträge in Höhe von 5,4 Mio. EUR enthalten, bei denen wir nicht von einer Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2007 ausgehen.

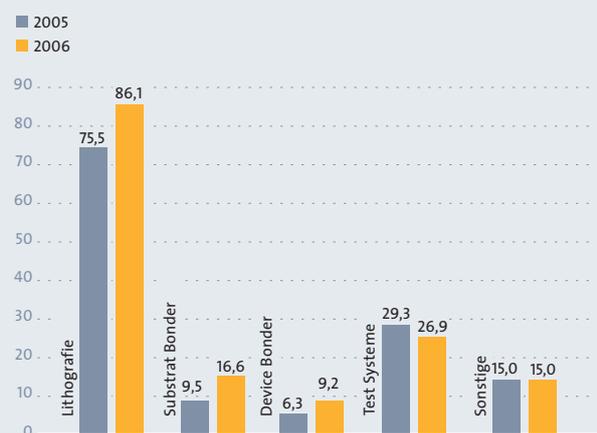
Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten:

Überblick

Sowohl bei den Umsätzen als auch beim Auftragseingang war die Lithografie der Treiber für die positive Entwicklung 2006. Darüber hinaus ist die Ausweitung des Geschäfts mit Substrat Bondern sehr wichtig, da wir bei diesem Segment mittelfristig ein überproportionales Wachstum erwarten.

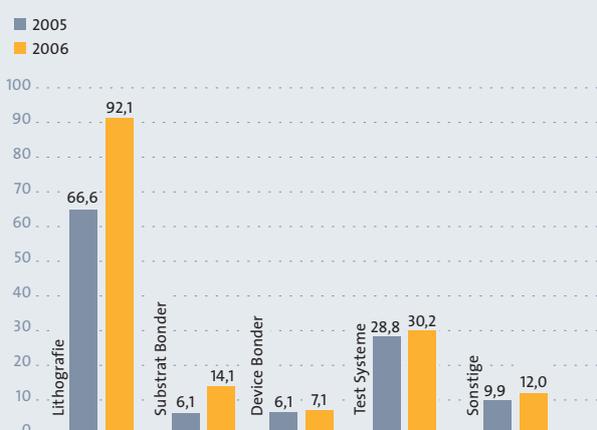
Auftragseingang nach Segmenten

in Mio. EUR



Umsätze nach Segmenten

in Mio. EUR



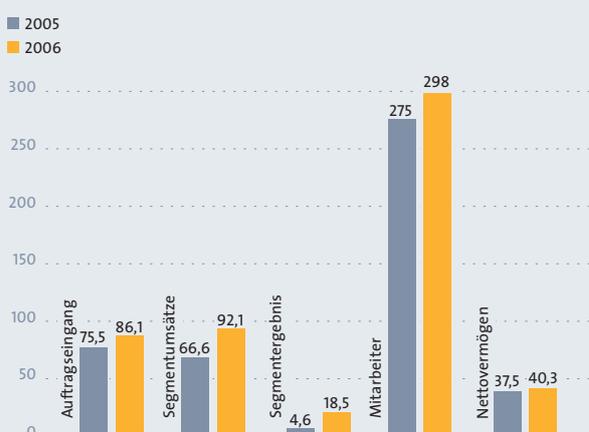
Lithografie

Das Segment Lithografie beinhaltet Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner und Coater und ist in Deutschland vor allem an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wichtige Teile der Vertriebsorganisation in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging stark vertreten.

Die Lithografie konnte 2006 ein erneutes Wachstum beim Auftragseingang verzeichnen. Insbesondere die Mask Aligner trugen zum Wachstum bei. Hinzu kamen Aufträge für sogenannte Lithocluster-Systeme, die in der LED-Produktion eingesetzt werden und deutliche Zuwächse beim Auftragsvolumen für Ersatzteile. Die Coater entwickelten sich leicht rückläufig. Insgesamt wurden in 2006 Aufträge im Wert von 86,1 Mio. EUR gebucht nach 75,5 Mio. EUR im Vorjahr (+14 %). Beim Umsatz hingegen lieferten die Coater die größten Umsatzanteile und wiesen auch das stärkste Wachstum auf. Aber auch bei den Mask Alignern konnten die Umsätze spürbar ausgeweitet werden, so dass sich in Summe ein durchgehend positives Bild ergibt. Der Segmentumsatz erreichte in 2006 92,1 Mio. EUR (Vorjahr: 66,6 Mio. EUR), eine Steigerung um 38 %.

Segmentübersicht Lithografie

(in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Das Umsatzwachstum schlug sich auch im Segmentergebnis nieder, welches sich aufgrund der damit verbundenen Skaleneffekte erheblich verbesserte. So belief sich das Segmentergebnis auf 18,5 Mio. EUR nach 4,6 Mio. EUR im Vorjahr. Die Rohertragsmarge stieg von vormals 44,2 % in 2005 auf 45,9 % an.

Der Anstieg des Segmentvermögens (netto) von 37,5 Mio. EUR in 2005 auf 40,3 Mio. EUR in 2006 ist im Wesentlichen auf deutlich verringerte Kundenanzahlungen zurückzuführen. Diese reduzierten sich um 5,9 Mio. EUR von 17,6 auf 11,7 Mio. EUR. Gegenläufig konnte der Lagerbestand nochmals reduziert werden. Zum Ende 2006 betrug der Lagerbestand 29,1 Mio. EUR (Vorjahr: 31,6 Mio. EUR; -8 %). Der Aufbau der Mitarbeiterzahl von 275 auf 298 trägt dem erheblichen Umsatzwachstum Rechnung.

Substrat Bonder

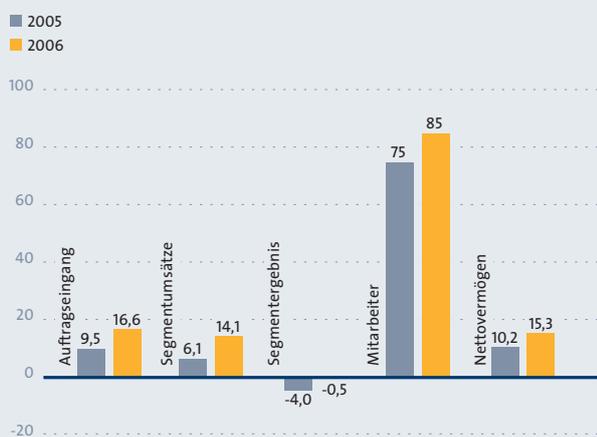
Das Segment Substrat Bonder ist hinsichtlich Entwicklung und Produktion am Standort Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus in kleinen Einheiten an wesentlichen Standorten in Europa und in Asien ansässig.

Wesentliche Produkte sind manuelle Geräte zum Bonden von 6 und 8 Zoll großen Substraten. Darüber hinaus gibt es noch Maschinen mit höherer Automatisierung für die Produktion mit dem Schwerpunkt auf 8 Zoll-Anwendungen.

Die Wachstumspotenziale für dieses Segment konnten im Jahr 2006 erkennbar unter Beweis gestellt werden. Der Auftragszugang stieg um 75 % auf 16,6 Mio. EUR (2005: 9,5 Mio. EUR), was wir neben dem Wachstum der Applikationen auch auf den Ausbau von Marktanteilen zurückführen. Der Umsatz stieg noch stärker von 6,1 Mio. EUR auf 14,1 Mio. EUR (+133 %). Die Umsatzentwicklung war durch einen hohen Auftragsbestand zu Jahresbeginn 2006 begünstigt.

Segmentübersicht Substrat Bonder

(in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Das Segmentergebnis verbesserte sich von - 4,0 Mio. EUR im Vorjahr auf - 0,5 Mio. EUR in 2006. Bei der Rohermargine konnte eine Verbesserung von 10,1 % in 2005 auf 38,2 % festgestellt werden – neben der Verbesserung bei der Auslastung vor allem ein

Ergebnis der Stabilisierung des noch jungen Produktportfolios. Die Overheadstrukturen wurden weiter aufgebaut, um eine weltweite Infrastruktur vor allem für die Produktionskunden bereitstellen zu können. Daher wurde der Break-even in diesem Segment noch nicht erreicht.

Die Intensität in der Produktentwicklung ist weiterhin hoch; die Ausgaben für F&E gingen zwar im Jahresvergleich zurück (1,4 Mio. EUR nach 1,8 Mio. EUR im Vorjahr; -22 %), befinden sich aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Im Blickpunkt steht weiterhin eine Vervollständigung des Portfolios, um für alle gängigen Bonding-Anwendungen eine Produktlösung anbieten zu können.

Das Segmentvermögen (netto) stieg deutlich von 10,2 Mio. EUR auf 15,3 Mio. EUR. Der Anstieg des Lagers um 4,0 Mio. EUR auf 13,4 Mio. EUR und der Forderungen (4,8 Mio. EUR nach 2,3 Mio. EUR) reflektiert dabei vor allem den Anstieg des Working Capital aufgrund des Wachstums des Geschäftsvolumens.

Device Bonder

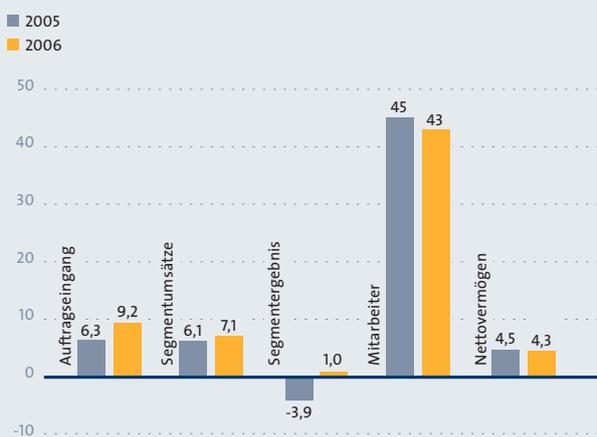
Das Segment Device Bonder ist in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes sind keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Dank der verbesserten Auftragssituation zeigte dieses Segment im Jahr 2006 auf Basis einer reduzierten Kostenbasis eine deutlich bessere Ergebnisperformance. In dem weiterhin sehr engen Marktumfeld konnten ein Umsatzanstieg von 6,1 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR (+16 %) und ein positives Segmentergebnis (1,0 Mio. EUR nach -3,9 Mio. EUR; inklusive Sondereffekte in Höhe von -3,6 Mio. EUR im Vorjahr) erzielt werden.

Der Auftragszugang betrug im abgelaufenen Jahr 9,2 Mio. EUR (Vorjahr: 6,3 Mio. EUR; +46 %).

Segmentübersicht Device Bonder

(in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Die Rohertragsmarge verbesserte sich von 32,5 % im Vorjahr auf 55,5 %. Dieser Anstieg wurde zu einem erheblichen Teil durch den Abverkauf teilweise wertberichtigter Bestände beeinflusst.

Das Segmentvermögen (netto) blieb nahezu unverändert.

Wir gehen davon aus, dass eine langfristige Lösung für dieses Segment im Verlauf des Jahres 2007 gefunden werden kann. Die Synergieeffekte mit den anderen Segmenten des Konzerns sind gering, und eine ausreichende Perspektive zur Erreichung einer relevanten Umsatzgröße sehen wir nur im Verbund mit anderen Produkten, die nicht im Portfolio des SÜSS-Konzerns enthalten sind.

Test Systeme

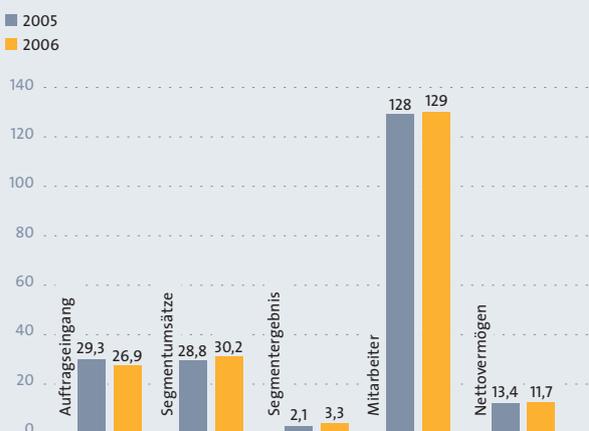
Dieses Segment stellt rund ein Fünftel des Geschäftsvolumens der Gruppe dar und ist in Sacka bei Dresden angesiedelt. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind hauptsächlich dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment.

Die Test Systeme zeichnen sich vor allem durch eine weniger zyklische Geschäftsentwicklung aus. Mit unseren Probern adressieren wir hauptsächlich Laboranwendungen, insbesondere z.B. die Fehleranalyse, aber auch teilweise Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme).

Der Auftragseingang ging im abgelaufenen Geschäftsjahr von 29,3 Mio. EUR auf 26,9 Mio. EUR zurück (-8 %). Bei den Umsätzen hingegen konnte ein Zuwachs erzielt werden. Dieser erreichte 30,2 Mio. EUR nach 28,8 Mio. EUR im Vorjahr (+5 %).

Segmentübersicht Test Systeme

(in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Die Verbesserung des Segmentergebnisses ist – neben den höheren Umsätzen – einer sich wieder erholenden Rohertragsmarge zu verdanken: Während im Jahr 2005 nur eine Marge von 39,6 % erreicht wurde, stieg dieser Wert 2006 wieder auf 42,9 %. Die relativ konstanten Kosten für Verwaltung und Vertrieb sowie F&E-Aufwendungen ließen das Segmentergebnis von 2,1 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR anwachsen.

Die Verringerung des Segmentvermögens (netto) beruht hauptsächlich auf reduzierten Forderungsbeständen. Diese betragen 5,1 Mio. EUR nach 6,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die Lagerbestände reduzierten sich leicht von 7,8 Mio. EUR auf 7,4 Mio. EUR.

Segment Sonstige

Das Segment Sonstige beinhaltet vor allem unser Geschäft mit den Masken für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien, USA). Daneben sind unsere Aktivitäten in der Mikrooptik (Neuchatel, Schweiz) und sonstige Bereiche zugeordnet. Auch das Geschäftsfeld C4NP ist derzeit in diesem Segment berücksichtigt. Sobald C4NP für den Konzern eine entsprechende Bedeutung im operativen Geschäft erreicht, werden wir hierfür ein

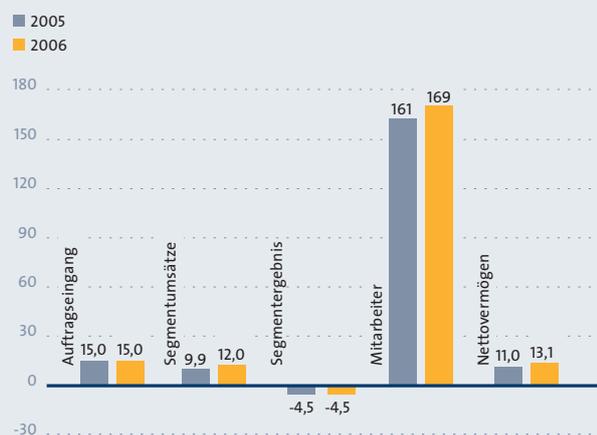
eigenes Segment bilden. Zum aktuellen Zeitpunkt trägt C4NP jedoch noch keine Umsätze bei, so dass bis auf Weiteres keine gesonderte Darstellung erfolgt. Ebenfalls enthalten sind die nicht auf die Segmente zuordenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Einen Großteil der Verwaltungsaufwendungen und damit auch des negativen Segmentergebnisses stellen die Aufwendungen der Konzernholding dar.

Der Bereich Mikrooptik konnte den Umsatz auf über 3,0 Mio. EUR verdoppeln. Auch das Betriebsergebnis stieg von 0,1 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR. Beim Maskengeschäft stieg der Umsatz nur marginal; dagegen verbesserte sich das Betriebsergebnis aufgrund geringerer Herstellkosten und reduzierter Verwaltungskosten um rund 1 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR.

Das Betriebsergebnis der zentralen Konzernfunktionen verschlechterte sich von -4,9 Mio. EUR auf -6,5 Mio. EUR. Gestiegene Verwaltungskosten im Jahr 2006 sowie einmalige Erträge im Jahr 2005 waren für die Ausweitung des Verlusts verantwortlich.

Segmentübersicht Sonstige

(in Mio. EUR bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)



Der Segmentverlust blieb nahezu konstant. Der Anstieg beim Segmentvermögen (netto) ist vor allem auf den gestiegenen Lagerbestand aufgrund des bestehenden Auftrags von der IBM Corp. sowie auf aktivierte Entwicklungsleistungen für C4NP zurückzuführen.

5. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

2006 wurde der Turnaround bei der Ertragslage erreicht. Während im Vorjahr nur das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) einen positiven Wert aufweisen konnte, gestaltete sich 2006 auch das Jahresergebnis (EAT) deutlich positiv. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung war der deutlich gestiegene Umsatz und der damit verbundene Anstieg des Rohertrags. Dies zeigt sich vor allem bei der Ergebniskennziffer EBIT – der Wert verbesserte sich von -4,2 Mio. EUR auf 16,0 Mio. EUR.

Entwicklung wesentlicher Ergebniskennzahlen

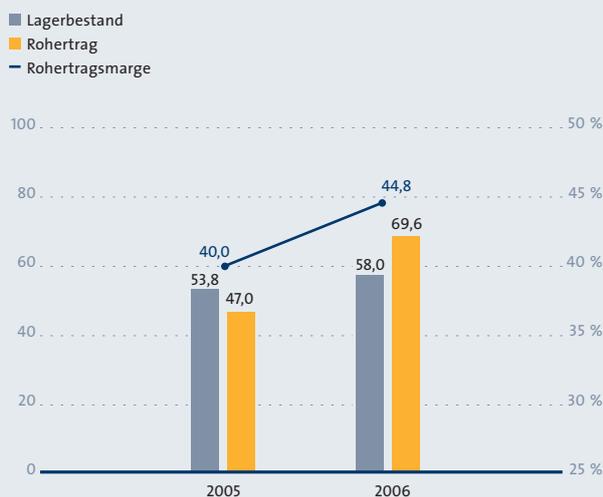
in Mio. EUR



Die höhere Auslastung im Konzern führte darüber hinaus zu einer Verbesserung der Rohertragsmarge, wobei neben der auslastungsbedingten Fixkostendegression folgende Faktoren für den Anstieg verantwortlich waren:

- Verbesserter Rohertrag bei den Substrat Bondern aufgrund Umsatzsteigerung und weiterer Lernkurveneffekte
- Abverkauf von teilweise wertberichtigten Maschinen im Segment Device Bonders
- Im Vergleich zu 2005 deutlich gesteigener Umsatzanteil von margenträchtigen Aufträgen für das Advanced Packaging

Entwicklung des Lagerbestands und des Rohertrages in Mio. EUR sowie der Rohertragsmarge in % vom Umsatz



Innerhalb der Produktlinien konnte vor allem das Segment Substrat Bonder in der Gesamtjahresbetrachtung Fortschritte bei der Entwicklung der Rohertragsmarge verzeichnen. Bei entsprechender Ausweitung des Geschäfts sind wir zuversichtlich, auch in diesem Segment Rohertragsmargen von über 40 % erreichen zu können.

Der Lagerbestand erhöhte sich von 53,8 Mio. EUR zum Jahresende 2005 um 7,7 % auf 58,0 Mio. EUR zum Jahresende 2006. Neben dem Anstieg im Segment Substrat Bonder, bedingt durch das wachsende Geschäftsvolumen, ist der Auftrag von IBM für unser Zukunftsprodukt C4NP für den Lageraufbau mitverantwortlich. Insgesamt ist die Lagerentwicklung nicht zufriedenstellend. Daher wird im laufenden Jahr 2007 ein Fokus auf der kritischen Würdigung der Lagerentwicklung in den einzelnen Segmenten liegen.

Entwicklung der Overheadkosten

in Mio. EUR und in % vom Umsatz



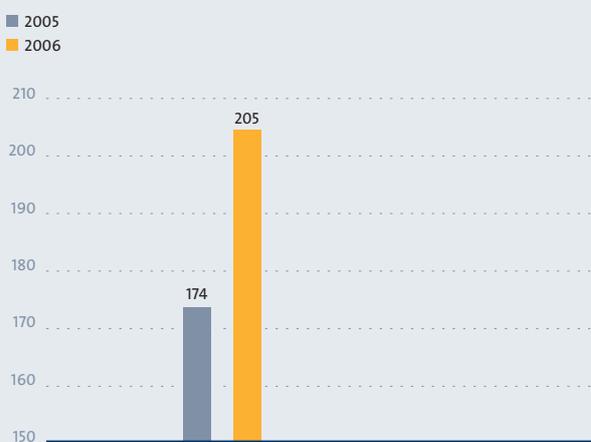
Die Kosten für Verwaltung und Vertrieb stiegen im Jahresvergleich um 3,7 % an. Unter Berücksichtigung des hohen Umsatzwachstums ist dieser Anstieg gering und unter anderem auf den Personalaufbau in diesen beiden Bereichen zurückzuführen (Verwaltung +7 Mitarbeiter, Vertrieb +28 Mitarbeiter).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen sind Buchverluste auf konzerninterne Fremdwährungskredite in Höhe von 1,5 Mio. EUR enthalten, die durch die Abschwächung des US-Dollars und des Yen im Jahr 2006 entstanden sind. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Beim Steueraufwand wirkte sich die Nutzung von wertberichtigten Verlustvorträgen positiv auf die Steuerquote aus. Hinzu kam eine Wertaufholung auf vormals durchgeführte Wertberichtigungen auf aktive latente Steueransprüche sowie die Aktivierung von Körperschaftsteuerguthaben in Deutschland.

Nettoumsatz je Mitarbeiter

in TEUR



Letztendlich ergab sich im Konzern ein Jahresergebnis in Höhe von 14,9 Mio. EUR (2005: -8,2 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,88 EUR nach -0,52 EUR im Vorjahr.

Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,8 % von 174 TEUR auf 205 TEUR.

Finanz- und Vermögenslage

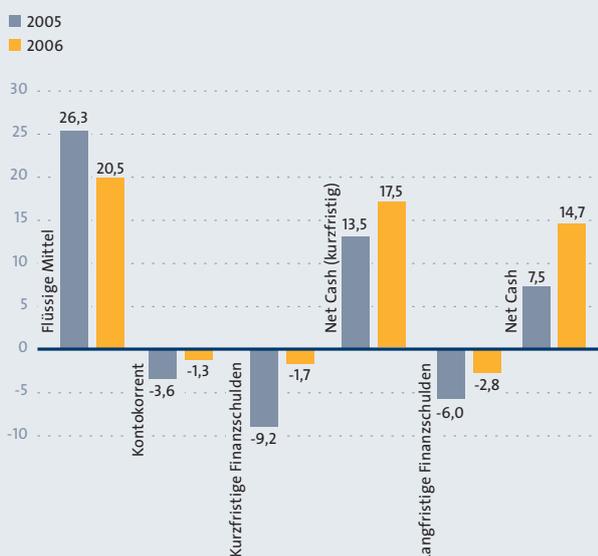
Unser Ziel, stets eine ausreichende kurzfristige Liquiditätsreserve für das operative Geschäft zu halten, wurde auch im Jahr 2006 deutlich erreicht. Neben dem Bestand an Barmitteln verfügt der Konzern über Kreditlinien in Höhe von insgesamt 17 Mio. EUR, die größtenteils an sogenannte „Financial Covenants“ gebunden sind. Die Inlandskreditlinie im Rahmen eines Bankenkonsortiums beträgt 12 Mio. EUR und ist banküblich besichert.

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2006 war neben dem Zufluss aus dem operativen Geschäft (operativer Cashflow: 14,4 Mio. EUR gegenüber 7,0 Mio. EUR im Vorjahr; +107 %) vor allem durch Tilgungsleistungen für Finanzschulden geprägt. So wurde zum einen der Restbetrag der Wandelanleihe getilgt, zum anderen wurden bei bestehenden langfristigen Darlehen Sondertilgungen geleistet, um die vertraglichen Vereinbarungen zugunsten des Unternehmens anzupassen. Insgesamt wurden netto 13,3 Mio. EUR getilgt, was auch den Rückgang der Bankguthaben um knapp 6 Mio. EUR erklärt.

Die Net Cash-Position – der Saldo aus Geldmitteln und Finanzschulden – hat sich im Jahresverlauf erheblich verbessert. Der schon zum Jahresende 2005 vorhandene positive Saldo von 7,5 Mio. EUR konnte 2006 auf 14,7 Mio. EUR gesteigert werden. Der Konzern verfügt damit über finanziellen Spielraum, um große Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Entwicklung der Bankguthaben und Finanzschulden

in Mio. EUR



Neben dem Goodwill bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten die langfristigen Vermögenswerte. Der Goodwill ist den Segmenten Lithografie (13,6 Mio. EUR, 2005: 13,6 Mio. EUR), Test Systeme (4,3 Mio. EUR, 2005: 4,6 Mio. EUR) und dem Maskengeschäft im Segment Sonstige (4,8 Mio. EUR, 2005: 5,4 Mio. EUR) zugeordnet. Bei den immateriellen Vermögenswerten repräsentiert derzeit das Projekt „C4NP“ mit 5,7 Mio. EUR (2005: 3,3 Mio. EUR) aktivierten Entwicklungskosten den größten Einzelposten. Auch war dieses Projekt mit einem Zuwachs von 2,4 Mio. EUR gegenüber 2005 für die Veränderung der Position „Entwicklungskosten“ (11,7 Mio. EUR gegenüber 9,6 Mio. EUR 2005) verantwortlich. Darüber hinaus sind jeweils aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,9 Mio. EUR für die Segmente Lithografie und Substrat Bonder enthalten. Ferner sind Restbuchwerte von 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 3,5 Mio. EUR) für erworbene Lizenzen und Patente des Segments Lithografie enthalten.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe nur in sehr begrenztem Maß über eigene Immobilien verfügt beziehungsweise auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Das Sachanlagevermögen veränderte sich nur unwesentlich und ging von 5,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 4,9 Mio. EUR zurück. Die latenten Steueransprüche erhöhten sich im Geschäftsjahr um 1,8 Mio. EUR und belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 9,2 Mio. EUR. Der Zuwachs beruht insbesondere auf einer anteiligen Wertaufholung aufgrund der Bewertung der voraussichtlich nutzbaren Verlustvorträge.

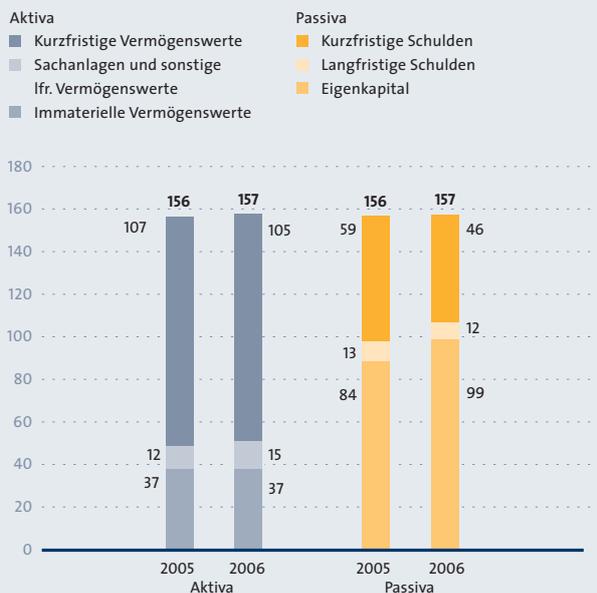
Zusammenfassend ergaben sich, abgesehen von dem wichtigen Projekt C4NP und der geänderten Bewertung bei den nutzbaren Verlustvorträgen, bei den langfristigen Vermögenswerten keine wesentlichen Veränderungen.

Innerhalb des Working Capital haben sich im abgelaufenen Jahr wesentliche Positionen deutlich verändert. Zum einen erhöhte sich, wie schon zuvor erwähnt, der Lagerbestand (zum Bilanzstichtag von 53,8 Mio. EUR in 2005 auf 58,0 Mio. EUR). Zum anderen reduzierten sich die Kundenanzahlungen um 4,0 Mio. EUR.

Aufgrund der hohen Tilgungsleistungen und des erhöhten Eigenkapitals hat sich die Bilanzstruktur auf der Passivseite sichtbar verändert. In der Konsequenz erhöhte sich die Eigenkapitalquote im Jahresvergleich von 54 % auf nun 63 %.

Bilanzstruktur Konzern

in Mio. EUR



Investitionen

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 2 bis 3 % des Umsatzes bewegen werden. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Fotomasken“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Der größere Anteil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht. Dominierendes Projekt war auch 2006 die Fertigungsentwicklung einer kommerziellen C4NP-Linie, die aus mehreren Maschinen besteht.

Wir gehen langfristig davon aus, dass rund 25 bis 35 % der Ausgaben für Forschung und Entwicklung aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Die Holding – SÜSS MicroTec AG

(Hinweis: Den Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Investor Relations-Abteilung.)

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für die Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften. Wie im Falle C4NP geschehen, übernimmt die Holding auch Prinzipalfunktion, soweit dies aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen sinnvoll erscheint.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften oder Lizenzeinnahmen aus Patenten und Rechten.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding

in TEUR (nach dt. Handelsrecht):

	2006	2005	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag	-1.922	-545	-1.377	-253 %
Eigenkapital	98.364	99.171	-807	-1 %
Bilanzsumme	108.565	115.837	-7.272	-6 %
EK-Quote in %	91 %	86 %		
Anlagevermögen	70.021	77.877	-7.856	-10 %
... % der Bilanzsumme	64 %	67 %		
Umlaufvermögen	38.544	37.961	583	2 %
... % der Bilanzsumme	36 %	33 %		

Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage

Der Rückgang der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultierte im Wesentlichen aus planmäßigen Tilgungen in Höhe von 7,1 Mio. EUR.

Die kurzfristigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich um 7,9 Mio. EUR. Der Aufbau der kurzfristigen Forderungen ist hauptsächlich auf die Tochtergesellschaften in Waterbury, USA, und Japan zurückzuführen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten nahmen im Geschäftsjahr um 7,2 Mio. EUR ab, was vor allem auf die Tilgung von Finanzschulden zurückzuführen ist.

Die Finanzschulden wurden im Verlauf des Jahres 2006 erheblich reduziert. Die einzelnen Tilgungsleistungen gliedern sich wie folgt:

Der mit der IBM Deutschland Kreditbank GmbH geschlossene Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von 3,4 Mio. EUR zur Finanzierung der Entwicklungsarbeiten für C4NP wurde im Geschäftsjahr 2006 vollumfänglich getilgt. Die 2006 angefallene Tilgung betrug dabei netto 2,5 Mio. EUR.

Vertragsgemäß hat die Gesellschaft zum 30. April 2006 den letzten Teilbetrag aus der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe in Höhe von 3,6 Mio. EUR zurückgezahlt. Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Anleihen auf insgesamt 0,4 Mio. EUR, der ausschließlich der Optionsanleihe zuzuordnen ist. Die Wandelanleihe ist vollständig getilgt.

Die Veränderung des Eigenkapitals (-0,8 Mio. EUR) resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres (1,9 Mio. EUR), dem Zuführungen zum gezeichneten Kapital und zur Kapitalrücklage (gesamt 1,1 Mio. EUR) aufgrund ausgeübter bzw. bestehender Aktienoptionen gegenüberstehen.

Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2006 ein Jahresfehlbetrag von 1,9 Mio. EUR (Vorjahr: -0,5 Mio. EUR).

Aufgrund des vorhandenen Ergebnisabführungsvertrags mit der SÜSS MicroTec Test Systems GmbH, Sacka, wurden bei der Holding 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR) ergebniswirksam vereinnahmt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,6 Mio. EUR enthalten. (Vorjahr: Fremdwährungsgewinne in Höhe von 3,2 Mio. EUR sowie periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten überwiegend die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR) im Rahmen des C4NP-Projekts sowie Fremdwährungsverluste in Höhe von 2,6 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR). Die Kosten aus selbst erbrachten Entwicklungsleistungen werden gemäß den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften nicht aktiviert.

Infolge der erheblich reduzierten Finanzschulden der SÜSS MicroTec AG gingen die Zinsaufwendungen im Geschäftsjahr um 1,0 Mio. EUR zurück.

In der SÜSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschäftsjahres 2006 17 (Vorjahr: 16) Mitarbeiter und zwei Vorstände aktiv tätig.

Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften sowie des C4NP-Projekts ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding

und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem soll die SÜSS MicroTec AG künftig am Erfolg des C4NP-Projekts partizipieren, das im Auftrag der Holding von mehreren Tochtergesellschaften entwickelt wird.

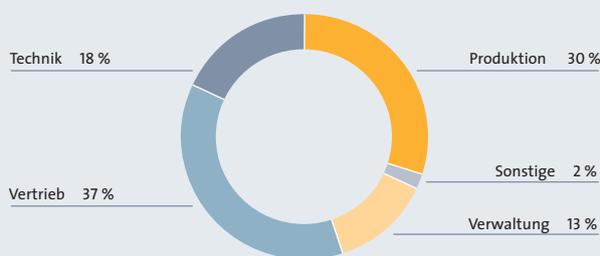
Mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Mit dem Charakter eines Spezialmaschinenherstellers geht auch die Verteilung der Mitarbeiter nach Bereichen einher. Da in vielen Fällen sehr kundenspezifische Maschinen gebaut werden bzw. erhebliche Anpassungen an einen Standardtyp erforderlich sind, benötigt das Unternehmen im Vertriebsbereich erhebliche technische Kapazitäten und Kompetenzen. Darüber hinaus ist eine ausreichende Entwicklungsabteilung erforderlich, um neben den klassischen Projekten der Produktentwicklung auch für aktuelle Kundenaufträge die vereinbarten Spezifikationen in das Equipment zu integrieren. Letztlich sind auch die Anforderungen an die Wartung dieser Maschinen hoch, so dass auch adäquate Servicepräsenz gewährleistet werden muss. Daher repräsentieren die Funktionsbereiche Vertrieb und Technik mehr als die Hälfte der Mitarbeiter im Konzern.

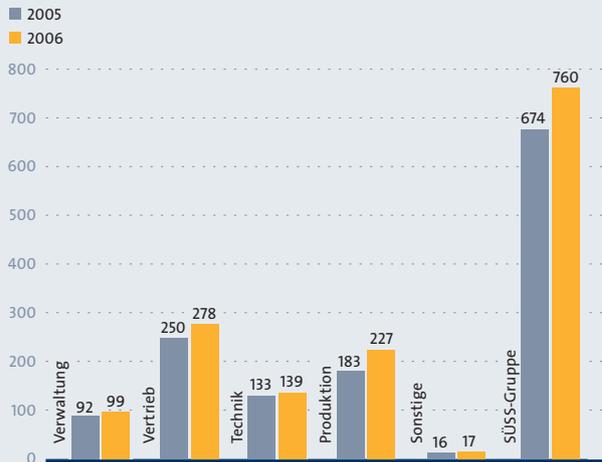
Mitarbeiter im Konzern

in %



SÜSS MicroTec hat einen hohen Anteil der Wertschöpfung in der Herstellung der Produkte nach außen verlagert. Die Materialquote liegt in der Regel bei 60 bis 70 %.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Bereichen



Zum Ende des Jahres 2006 waren 760 (Vorjahr: 674; +12,8 %) Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt. Im Berichtsjahr beeinflussten folgende Maßnahmen die Änderung der Mitarbeiterzahlen:

- Das Umsatzwachstum machte einen Personalaufbau in den Fertigungsbereichen erforderlich.
- Zur Sicherstellung einer weltweiten Präsenz im Segment Substrat Bonder wurde entsprechendes Personal eingestellt.

Der Aufbau, Erhalt und die Entwicklung einer Stammebelegschaft, der eine weitreichende Perspektive innerhalb der SÜSS MicroTec-Gruppe offeriert werden kann, ist dabei die Leitidee für die Personalentwicklung im Konzern.

6. Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB

Das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG in Höhe von 17.006.926 EUR ist aufgeteilt in 17.006.926 nennwertlose, stimmberechtigte Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiegattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10 % der Stimmrechte überschreiten, gibt es zum Bilanzstichtag nicht.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 16. Juni 2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 6.022.358 durch Ausgabe von bis zu 6.022.358 neuen Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Es gibt keine wesentlichen Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen.

Entschädigungsvereinbarungen o. Ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiegattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change of Control“-Klauseln nicht wegfallen.

7. Vergütungsbericht

(Hinweis: Angaben zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats, zu den Grundzügen des Vergütungssystems des Vorstands sowie die Offenlegung der Vergütung des Vorstands befinden sich im Corporate Governance Bericht auf den Seiten 12 ff.)

8. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Im Jahr 2006 wurden die positiven Effekte der – insbesondere im Segment Lithografie – durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen deutlich sichtbar. Sowohl die operative Ergebnisperformance als auch die positive Finanzschuldenposition ermöglichen eine auf Wachstum konzentrierte Unternehmensstrategie.

Die Passivseite der Bilanz ermöglicht es dem Unternehmen, zur Unterstützung strategischer Maßnahmen entsprechende Finanzierungen bereitzustellen. Vor allem Fremdkapitalkomponenten können bei Bedarf nun wieder integriert werden, ohne dabei die Bilanzstruktur nachhaltig zu schwächen. Die wirtschaftliche Lage hat sich somit deutlich verbessert und ist unseres Erachtens sehr gut. Im Jahr 2007 soll der Beweis der Nachhaltigkeit der erfolgreichen Umstrukturierung erbracht werden.

9. Umwelt

Während in unserem Produktionsprozess kaum umweltbelastende Stoffe Verwendung finden oder entstehen, setzen unsere Kunden in der Produktion von Halbleitern und Mikrosystemen zahlreiche chemische Stoffe ein. Daher ist unser Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer Umwelt im Wesentlichen von den verwendeten Prozessen und Materialien im Produktionsprozess unserer Kunden abhängig.

Jedoch können wir einen indirekten Beitrag leisten, indem wir Maschinen produzieren, die eine Verwendung von umweltfreundlicheren Materialien ermöglichen. Der von IBM entwickelte C4NP-Prozess beispielsweise erlaubt die bleifreie Verarbeitung von Chips.

Darüber hinaus werden unsere Produkte beispielsweise in der Automobilzulieferer-Industrie bei der Produktion von Sensoren eingesetzt, die nachhaltig die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen: Airbags und Antiblockiersysteme sorgen dafür, dass die individuelle Mobilität immer sicherer wird. Aber auch intern spielt die Arbeitssicherheit eine wichtige Rolle: In Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft werden die Mitarbeiter der SÜSS MicroTec regelmäßig zum Thema „Sicherheit am Arbeitsplatz“ geschult. Die Reinräume entsprechen den anspruchsvollen Sicherheitsstandards, so dass das Arbeiten mit gefährlichen Chemikalien so risikoarm wie möglich geschehen kann. Für den Notfall sind Mitarbeiter auch in spezifischen Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgebildet.

Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen angemessenen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer Umwelt leisten.

10. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 18. Januar 2007 haben wir die vollständigen Anteile an einer neu gegründeten Gesellschaft in Singapur erworben. Ziel ist es, zukünftig in der für uns wichtigen Region Vertriebsfunktionen und technische Unterstützung für unsere Kunden durch einen eigenen lokalen Auftritt bereitzustellen.

11. Risikobericht

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

Politische Rahmenbedingungen

Unverändert besteht Konfliktpotenzial im Nahen Osten, welches bei einer Eskalation erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf 2007 nehmen könnte. Hinzu kommen Risiken bei der Embargopolitik in mehreren asiatischen Ländern bzw. bei speziellen Kunden der Gruppe, wobei diese Risiken von deutlich geringerem Ausmaß sind. Zusätzlich ist im Verlauf des Jahres 2006 die Energieversorgung als ein potenzielles Risiko insbesondere für die europäische Wirtschaft hinzugekommen, wo politische Spannungen Auswirkung auf die Versorgungssicherheit hatten.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesen Risiken begegnen wir durch angepasste Strukturen, wo bei schwankender Geschäftstätigkeit vor allem extern, zum Beispiel durch Outsourcing, angepasst wird.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Abhängigkeit von einzelnen „Know-How“-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

Betriebliche Risiken

Vermögens- und Ertragslage

Die unter dem Punkt „Marktpositionierung“ dargestellten Risiken könnten in der Konzernbilanz, insbesondere bei der Bewertung aktivierter Entwicklungsleistungen, außerplanmäßige Wertberichtigungen im Rahmen künftiger Impairment-Tests notwendig machen. Diese hätten Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden. Durch konzernweit gültige Bewertungsregelungen sollen latente Überbewertungen vermieden werden.

Preisdruck und Währungsentwicklung

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten. Der Wechselkurs des US-Dollars hat wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Konzerns. Daher soll die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöht werden, um eine den Umsatzanteilen adäquate Wertschöpfung in diesem Währungsraum zu erzeugen. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen 3 bzw. 6 Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Darüber hinaus wird ein Sockelbetrag auf eine Laufzeit von 12 Monaten gesichert. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Zugang zu Fremdkapital und Zinsänderungsrisiko

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Das Zinsänderungsrisiko ist begrenzt, da die wesentlichen Fremdkapitalpositionen auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen basieren.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2006 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet. Die aktuelle Eigenkapitalausstattung lag weit über dem Risk Adjusted Capital, das den Eigenkapitalanteil darstellt, der zur Deckung potenzieller Verluste mindestens vorgehalten werden muss.

Risikomanagement-System

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr sind wir stets darauf aus, ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz zu erreichen. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikomanagement-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Risiken werden für das Unternehmen als „wesentlich“ eingestuft, wenn sie entweder als Einzelrisiko oder aber kumulativ eine maximale Schadenshöhe von 1 Mio. EUR erreichen oder übertreffen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

12. Prognosebericht

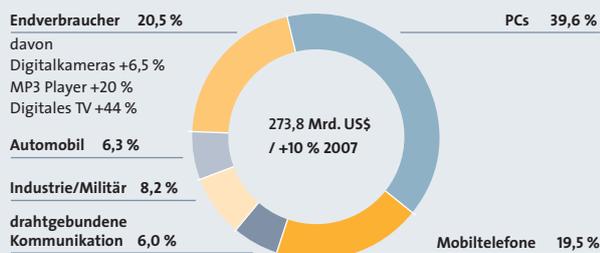
Nach einem hervorragenden Geschäftsjahr 2006 erwarten wir 2007 eine relativ stabile Entwicklung für die gesamte Equipment-Industrie, allerdings blickt SÜSS mit Spannung auf einige Bereiche, in denen die Impulse neuer Grundlagentechnologien ein deutlich über dem Markt liegendes Wachstum generieren werden. Die Geschäftsentwicklung von SÜSS MicroTec wird 2007 und darüber hinaus von exogenen und endogenen Faktoren beeinflusst. In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf diese Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für den Erfolg unseres Unternehmens erachten.

Halbleiterindustrie

In der Chipindustrie wird 2007 mit weiterem Wachstum gerechnet. Bezüglich der Prognosen herrscht in diesem Jahr ein breiterer Konsens unter den Analysten, wobei die Institute mehrheitlich von Wachstumsraten zwischen 7 % und 10 % ausgehen. Die maßgeblichen Wachstumstreiber sind im nachstehenden Schaubild aufgeführt.

Halbleiter-Wachstum 2007

in %



Quelle: iSupply/Gartner/SIA November 2006

Halbleiter-Equipment-Industrie

Nachdem die Equipment-Industrie 2006 zweistellige Wachstumsraten verzeichnete, gehen die maßgeblichen Institute für 2007 mehrheitlich von einem einstelligen Wachstum aus, bevor dieses 2008 wieder in den zweistelligen Bereich zurückkehren soll. So rechnet etwa VLSI für die gesamte Halbleiter-Equipment-Industrie mit einem Wachstum von rund 3 %, während die Wachstumsprognosen von SEMI näher bei 4 % liegen. Die Branche erwartet im Allgemeinen ruhigere und moderatere Zyklen, die bessere Vorhersagen einzelner Quartale und des Gesamtjahres ermöglichen. Hinzu kommt, dass die gesteigerte Diversifizierung von Endprodukten und Branchen, die von Halbleiter- und damit zusammenhängenden Technologien unmittelbar profitieren, eine zyklusübergreifende Ertragskraft gewährleisten. Wie in der Vergangenheit bereits dargelegt, folgt der Geschäftszyklus von SÜSS MicroTec dem Marktzyklus nicht 1:1, da viele Systeme in die Forschungs- und Pilotproduktion verkauft werden. Die Stimmung des Gesamtmarktes wirkt sich jedoch merklich auf das Geschäftsklima unserer wichtigsten Kunden aus. Mit Blick auf einzelne Regionen kommt Asien wie schon in der Vergangenheit die unbestrittene Rolle des Wachstumsführers zu (siehe nachfolgendes Schaubild).

Marktregion	2005 Ist-Werte	2006	Veränd.	2007	Veränd.	2008	Veränd.	2009	Veränd.
	Mrd. \$	Mrd. \$	in %	Mrd. \$	in %	Mrd. \$	in %	Mrd. \$	in %
Nordamerika	5,70	7,83	37,2	8,11	3,6	8,54	5,3	8,83	3,4
Japan	8,18	9,11	11,3	9,63	5,7	10,77	11,9	11,25	4,4
Taiwan	5,72	6,91	20,8	7,03	1,7	8,70	23,7	9,44	8,6
Europa	3,26	3,66	12,1	3,76	2,9	3,92	4,4	4,08	4,1
Südkorea	5,83	6,98	19,9	7,19	2,9	8,16	13,6	8,50	4,1
China	1,33	2,39	80,4	2,42	1,0	2,97	22,8	3,23	8,7
Rest der Welt	2,86	3,76	31,3	4,01	6,8	4,70	17,2	5,00	6,3
Equipment gesamt	32,88	40,64	23,6	42,14	3,7	47,77	13,3	50,32	5,4

Quelle: SEMI, Dezember 2006

SÜSS erwartet weiteres Wachstum auf dem asiatischen Markt, nachdem umfangreiche und fortlaufende Veränderungen der Vertriebszentren dieser Region vorgenommen wurden. Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass wir nach wie vor mit kräftigen Umsätzen in Nordamerika und Europa rechnen, wo ein Großteil der Entwicklungsarbeiten unserer Kunden erfolgt, bevor sie zur Massenfertigung in asiatische Produktionsstätten verlagert werden.

Wie bereits in unserem Jahresabschluss 2005 erläutert, sind wir unverändert der Überzeugung, dass die in den vergangenen Jahren in der Halbleiterindustrie beobachteten Entwicklungen hinreichend belegen, dass die Branche allmählich „reifer“ wird. Die heutigen Investitionsentscheidungen der Kunden sind wohlüberlegt und der irrationale Ausgabenrausch früherer Jahre scheint der Vergangenheit anzugehören. Es wird auch weiterhin zu einigen heftigen Ausschlägen und Schwankungen kommen, die nach unserer Ansicht jedoch nicht mehr die früheren Ausmaße annehmen dürften. Abweichungen von +/-10 % bis +/-20 % in einzelnen Jahren können wir daher nicht ausschließen, mit Umsatzsprüngen wie im Jahr 2000 (+86 %) rechnen wir jedoch nicht mehr (Angaben gemäß früherer Rechnungslegung nach US-GAAP). Wir gehen nach wie vor davon aus, dass sich in der Equipment-Industrie in dieser Phase ein langfristiges Wachstum in der Größenordnung von 10 % einstellen wird.

Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

Advanced Packaging-Markt

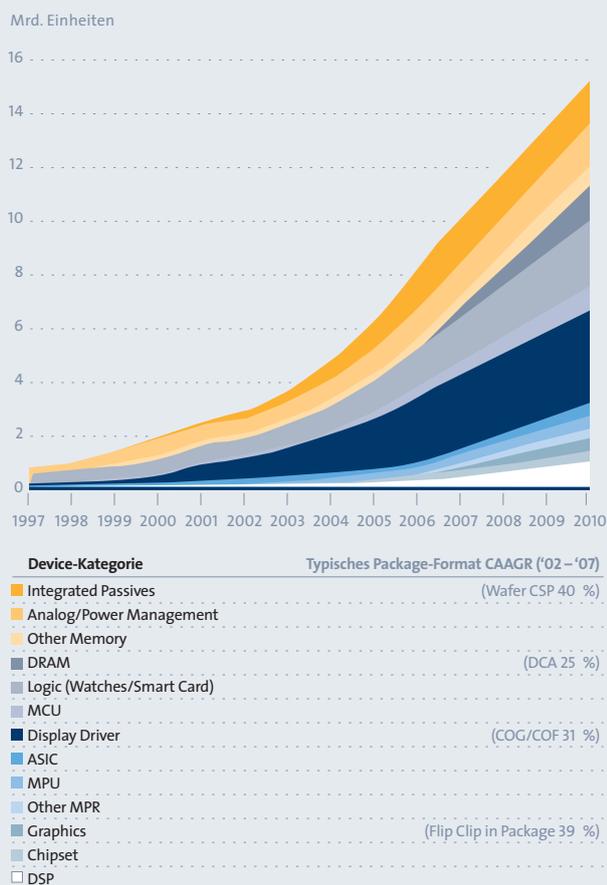
Im Advanced Packaging-Markt rechnen wir aufgrund steigender Investitionen in innovative Prozesse mit der stärksten Wachstumsdynamik innerhalb der SÜSS MicroTec-Gruppe. Geringere Abstände zwischen den immer kleiner werdenden Lotkügelchen und nicht zuletzt die sich abzeichnenden gesetzlichen Regelungen zur Schadstoffreduzierung (etwa von Blei) erfordern völlig neue Packaging-Technologien, die flexibel auf die sich stetig verändernden Marktanforderungen reagieren können. Dies wird sich auch auf das Wachstum des Segments Lithografie nieder-

schlagen, da dieser Markt derzeit fast zur Gänze von Lithografieprodukten in Gestalt umsatzstarker Produktionsmaschinen bedient wird. In Zukunft soll auch die ausschließlich auf diesen Markt ausgerichtete C4NP-Technologie wesentliche Umsatzbeiträge aus diesem Markt generieren.

Der Grund für diese erwartete Dynamik liegt vor allem darin, dass das Wachstum in diesem Bereich nicht allein vom Wachstum der Gesamtbranche abhängt. Wir gehen vielmehr davon aus, dass Advanced Packaging das klassische Wire Bonding bei bestimmten Chiparten nach und nach verdrängen wird. Aufgrund dieser Technologieverdrängung eröffnen sich Wachstumspotenziale in der Halbleiterindustrie selbst in Zeiten stagnierender oder sogar rückläufiger Gesamtmarktentwicklung. Mehrere Marktforschungsinstitute bestätigen hier unsere Annahmen. Während gegenwärtig nur rund 5 bis 10 % aller Chips mit der modernen Kontaktierungsmethode produziert werden, wird bis zum Jahr 2010 mit einer Verdoppelung dieses Anteils gerechnet. Dies bedeutet, dass in den kommenden drei bis vier Jahren die vorhandene Kapazität für Advanced Packaging – die im Wesentlichen in den vergangenen zehn Jahren installiert wurde – ebenfalls verdoppelt werden muss. Wir rechnen damit, dass ein hoher Anteil dieser Kapazitätserweiterung auf 300mm-Produktionslinien entfällt. Ferner gehen wir davon aus, dass unsere gute Wettbewerbsposition bei den asiatischen Auftragsfertigern unverändert bestehen bleibt. Das nachstehende Schaubild zeigt eine Prognose, wie sich die Anwendung der Advanced Packaging-Technologie bei verschiedenen Chiparten bis 2010 entwickeln soll.

Wie im Schaubild ersichtlich, geht das Marktforschungsunternehmen Prismark davon aus, dass in diesem Markt jährliche Wachstumsraten von 20 % oder mehr durchaus möglich sein können. Hinzu kommen weitere bedeutende Geschäftschancen, die dieses Wachstum nochmals effektiv steigern könnten:

Weltweiter Konsum von Flip Chip Devices (Inkl. Flip Chip in Package, DCA, COF/COG und Wafer CSP)



Das Interesse an der C4NP-Technologie bleibt auf unverändert hohem Niveau. Wir haben hervorragende Fortschritte bei der Entwicklung der C4NP-Produktionslinie erzielt und die Ergebnisse von Zuverlässigkeitstests bestätigen die Überlegenheit dieser Technologie. Gespräche mit IBM und potenziellen Kunden sowie unsere eigenen Erfahrungen mit der manuellen Produktionslinie veranlassten uns jedoch zu einer neuen Evaluierung der Produktionsgeräte, die wir auf dem Packaging-Markt bereitstellen werden. Anstatt potenziellen Kunden Einzelsysteme mit einem

Durchsatz von 300 Wafern pro Tag anzubieten, wurde die Bereitstellung flexiblerer Systeme mit einem Durchsatz von 150 Wafern pro Tag beschlossen, um so eine reibungslosere Produktionsanlaufphase zu ermöglichen. Im Prognosebericht des vergangenen Jahres brachten wir unsere Hoffnung zum Ausdruck, im Jahr 2006 sogenannte „Early Adopters“ zum Umstieg auf die C4NP-Technologie gewinnen zu können. Dies hat sich zwar nicht bewahrheitet, wir sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass diese Technologie in sehr naher Zukunft auf die entsprechende Akzeptanz stoßen wird.

Mikrosystemtechnik-Markt (MEMS)

Die Mikrosystemtechnik, auch MEMS genannt, zeichnet sich durch eine hohe Diversifizierung sowohl bei den Produkten als auch bei den Herstellern dieser Produkte aus. Im Gegensatz zum Mikrochip, der in der Regel in großen Stückzahlen äußerst kostengünstig produziert wird, fällt bei Mikrosystemen die Ausbringungsmenge häufig geringer aus, während die Produktvielfalt erheblich höher ist. Die Mikrosystemtechnik ist nicht von einzelnen Endmärkten abhängig, sondern wird vom allgemeinen Konjunktur- und Investitionsklima beeinflusst. Immer mehr MEMS-Anwendungen weisen mittlerweile Anzeichen der Vermarktungsreife auf. In diesem Sektor wird die Equipment-Industrie eine große Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produktions- und Testgeräten verzeichnen, wobei erstere die Ausbeute verbessern können, während letztere bei der Prüfung dieser Ausbeute zum Einsatz kommen. Diese Geräte werden für den kommerziellen Erfolg der MEMS-Industrie von grundlegender Bedeutung sein.

Märkte für Mikrosysteme weltweit nach Anwendungen

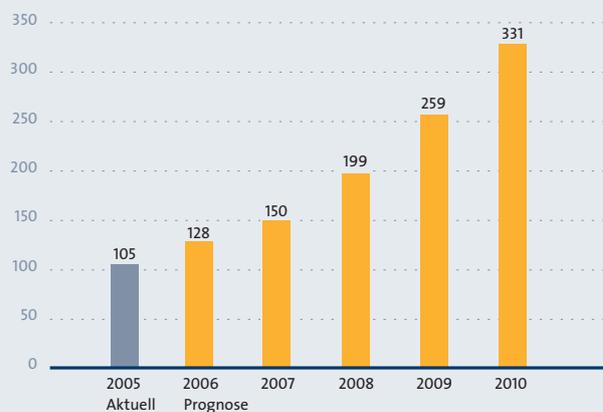
Markt für Mikrosysteme	Aktuell 2005	Vorhersage 2006	Vorhersage 2007	Vorhersage 2008	Vorhersage 2009	Vorhersage 2010	Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Tintendruckerköpfe	1.532	1.663	1.660	1.881	2.004	2.015	6
Drucksensoren	911	1.053	1.150	1.172	1.206	1.254	7
Silikon-Mikrofone	65	116	172	259	330	398	44
Beschleunigungsmesser	393	439	487	550	666	869	17
Gyroscopes	558	635	722	808	874	930	11
MOEMS (inkl. DMDs)	1.292	1.743	2.069	2.348	2.748	3.154	20
Mikrofluide	404	453	508	629	732	849	16
RF MEMS	105	128	150	199	259	331	26
Mikro-Brennstoffzellen	0	0	0	1	26	65	NA
Gesamt Millionen US\$	5.261	6.230	6.918	7.848	8.846	9.864	13

Quelle: Yole Développement, Juni 2006

Yole, ein führendes Marktforschungsinstitut im Bereich MEMS, prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13 % für die Mikrosysteme und ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6 % für das Equipment zur Fertigung dieser Mikrosysteme. Interessant ist, dass sich die RF MEMS – im Jahr 2005 mit einem Marktanteil von 2 % eines der kleinsten Segmente des MEMS-Gerätemarktes – bis zum Jahr 2010 mit einem durchschnittlichen Jahreswachstum von 26 % zur „Killerapplikation“ von morgen entwickeln werden. Dies liegt vor allem an der höheren Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber ihren traditionellen Pendanten, weshalb sich RF MEMS optimal für Militär- und Raumfahrt-Anwendungen eignen. Im Konsumgütermarkt (hauptsächlich Mobiltelefone) fällt das Volumen zwar geringer aus, doch sind Anwender hier bereit, für mehr Leistung auch höhere Preise zu bezahlen. Silizium-Mikrofone verzeichnen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 44 % ebenfalls einen veritablen Boom.

RF MEMS global

in Millionen US\$



Quelle: Yole Développement, Juni 2006

Im Hinblick auf den Equipment-Markt zählen zwei der drei Hauptwachstumstreiber zu den starken Produkten von SÜSS – Wafer (Substrat) Bonder und Wafer Test-Systeme. Yole prognostiziert ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10 % im Bereich Wafer Bonding für den Mikrosystemmarkt und 7 % bei Testsystemen. Der jüngste Umsatzanstieg im Segment Substrat Bonding geht zum Teil auf diesen Trend zurück. Daneben ist ein wachsendes Interesse an spezialisierten SÜSS-Testsystemen für MEMS zu beobachten.

Verbindungshalbleiter-Markt

Bei Verbindungshalbleitern gestalten sich Einschätzungen über die zukünftige Marktentwicklung für unsere Produkte weiterhin schwierig, da es sich hier um einen sehr diversifizierten Markt handelt, der häufig extremen Schwankungen unterliegt (als Beispiel sei der Einbruch der Telekommunikationsbranche vor einigen Jahren genannt). Einer der starken Wachstumstreiber bei Verbindungshalbleitern ist der Bereich LED. Das Marktforschungsunternehmen ISuppli prognostiziert für das Segment High Brightness bis 2011 ein durchschnittliches Jahreswachstum von bis zu 57 %. SÜSS ist gut aufgestellt, um von diesem Wachstum zu profitieren, da der Absatz praktisch aller Produktlinien auf diesem Markt erfolgt.

Endogene Indikatoren

Ab 2004 wurden die operative Geschäftstätigkeit und der Vertrieb der Gruppe umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen unterzogen, die 2006 im Wesentlichen abgeschlossen waren. Mit diesen Veränderungen sind wir optimal positioniert, um von den Vorteilen des von den Marktforschungsinstituten und unseren Kunden geteilten positiven Marktausblicks profitieren zu können.

13. Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

Für die gesamte Gruppe streben wir in den nächsten drei bis fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 10 % an. Neben den üblichen Kapazitätserweiterungen durch die Installation neuer Produktionslinien erwarten wir zukünftig zudem einen nachhaltigen Anstieg der Umsatzbeiträge aufgrund von Wiederbeschaffungsinvestitionen. In den vergangenen zwei Jahren konnten wir bereits Investitionen in Nachfolgergeräte bei einzelnen Großkunden vornehmen, wo höhere Spezifikationsanforderungen sowie die gesteigerte Durchsatzleistung der neueren Maschinen entscheidende Faktoren für den Ersatz des bestehenden Equipments waren. Darüber hinaus soll die Rohertragsmarge langfristig auf 45 bis 47 % erhöht werden, wobei die Steigerung der heutigen Performance vor allem durch Skaleneffekte, verbesserte Fertigungsprozesse und neue Produkte erzielt werden soll.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen schrittweise bis auf 10 % der Umsätze erhöht werden. Mit dem vorhandenen Umsatzwachstum und einem relativ geringen Kostenanstieg bei Vertrieb und Verwaltung soll die Gruppe daraufhin in der Lage sein, EBIT-Margen (bezogen auf den Umsatz) von mindestens 10 % zu erzielen. Unterstützt durch diese Ertragsentwicklung soll das operative Geschäft ausreichend freien Cashflow generieren, so dass kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf für das organische Wachstum des Basisgeschäfts auftreten sollte. Mit Blick auf die regionale Aufteilung gehen wir auf lange Sicht und bedingt durch den Schwerpunkt Advanced Packaging weiterhin von einem überproportionalen Wachstum in Asien aus.

Auf Grundlage des gegenwärtigen Auftragsbestands, der Geschäftsentwicklung und des Investitionsklimas zu Beginn des Jahres 2007 erwarten wir, dass sich unser Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird. Wir beabsichtigen, erneut eine EBIT-Marge von über 10 % zu erzielen. Der Break-even-Umsatz auf EBIT-Basis beträgt gegenwärtig etwa 115 bis 120 Mio. EUR.

14. Vorausschauende Aussagen

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf die zukünftige Entwicklung des SÜSS-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrundegelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 16. März 2007

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind
Stephan Schulak

IFRS – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

TEUR	Anhang Nr.	01.01. – 31.12.2006	01.01. – 31.12.2005
Umsatzerlöse	(3)	155.491	117.540
Herstellungskosten	(4)	-85.847	-70.567
Bruttoergebnis vom Umsatz		69.644	46.973
Vertriebskosten		-24.349	-22.126
Forschungs- und Entwicklungskosten		-7.030	-7.204
Verwaltungskosten		-20.704	-21.312
Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts	(5)	0	-1.839
Sonstige betriebliche Erträge	(6)	1.432	4.257
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-2.959	-2.953
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	(11)	0	-22
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		22.171	5.793
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(11)	-6.137	-10.019
Operatives Ergebnis (EBIT)		16.034	-4.226
Zinsaufwendungen	(8)	-943	-2.001
Zinserträge	(8)	522	592
Ergebnis vor Steuern		15.613	-5.635
Ertragsteuern	(9)	-700	-2.593
Jahresergebnis		14.913	-8.228
Davon Minderheitsanteile		114	5
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		14.799	-8.233
Ergebnis je Aktie	(10)		
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR		0,88	-0,52
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR		0,87	-0,52

IFRS – Konzernbilanz

TEUR			
AKTIVA	Anhang Nr.	31.12.2006	31.12.2005
Langfristige Vermögenswerte		52.435	50.401
Immaterielle Vermögenswerte	(12)	14.514	13.668
Geschäfts- oder Firmenwert	(13)	22.726	23.560
Sachanlagen	(14)	4.948	5.384
At-equity bewertete Beteiligungen	(15)	0	0
Sonstige Finanzanlagen	(16)	5	33
Steuerforderungen	(21)	598	0
Sonstige Vermögenswerte	(17)	417	364
Latente Steueransprüche	(9)	9.227	7.392
Kurzfristige Vermögenswerte		104.840	106.920
Vorratsvermögen	(18)	57.964	53.837
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(19)	23.244	23.681
Wertpapiere	(20)	9	58
Steuerforderungen	(21)	1.265	1.120
Flüssige Mittel		20.459	26.325
Sonstige Vermögenswerte	(22)	1.899	1.899
Bilanzsumme		157.275	157.321
PASSIVA			
Eigenkapital		99.155	84.165
Gezeichnetes Kapital	(23)	17.007	16.793
Rücklagen	(23)	82.339	66.640
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(23)	-354	683
Minderheitsanteile		163	49
Langfristige Schulden		11.787	13.800
Pensionsrückstellungen	(24)	2.596	2.581
Sonstige Rückstellungen	(25)	586	455
Finanzverbindlichkeiten	(26)	2.677	5.957
Sonstige Verbindlichkeiten	(27)	195	245
Latente Steuerverbindlichkeiten	(9)	5.733	4.562
Kurzfristige Schulden		46.333	59.356
Sonstige Rückstellungen	(28)	5.030	3.968
Steuerverbindlichkeiten	(29)	1.338	394
Finanzverbindlichkeiten	(26)	3.116	12.832
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.418	6.061
Sonstige Verbindlichkeiten	(29)	30.431	36.101
Bilanzsumme		157.275	157.321

IFRS – Konzern-Kapitalflussrechnung

TEUR	01.01. – 31.12.2006	01.01. – 31.12.2005
Jahresergebnis	14.913	-8.228
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	3.700	4.227
Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts	0	1.839
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.437	3.931
Veränderung von At-equity bewerteten Beteiligungen	0	22
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	202	266
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	1.526	297
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-10	-312
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	403	458
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-417	-1.178
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	127	546
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	2.400	-1.835
Veränderung des Vorratsvermögens	-8.009	6.016
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.290	1.934
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-796	1.016
Veränderung der Pensionsrückstellungen	67	16
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.368	191
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-1.544	-4.255
Veränderung der latenten Steuern	-664	2.001
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.413	6.952

IFRS – Konzern-Kapitalflussrechnung

TEUR	01.01. – 31.12.2006	01.01. – 31.12.2005
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.291	-1.704
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-4.968	-4.273
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	9	972
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7.250	-5.005
Aufnahme von Bankdarlehen	398	1.250
Tilgung von Bankdarlehen	-7.374	-2.376
Tilgung der Wandelanleihe	-3.622	-5.634
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-2.314	1.061
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-127	170
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung	0	6.844
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	0	-109
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	711	199
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-12.328	1.405
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	-701	439
Veränderung der flüssigen Mittel	-5.866	3.791
Flüssige Mittel zum Jahresanfang	26.325	22.534
Flüssige Mittel zum Ende der Periode	20.459	26.325
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	862	1.257
Zinseinnahmen während der Periode	522	592
Steuerzahlungen während der Periode	1.132	455
Steuererstattungen während der Periode	0	392

IFRS – Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2005	15.157	15.157
Einzahlung aufgrund Kapitalerhöhung	1.456	1.456
Kosten der Kapitalerhöhung nach Steuereffekt		
Ausgabe von Stückaktien: Ausübung von Aktienoptionen	180	180
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresergebnis		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 31.12.2005	16.793	16.793
Stand 01.01.2006	16.793	16.793
Ausgabe von Stückaktien: Ausübung von Aktienoptionen	214	214
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresergebnis		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 31.12.2006	17.007	17.007

Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Minderheitsanteile	Total
84.917	433	-16.233	-902	44	83.416
5.388					6.844
-109					-109
19					199
458					458
		-8.233		5	-8.228
			-10		-10
			1.595		1.595
90.673	433	-24.466	683	49	84.165
90.673	433	-24.466	683	49	84.165
497					711
403					403
		14.799		114	14.913
			-31		-31
			-1.006		-1.006
91.573	433	-9.667	-354	163	99.155

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens (Anlagespiegel 2006)

TEUR	01.01.2006	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abgang	31.12.2006
		Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen			
I. Immaterielle Vermögenswerte							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.678	-158	130	9	30	16.629	
2. Entwicklungskosten	15.550	-577	4.838	0	164	19.647	
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	173	-19	0	0	0	154	
	32.401	-754	4.968	9	194	36.430	
II. Geschäfts- oder Firmenwert	37.971	-834	0	0	0	37.137	
III. Sachanlagen							
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	6.102	-237	193	0	7	6.051	
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.436	-948	946	-20	17	10.397	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.649	-285	844	41	672	10.577	
4. Fahrzeuge	566	-16	27	-14	81	482	
5. Anlagen im Bau	71	-2	106	-16	0	159	
6. Aktivierte Leasinggegenstände							
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	127	-22	175	0	0	280	
Technische Anlagen und Maschinen	1.375	-55	0	0	0	1.320	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161	-17	0	0	0	1.144	
	30.487	-1.582	2.291	-9	777	30.410	
IV. Finanzanlagen							
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095	
2. Sonstige Finanzanlagen	201	0	0	0	28*	173	
	2.296	0	0	0	28	2.268	

* betrifft Veränderung Konsolidierungskreis

	Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwerte		
	01.01.2006	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006
	12.617	-128	1.344	-9	28	13.796	4.061	2.833
	5.977	-335	2.326	0	0	7.968	9.573	11.679
	139	-17	30	0	0	152	34	2
	18.733	-480	3.700	-9	28	21.916	13.668	14.514
	14.411	0	0	0	0	14.411	23.560	22.726
	4.871	-194	328	0	0	5.005	1.231	1.046
	8.832	-867	1.156	19	0	9.140	1.604	1.257
	8.935	-199	722	-21	655	8.782	1.714	1.795
	494	-33	25	11	77	420	72	62
	0	0	0	0	0	0	71	159
	21	-5	54	0	0	70	106	210
	822	-41	147	0	0	928	553	392
	1.128	-16	5	0	0	1.117	33	27
	25.103	-1.355	2.437	9	732	25.462	5.384	4.948
	2.095	0	0	0	0	2.095	0	0
	168	0	0	0	0	168	33	5
	2.263	0	0	0	0	2.263	33	5

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens (Anlagespiegel 2005)

TEUR	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.2005
	01.01.2005	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.777	-274	175	0	0	16.678
2. Entwicklungskosten	10.904	548	4.098	0	0	15.550
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	184	2	0	0	13	173
	27.865	276	4.273	0	13	32.401
II. Geschäfts- oder Firmenwert	36.892	1.079	0	0	0	37.971
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.400	183	136	440	2.057	6.102
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.139	1.073	250	0	26	10.436
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.572	350	547	-440	380	10.649
4. Fahrzeuge	541	30	47	0	52	566
5. Anlagen im Bau	0	0	71	0	0	71
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	632	5	90	0	600	127
Technische Anlagen und Maschinen	874	-1	528	0	26	1.375
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.226	-97	35	0	3	1.161
	30.384	1.543	1.704	0	3.144	30.487
IV. Finanzanlagen						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	201	0	0	0	0	201
	2.296	0	0	0	0	2.296

	01.01.2005	Währungs- differenz	Kumulierte Abschreibungen			Restbuchwert		
			Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2004	31.12.2005	
	11.120	-354	1.851	0	0	12.617	5.657	4.061
	3.376	254	2.347	0	0	5.977	7.528	9.573
	122	1	29	0	13	139	62	34
	14.618	-99	4.227	0	13	18.733	13.247	13.668
	12.572	0	1.839	0	0	14.411	24.320	23.560
	3.795	163	1.622	125	834	4.871	3.605	1.231
	6.823	930	1.105	0	26	8.832	2.316	1.604
	8.485	232	710	-125	367	8.935	2.087	1.714
	499	21	24	0	50	494	42	72
	0	0	0	0	0	0	0	71
	316	1	304	0	600	21	316	106
	713	-1	136	0	26	822	161	553
	1.125	-24	30	0	3	1.128	101	33
	21.756	1.322	3.931	0	1.906	25.103	8.628	5.384
	2.073	0	22	0	0	2.095	22	0
	168	0	0	0	0	168	33	33
	2.241	0	22	0	0	2.263	55	33

IFRS – Segmentberichterstattung Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

TEUR	Lithografie		Substrat Bonder	
	2006	2005	2006	2005
Umsatzerlöse	92.078	66.554	14.124	6.074
Segmentergebnis	18.486	4.626	-508	-4.016
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung	0	-22	0	0
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-1.083	290	-90	67
Segmentvermögen	59.698	66.281	21.560	14.638
- davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen				
Konzernaktiva				
Segmentschulden	-19.429	-28.737	-6.286	-4.393
Nicht zugeordnete Konzernschulden				
Konzernschulden				
Abschreibungen	3.138	3.771	1.081	1.010
- davon planmäßig	3.138	3.290	1.081	1.010
- davon außerplanmäßig	0	481	0	0
Investitionen	1.848	1.227	1.584	446
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	298	275	85	75

Segmentinformationen nach Regionen

TEUR	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Europa	43.225	41.588	4.183	4.550	78.196	73.719
Nordamerika	47.684	42.170	2.700	703	42.594	43.485
Japan	17.098	7.669	103	18	3.329	4.185
Sonstiges Asien	47.170	26.112	80	30	579	718
Rest	314	0	193	676	2.345	3.759
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-3.647	-5.736
Gesamt	155.491	117.540	7.259	5.977	123.396	120.130

Device Bonder		Test Systeme		Sonstige		Summe	
2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
7.085	6.129	30.194	28.752	12.010	10.030	155.491	117.540
1.042	-3.932	3.251	2.074	-4.545	-4.457	17.726	-5.706
0	0	0	0	0	0	0	-22
-350	134	426	-44	-405	289	-1.502	736
7.264	5.515	17.708	20.265	17.166	13.431	123.396	120.130
0	0	4.317	4.597	4.810	5.364	22.726	23.560
						33.879	37.191
						157.275	157.321
-2.918	-1.048	-6.008	-6.836	-4.031	-2.476	-38.672	-43.490
						-19.448	-29.666
						-58.120	-73.156
170	3.081	308	440	1.440	1.717	6.137	10.019
170	186	308	440	1.440	1.717	6.137	6.643
0	2.895	0	0	0	0	0	3.376
54	29	239	184	3.534	4.091	7.259	5.977
43	45	129	128	169	161	724	684

Anhang zum IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2006

(1) Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen in Deutschland, Waterbury und Palo Alto in den USA, und Saint Jeoire in Frankreich. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Großbritannien, Japan, Thailand, Taiwan und China. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

a) Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 Abs. 1 ff. HGB erstellt.

b) Nicht vorzeitige angewandte Standards und Interpretationen

Das IASB hat nachfolgende Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung noch nicht verpflichtend ist und die vom SÜSS-Konzern auch nicht vorzeitig angewandt wurden:

IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“

Das IASB hat im August 2005 IFRS 7 veröffentlicht. In diesem Standard wurden die Angaben zu Finanzinstrumenten zusammengefasst, die bislang in IAS 30 „Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen“ und IAS 32 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ geregelt waren. Dabei wurden einzelne Angabepflichten geändert bzw. ergänzt.

IFRS 7 ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Der Standard, der von allen Unternehmen anzuwenden ist, wird bei der erstmaligen Anwendung durch den SÜSS-Konzern im Geschäftsjahr 2007 voraussichtlich zu erweiterten Angaben zu Finanzinstrumenten führen.

IFRIC 7 „Anwendung des Restatement-Ansatzes nach IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationenländern“

Das IASB hat im November 2005 die Interpretation IFRIC 7 herausgegeben. Diese Interpretation enthält Richtlinien zur Anwendung von IAS 29 „Rechnungslegung in Hochinflationenländern“, wenn die funktionale Währung eines Unternehmens erstmalig als hyperinflationär eingestuft wird.

IFRIC 7 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. März 2006 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die Interpretation hat keine Auswirkungen auf die künftigen Konzernabschlüsse der SÜSS MicroTec AG, da bei keinem der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen die funktionale Währung die Währung eines Hochinflationenlandes ist und das auch nicht zu erwarten ist.

IFRIC 8 „Anwendungsbereich von IFRS 2“

Das IASB hat im Januar 2006 die Interpretation IFRIC 8 veröffentlicht, die zum Anwendungsbereich von IFRS 2 Stellung nimmt. IFRS 2 „Aktienbasierte Vergütung“ ist anzuwenden auf Geschäftsvorfälle, in deren Rahmen eine Gesellschaft Güter oder Dienstleistungen als Gegenleistung für eine aktienbasierte Vergütung erhält. Nach IFRIC 8 ist IFRS 2 auch dann anzuwenden, wenn die Gesellschaft die erhaltenen Güter oder Dienstleistungen nicht klar identifizieren kann.

IFRIC 8 ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Mai 2006 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die Interpretation hat keine Auswirkungen auf die künftigen Konzernabschlüsse der SÜSS MicroTec AG, da kein in den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen derartige in der Interpretation genannte Geschäftsvorfälle getätigt hat und in der vorhersehbaren Zukunft auch nicht tätigen wird.

Änderung des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – Angaben zum Kapital

Das IASB hat im August 2005 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ eine Änderung des IAS 1 bekannt gemacht. Danach sind im Abschluss Informationen zu veröffentlichen, die den Abschlussadressaten eine Bewertung der Ziele, Methoden und Prozesse beim Kapitalmanagement ermöglichen.

Die Änderung des IAS 1 ist anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnen. Eine frühere Anwendung wird empfohlen.

Die erstmalige Anwendung dieser Änderung des IAS 1 durch den SÜSS-Konzern im Geschäftsjahr 2007 wird zu erweiterten Anhangangaben führen.

IFRIC 9 „Neueinschätzung eingebetteter Derivate“

Das International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) hat am 1. März 2006 die Interpretation IFRIC 9 „Neueinschätzung eingebetteter Derivate“ veröffentlicht. IFRIC 9 befasst sich mit der Besonderheit der Bilanzierung eingebetteter Derivate nach IAS 39. Nach den in IAS 39.11 genannten Voraussetzungen ist zu beurteilen, ob das eingebettete Derivat vom Basisvertrag zu trennen und nach den Bilanzierungsregeln für derivative Finanzinstrumente abzubilden ist.

IFRIC 9 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juni 2006 beginnen, wobei eine frühere Anwendung empfohlen wird.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2007 keine Auswirkungen.

IFRIC 10 „Zwischenberichterstattung und Wertminderung“

Im Juli 2006 veröffentlichte das IFRIC die Interpretation IFRIC 10 „Zwischenberichterstattung und Wertminderung“. In IFRIC 10 wird geregelt, dass ein Unternehmen an jedem Berichterstattungstermin den Goodwill, Eigenkapitalinstrumente usw., die zu Kosten bewertet werden, einem Impairment-Test unterziehen muss (IAS 36, IAS 39). Ab einem nachfolgenden Berichtstermin können sich die Verhältnisse so geändert haben, dass die Wertminderung geringer ausfallen würde oder ganz vermieden werden könnte. Die Interpretation regelt, ob eine Wertaufholung vorzunehmen ist.

IFRIC 10 ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. November 2006 beginnen.

IFRIC 11, IFRS 2 „Transaktionen unter Verwendung eigener Aktien oder von Aktien, die von anderen Konzernunternehmen emittiert wurden“

Das International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) hat am 2. November 2006 die Interpretation IFRIC 11 IFRS 2 – „Transaktionen unter Verwendung eigener Aktien oder von Aktien, die von anderen Konzernunternehmen emittiert wurden“ veröffentlicht. Die Interpretation befasst sich mit der Fragestellung, wie konzernweite aktienbasierte Vergütungen zu bilanzieren sind, welche Auswirkungen Mitarbeiterwechsel innerhalb eines Konzerns haben und wie aktienbasierte Vergütungen zu behandeln sind, bei denen das Unternehmen eigene Aktien ausgibt oder Aktien von einem Dritten erwerben muss.

IFRIC 11 ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. März 2007 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG hat die Auswirkungen von IFRIC 11 auf den Konzernabschluss noch nicht untersucht.

IFRS 8 „Segmentberichterstattung“

Durch IFRS 8 wird die Segmentberichterstattung vom sogenannten risk and reward approach des IAS 14 auf den management approach in Bezug auf die Segmentidentifikation umgestellt. Maßgeblich sind dabei die Informationen, die dem sogenannten chief operating decision maker regelmäßig für Entscheidungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird die Bewertung der Segmente vom financial accounting approach des IAS 14 auf den management approach umgestellt.

IFRS 8 ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

IFRS 8 wird bei der erstmaligen Anwendung durch die SÜSS MicroTec AG zu geänderten Angaben in der Segmentberichterstattung führen.

c) Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des „True and fair views“ sowie der Fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

Immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswerts ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellkosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Fremdkapitalkosten werden nicht aktiviert. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe mit Ausnahme des Geschäfts- oder Firmenwerts nicht vor.

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern nur noch im Rahmen eines Werthaltigkeitstests nach IAS 36 außerplanmäßig abgewertet.

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer für die wesentlichen Anlagekategorien ist nachstehend wiedergegeben:

Grundstücke, Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwerts aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingdauer wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrags getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

Außerplanmäßige Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine außerplanmäßige Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Die Ermittlung der Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung erfolgt für die unmittelbare Zukunft auf der Grundlage der aktuellen Konzernplanung. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Durchschnittlich errechnet sich dabei ein jährliches Wachstum von 4,6 % (2005: 9,6 %). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 9,6 % (2005: 9,0 %) durchgeführt.

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die außerplanmäßige Wertminderung entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der außerplanmäßigen Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf außerplanmäßig abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

At-equity bewertete Beteiligungen

Der Konzern bewertet seine At-equity bewerteten Beteiligungen gemäß IAS 28 („Investments in Associates“). Es werden derzeit keine At-equity bewerteten Beteiligungen mit Veräußerungsabsicht gehalten.

Sonstige Finanzanlagen

Sonstige Finanzanlagen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt.

Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen wird zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswerts.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögenswerte

Forderungen und sonstige Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen gegenüber einzelnen Kunden.

Wertpapiere

Wertpapiere werden mit Marktpreisen bewertet. Unrealisierte Gewinne und Verluste von Wertpapieren, die als zum „Verkauf bestimmt“ klassifiziert werden („available for sale“), werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Aktionsoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen werden gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der Zinsaufwendungen ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und wenn die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag unter Einbeziehung von Transaktionskosten sowie Agien und Disagien angesetzt. Langfristige Verbindlichkeiten werden mit dem Barwert angesetzt. Sofern vorgeschrieben, werden Verbindlichkeiten (z. B. derivative Finanzinstrumente) zu Zeitwerten bewertet.

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Herstellungskosten

Die Herstellungskosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

Ergebnis pro Aktie (EPS-Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden grundsätzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Assistance“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgegrenzt.

Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

Die Annahmen und Schätzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die konzerneinheitliche Festlegung von Nutzungsdauern, die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen, die Parameter für die Bewertung der Pensionsrückstellungen und Aktienoptionen im Zeitpunkt der Gewährung sowie die Realisierbarkeit zukünftiger Steuerentlastungen. Darüber hinaus sind Schätzungen und Annahmen bei der Überprüfung des Geschäfts- oder Firmenwerts („Impairment Test“) notwendig.

d) Konsolidierung

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20 und 50 %), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik ausüben kann, werden nach der Equity-Methode bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die funktionale Währung des Konzerns ist der Euro. Alle Angaben erfolgen in tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2006		2005	
	Bilanz	GuV	Bilanz	GuV
1 EUR vs 1 USD	1,32	1,26	1,18	1,25
1 EUR vs 100 JPY	156,65	146,17	139,13	137,14
1 EUR vs 1 GBP	0,67	0,68	0,69	0,69
1 EUR vs 1 CHF	1,61	1,58	1,56	1,55
1 EUR vs 100 TWD	42,90	40,91	39,12	40,25
1 EUR vs 100 CNY	10,29	9,86	9,38	10,05
1 EUR vs 100 THB	46,77	47,61	48,62	50,18

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis

Die Karl SÜSS Geschäftsführungs GmbH, die bisher zu Anschaffungskosten im Konzernabschluss berücksichtigt wurde, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr in die SÜSS MicroTec REMAN GmbH umfirmiert und zum 1. Juli 2006 als vollkonsolidierte Tochtergesellschaft in den Konsolidierungskreis einbezogen. Diese Gesellschaft betreibt seitdem das Gebrauchtmaschinengeschäft des Segments „Lithografie“, das von der SÜSS MicroTec Lithography GmbH übernommen wurde. Eine wesentliche Änderung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns ergab sich dadurch nicht.

Weitere Änderungen des Konsolidierungskreises ergaben sich im Geschäftsjahr 2006 nicht. In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2006 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching	17.006.926,00 EUR	HOLDING	98.363.695,18 EUR	-1.921.558,57 EUR	
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching	2.000.100,00 EUR	100 %	11.541.055,21 EUR	6.135.546,51 EUR	voll
SUSS MicroTec Test Systems GmbH, Sacka (*)	511.291,88 EUR	100 %	8.122.120,88 EUR	671.305,04 EUR	voll
SUSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH, Singen	26.000,00 EUR	100 %	141.669,01 EUR	-46.846,86 EUR	voll
SUSS MicroTec Ltd., Wokingham Berkshire	£10.000,00	100 %	£1.446.703,99	£41.024,67	voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama	30.000,00 TJPY	100 %	387.875,00 TJPY	28.616,00 TJPY	voll
SUSS MicroTec S.A.S., St. Jeoire	1.275.000,00 EUR	100 %	1.706.938,00 EUR	231.916,00 EUR	voll
SUSS MicroOptics S.A., Neuchatel	500.000,00 CHF	85 %	1.686.489,11 CHF	1.187.189,71 CHF	voll
SUSS MicroTec Inc., Waterbury	\$105.000,00	100 %	\$7.495.474,35	-\$844.242,15	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	5.000.000,00 TWD	100 %	64.351.109 TWD	50.633.453 TWD	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai	1.655.320,00 CNY	100 %	4.738.481,69 CNY	910.771,14 CNY	voll
Image Technology Inc., Palo Alto	\$24.287,00	100 %	\$2.151.275,43	\$1.041.301,55	voll
MFI Technologies Group	\$2.737.476,00	100 %	-\$4.225.529,31	-\$34.500,71	voll
HUGLE Lithography Inc., Sunnyvale	\$1.190.442,00	53,1 %	-\$39.579,00	-\$3.894,00	at equity
SUSS MicroTec Company Ltd., Bangkok	4.000,00 TTHB	49 %	14.620,82 TTHB	964,15 TTHB	voll
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim	25.564,59 EUR	100 %	-217.382,43 EUR	-256.799,18 EUR	voll
Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz	51.129,19 EUR	10 %	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand	n/a	10 %	n/a	n/a	keine

(*) Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisführungsvertrags mit der SÜSS MicroTec AG

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Die Beteiligung an der HUGLE Lithography Inc. wird aus Wesentlichkeitsgründen trotz der Beteiligung von 53,1 % am Kapital der Gesellschaft nur nach der At-equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogen. Die HUGLE Lithography Inc. ist eine Gesellschaft ohne aktiven Geschäftsbetrieb, die über keine Vermögenswerte verfügt.

Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat weder im Geschäftsjahr 2006 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(3) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Maschinen	121.798	90.487
Ersatzteile	15.167	9.834
Serviceleistungen	6.266	6.381
Sonstige	12.260	10.838
Umsatzerlöse	155.491	117.540

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten vor allem Erlöse aus dem Maskengeschäft sowie aus dem Bereich Mikrooptik.

(4) Herstellungskosten

In den Herstellungskosten sind insgesamt Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von TEUR 2.326 (2005: TEUR 2.347) enthalten.

Zudem sind in die Herstellkosten Wertminderungen auf Demogeräte und fertige Erzeugnisse von TEUR 1.367 (2005: TEUR 1.524) eingeflossen. Auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden im Geschäftsjahr Zuschreibungen in Höhe von TEUR 31 vorgenommen. Im Vorjahr wurde diese Vorratsposition um TEUR 1.526 wertgemindert.

(5) Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts

Auf Basis des jährlichen Werthaltigkeitstests ergaben sich für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts.

Im Vorjahr wurde aufgrund des unverändert schwierigen Geschäftsumfelds und der anhaltend schwachen Entwicklung bei Umsatz und Auftragseingang eine vollständige Abwertung des Geschäfts- oder Firmenwerts im Segment Device Bonder vorgenommen. Die Höhe der Abwertung betrug TEUR 1.839.

Für die Bestimmung des erzielbaren Betrags bei der Bemessung der Wertminderung wurde der zu erwartende Veräußerungserlös für das Segment Device Bonder verwendet. Der zu erwartende Veräußerungserlös wurde unter Berücksichtigung anfallender Veräußerungskosten mit Hilfe diskontierter Netto-Cashflows ermittelt.

(6) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Rückstellungsaufösungen	417	1.178
Sonstige Zuschüsse	356	738
Versicherungsleistungen	146	18
Fremdwährungsgewinne	126	1.558
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61	342
Mieterträge	47	54
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	60
Sonstiges	279	309
Sonstige betriebliche Erträge	1.432	4.257

Die sonstigen Zuschüsse betreffen wie im Vorjahr insbesondere erhaltene Aufwandszuschüsse aus einem Förderprojekt der europäischen Union, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

Während im Vorjahr Fremdwährungsgewinne resultierten, mussten im Geschäftsjahr 2006 aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen Fremdwährungsverluste hingenommen werden.

Die Erträge aus Rückstellungsaufösungen des Vorjahres resultierten hauptsächlich aus der teilweisen Auflösung der im Geschäftsjahr 2004 gebildeten Rückstellung für die Abfindungszahlung an Herrn Dr. Richter, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft.

(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Fremdwährungsverluste	1.623	590
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	51	238
Vertragsstrafen, Schadensersatz	59	31
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	202	266
Außerplanmäßige Wertminderungen auf Sachanlagen	0	1.515
Sonstiges	1.024	313
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.959	2.953

Bei den Fremdwährungsverlusten des abgelaufenen Geschäftsjahres handelt es sich überwiegend um unrealisierte Währungsverluste aus der Bewertung ausgereicherter Fremdwährungsdarlehen.

Als Ergebnis des jährlichen Werthaltigkeitstests wurde im Vorjahr für das Segment Device Bonder über die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts hinaus weiterer Abwertungsbedarf ermittelt. Zur Deckung des Segmentbuchwerts „Device Bonder“ durch den ermittelten Veräußerungswert für dieses Segment war eine außerplanmäßige Abwertung auf den zugeordneten Grundstücks- und Gebäudeteil in Höhe von TEUR 1.056 notwendig.

Eine weitere außerplanmäßige Abwertung in Höhe von TEUR 459 auf den niedrigeren erzielbaren Betrag wurde im Vorjahr auf das Gebäude einschließlich Einbauten in Aßlar vorgenommen, welches nach der Schließung des Standorts im Geschäftsjahr 2005 veräußert wurde.

(8) Zinsaufwendungen und -erträge

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

TEUR	2006	2005
Bankverbindlichkeiten	638	828
Wandel- und Optionsanleihe	227	1.067
Pensionsrückstellungen	78	106
Zinsaufwendungen	943	2.001

Bei den Zinsaufwendungen aus der Wandel- und Optionsanleihe handelt es sich in Höhe von TEUR 100 (2005: TEUR 521) um Zinszahlungen an die Anleihegläubiger und in Höhe von TEUR 127 (2005: TEUR 546) um den Aufstockungsbetrag zur Erreichung des Rückzahlungsbetrags bei Laufzeitende.

Die Zinserträge resultieren überwiegend aus Geldmarktanlagen.

(9) Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

TEUR	2006	2005
Deutsche Körperschaftsteuer	-300	1.579
Deutsche Gewerbeertragsteuer	-180	1.238
Ausländische Ertragsteuer	1.180	-224
Gesamtaufwand	700	2.593
...davon laufend	1.277	538
...davon latent	-577	2.055

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

TEUR	2006	2005
Angenommener Steuersatz		
Körperschaftsteuer	25,00 %	25,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbesteuersatz	14,90 %	14,90 %
Kombinierter Steuersatz	37,34 %	37,34 %
Ergebnis vor Steuern	15.613	-5.635
Erwartete Ertragsteuern	5.830	-2.104
Abweichende Steuersätze im Ausland	-403	-37
Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen	79	69
Aktivierung Körperschaftsteuerguthaben	-598	0
Außerplanmäßige Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts	0	613
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	274	55
Steueraufwand Vorjahre	544	421
Veränderung der Wertberichtigung auf latente Steueransprüche	-3.823	3.915
Inanspruchnahme wertberichtiger Verlustvorträge	-924	-253
Steuerfreie Erträge	-244	0
Steuerzuschriften	-115	0
Sonstiges	80	-86
Effektive Ertragsteuern	700	2.593

Als Folge der deutlich verbesserten Ertragslage bei zahlreichen Konzerngesellschaften wurden im Berichtsjahr Zuschreibungen auf latente Steueransprüche in Höhe von TEUR 3.823 erforderlich. Die Zuschreibungen erhöhen die latenten Steueransprüche auf einen Betrag, der nach Auffassung der Gesellschaft – basierend auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Gewinne sowie des Zeitpunkts der Umkehrung zeitlicher Buchungsunterschiede – wahrscheinlich realisiert werden kann.

Weiterhin führte die positive Ertragslage dazu, dass wertberichtigte Verlustvorträge aus Vorjahren in Höhe von TEUR 924 in Anspruch genommen wurden.

Eine weitere Verringerung der Konzernsteuerquote trat durch die Aktivierung eines Körperschaftsteuerguthabens von TEUR 598 infolge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) ein.

Im Vorjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf latente Steueransprüche in Höhe von TEUR 3.915 vorgenommen. Die Wertberichtigungen betrafen neben latenten Steueransprüchen auf Verlustvorträge in Höhe von TEUR 2.086 auch gebildete Steueransprüche auf temporäre Differenzen in Höhe von TEUR 1.829. Der größte Teil dieser Wertberichtigungen wurde bei den Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich und Japan sowie bei der SUSS MicroTec Lithography GmbH notwendig.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

TEUR	Aktiva		Passiva	
	2006	2005	2006	2005
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	532	1.392	33	
Pensionsrückstellungen	1.063	1.268		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	264	1.501	13	
Sonstige langfristige Rückstellungen	374	135		
Immaterielle Vermögenswerte			3.352	2.773
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	4		135	40
Finanzverbindlichkeiten			19	201
Geschäfts- oder Firmenwert			825	513
Vorratsvermögen	1.113		460	429
Sachanlagen	234		648	606
Sonstiges	49	480	248	
Verlustvorträge	5.594	2.616		
Gesamt	9.227	7.392	5.733	4.562

Der Konzern verfügt über Verlustvorträge in Höhe von TEUR 36.268 (2005: 47.175). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2011 insgesamt TEUR 5.160 und nach weiteren zwei Jahren nochmals TEUR 1.289. Im Zeitraum von 2022 bis 2026 verfallen insgesamt TEUR 3.588. Ein Teil der Verlustvorträge in Höhe von TEUR 26.231 ist unbegrenzt nutzbar.

Die Veränderung der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Verlustvorträgen bei der SUSS MicroTec Lithography GmbH und aus der Anpassung von Verlustvorträgen bei der SÜSS MicroTec AG und der SUSS MicroTec Inc. sowie dem Verfall von Verlustvorträgen bei der MFI Technologies Inc.

(10) Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

	2006	2005
Jahresergebnis nach Ergebnisanteil anderer Gesellschafter – unverwässert –	14.799	-8.233
Erhöhung des Jahresergebnisses durch verwässernd wirkende Wandel- und Optionsanleihe	142	n/a
Jahresergebnis nach Berücksichtigung von Verwässerungseffekten	14.941	-8.233
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien – unverwässert –	16.823	15.722
Verwässerung aufgrund der bestehenden Aktienoptionsprogramme	67	n/a
Effekt aus der verwässernd wirkenden Wandel- und Optionsanleihe	373	n/a
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien – verwässert –	17.263	15.722
Ergebnis je Aktie in EUR – unverwässert –	0,88	-0,52
Ergebnis je Aktie in EUR – verwässert –	0,87	-0,52

Im Geschäftsjahr 2005 wurden 733.175 Aktien aus der im Geschäftsjahr 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt geführt hätte.

Die ausgegebenen Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft wurden im Vorjahr bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung ebenfalls zu einem negativen Verwässerungseffekt geführt hätte.

(11) Sonstige Angaben zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

TEUR	2006	2005
Löhne und Gehälter	36.750	32.613
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.856	5.764
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.483	2.013
Personalaufwand	44.089	40.390

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen in 2006 TEUR 54.702 (2005: TEUR 49.212).

Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibungen und Wertminderungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Immaterielle Vermögenswerte	3.700	4.227
Geschäfts- oder Firmenwert	0	1.839
Sachanlagen	2.437	3.931
Finanzanlagen	0	22
Abschreibungen und Wertminderungen	6.137	10.019

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 2.326 (2005: TEUR 2.347) wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von TEUR 1.344 (2005: TEUR 1.851) und aktivierte Leasinggegenstände in Höhe von TEUR 30 (2005: TEUR 29) abgeschrieben.

Der wesentliche Teil der Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von TEUR 1.097 (2005: TEUR 1.105) ist in den Verwaltungskosten enthalten.

Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Wertminderungen vorgenommen (2005: TEUR 3.376). Die Wertminderungen des Vorjahres betrafen neben dem Geschäfts- oder Firmenwert (TEUR 1.839) Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) in Höhe von TEUR 1.515, deren Buchwerte nicht mehr durch die erwarteten Veräußerungserlöse bzw. diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt waren.

Zudem wurden im Vorjahr infolge anhaltender Verluste Wertminderungen auf At-equity bewertete Beteiligungen (Finanzanlagen) von TEUR 22 vorgenommen.

Erläuterungen zu den Aktiva

(12) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von TEUR 2.833 (2005: TEUR 4.061) Entwicklungsleistungen von TEUR 11.679 (2005: TEUR 9.573) ausgewiesen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Produktionslinie für die C4NP-Technologie sowie neuer Maschinen in den Segmenten Lithografie und Substrate Bonder.

(13) Geschäfts- oder Firmenwert

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert von TEUR 22.726 (2005: TEUR 23.560) enthält einen Fremdwährungsanteil von TUSD 9.588 aus dem Erwerb US-amerikanischer Geschäftsbetriebe in Vorjahren. IAS 21 sieht vor, dass ein Geschäfts- oder Firmenwert, der aus dem Erwerb eines ausländischen Geschäftsbetriebs und Anpassungen des Buchwerts der erworbenen Vermögenswerte und Schulden an den beizulegenden Zeitwert entsteht, wie ein Vermögenswert des ausländischen Geschäftsbetriebs zu behandeln und damit zum Stichtagskurs umzurechnen ist. Die aus der Stichtagsbewertung resultierenden Fremdwährungsdifferenzen des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR -834 (2005: TEUR 1.079) werden erfolgsneutral im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst.

Zu den im Vorjahr vorgenommenen außerplanmäßigen Wertminderungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert verweisen wir auf die Anhangsangabe (5).

(14) Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von TEUR 629 (2005: TEUR 692) auch geleaste Technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleaste Grundstücke, Gebäude und Einbauten enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrundeliegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

(15) At-equity bewertete Beteiligungen

Die mittels der Equity-Methode bewertete Beteiligung an der HUGLE Lithography Inc., USA (Anteil 53,1 %) wurde im Vorjahr vollständig abgewertet. Die Gesellschaft ist inaktiv.

(16) Sonstige Finanzanlagen

Der Konzern hält weitere Beteiligungen mit Anteilen von weniger als 20 %. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.

(17) Sonstige langfristige Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

TEUR	2006	2005
Rückdeckungsversicherung	254	196
Kautionen	161	167
Sonstiges	2	1
Sonstige langfristige Vermögenswerte	417	364

(18) Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen lässt sich wie folgt aufteilen:

TEUR	2006	2005
Materialien und Hilfsstoffe	23.899	21.037
Unfertige Erzeugnisse	18.309	9.337
Fertigerzeugnisse	12.796	21.489
Demonstrationsgeräte	12.571	10.032
Handelswaren	108	135
Wertberichtigungen	-9.719	-8.193
Vorratsvermögen	57.964	53.837

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2006 bilanzierten Vorräte in Höhe von TEUR 57.964 (2005: TEUR 53.837) sind TEUR 6.408 (2005: TEUR 8.162) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

(19) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

TEUR	2006	2005
Forderungen gegen Dritte	24.360	24.807
Wertberichtigungen	-1.116	-1.126
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.244	23.681

(20) Wertpapiere

Als „available for sale“ behandelt die Gesellschaft unter dieser Position den Aktienbesitz an der JMAR Technologies, Inc., der aus der Veräußerung von Patenten und der Technologie betreffend Röntgen-Lithografie im Geschäftsjahr 2001 stammt.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Börsenkurs abgeleitet wurde. Der durch die Marktwertänderung entstandene unrealisierte Verlust in Höhe von TEUR 49 (2005: TEUR 17) wurde nach Berücksichtigung latenter Steuern ergebnisneutral innerhalb des Eigenkapitals im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen. Der Wert der Aktien beträgt zum Jahresende TEUR 9 (2005: TEUR 58).

(21) Steuerforderungen

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von TEUR 598 infolge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,77 % p.a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von TEUR 1.029 (2005: TEUR 865) und Forderungen im Bereich Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 236 (2005: TEUR 255).

(22) Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

TEUR	2006	2005
Aktive Rechnungsabgrenzung	724	906
Geleistete Anzahlungen	564	640
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	371	107
Sonstiges	240	246
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	1.899	1.899

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

Erläuterungen zu den Passiva

(23) Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Vorjahresstichtag TEUR 16.793. Infolge der Ausübung von insgesamt 213.958 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausübungszeiträumen wurde das Grundkapital aus bedingtem Kapital 2002/II durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um TEUR 214 auf TEUR 17.007 erhöht. Es ist in 17.006.926 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 eingeteilt. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.022.

Am 31. Dezember 2006 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt TEUR 5.874 (2005: TEUR 6.088). Es kann bis zu TEUR 4.800 für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden. Der Restbetrag von TEUR 1.074 ist für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns vorgesehen. Dabei sind TEUR 268 dem alten, geschlossenen Aktienoptionsplan 1999, TEUR 56 dem Aktienoptionsplan 2002 und TEUR 750 dem Aktienoptionsplan 2005 zuzuordnen.

TEUR	2006	2005
Grundkapital	17.007	16.793
genehmigtes Kapital	6.022	6.022
bedingtes Kapital	5.874	6.088

Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Kapitalrücklage	91.573	90.673
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzverlust	-9.667	-24.466
Rücklagen	82.339	66.640

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Geschäftsjahr durch die Ausübung von Aktienoptionen um TEUR 497. Zudem wurden der Kapitalrücklage aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne TEUR 403 ergebniswirksam zugeführt.

Im Vergleich zum Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG nach HGB unterscheidet sich die Kapitalrücklage im IFRS-Konzernabschluss durch die unterschiedliche Behandlung der Wandel- und Optionsanleihe sowie der Kosten der Kapitalerhöhungen in beiden Rechnungslegungsstandards.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzverlust verringerte sich durch das positive Jahresergebnis von TEUR 14.799 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf TEUR -9.667.

Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des Kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

TEUR	2006	2005
Fremdwährungsanpassungen	715	-880
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-32	-22
Stand zu Beginn der Periode	683	-902
Veränderungen vor Steuern		
Fremdwährungsanpassungen	-1.006	1.595
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-49	-16
Steuereffekte		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	18	6
Stand am Ende der Periode	-354	683

Aktionsoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

Aktionsoptionsplan 1999

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 800 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. März 2004 zu erhöhen. Die Bezugsrechte können zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Jahren, zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von 5 Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens den Bezugspreis bei Ausübung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50 %, nach vier Jahren um mindestens 75 % bzw. nach fünf Jahren um mindestens 100 % übersteigt. Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital für diesen Optionsplan auf TEUR 350 gesenkt. Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde für die Zukunft aufgehoben.

Aktionsoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 500 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren zu 100 % ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5 % für 12 Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolgeindex

oder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833 % pro vollem Kalendermonat (10 % pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

Aktienoptionsplan 2005

In der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu TEUR 750 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund 2 Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat

oder

- der Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fünf Jahren.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 403 (2005: TEUR 458) für diese Pläne vorgenommen.

Aus dem in der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 genehmigten Kapital wurden im Berichtsjahr insgesamt 209.500 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 7,53 gewährt. Im Vorjahr wurden aus genehmigtem Kapital 193.000 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 4,95 gewährt.

Am 31. Dezember 2006 bestanden insgesamt 413.900 Bezugsrechte (2005: 673.027 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2006 gewährten Optionen in Höhe von EUR 2,9513 wurde unter Verwendung des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells berechnet. Für die Ermittlung des Marktwerts wurden folgende Parameter verwendet:

	2006	2005
Erwartete durchschnittl. Laufzeit	5 Jahre	5 Jahre
Risikofreier Zinssatz	4,04 %	2,82 %
Erwartete Volatilität SÜSS-Aktie	48 %	31 %
Erwartete Dividende	0 %	0 %

Die Berechnung der Volatilität erfolgte unter Berücksichtigung historischer Kursschwankungen der SÜSS MicroTec-Aktie.

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in EUR
01.01.2005	761.963	11,64
gewährt 2005	193.000	4,95
ausgeübt 2005	180.000	1,11
verfallen 2005	101.936	12,37
31.12.2005	673.027	12,42
gewährt 2006	209.500	7,53
ausgeübt 2006	213.958	3,33
verfallen 2006	254.669	18,60
31.12.2006	413.900	10,85
noch begebbar	347.500	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittl. Bezugspreis EUR	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit Monate
unter EUR 10,00	345.900	5,97	49
EUR 10,00 - EUR 19,99	0	0,00	0
EUR 20,00 - EUR 24,99	0	0,00	0
EUR 25,00 - EUR 29,99	0	0,00	0
EUR 30,00 - EUR 35,99	68.000	35,44	5
ab EUR 36,00	0	0,00	0
	413.900	10,85	42

(24) Pensionsrückstellungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzten sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Inländische Verpflichtungen	1.995	2.124
Ausländische Verpflichtungen	601	457
Gesamt	2.596	2.581

Leistungsorientierte Pläne („Defined benefit plans“)

Der Konzern verfügt in Deutschland und Japan über leistungsorientierte Pensionspläne. Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

TEUR	2006	2005
Abzinsungsfaktor	4,25 % – 4,50 %	4,00 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	4,50 % – 4,75 %	4,70 %
Gehaltssteigerung	0,0 %	0,0 %
Rentensteigerung	1,0 %	1,0 %

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2006 und 2005 wie folgt entwickelt:

TEUR	2006	2005
Anwartschaftsbarwert am 1.1.	4.013	3.607
Dienstzeitaufwand	225	108
Zinsaufwand	137	164
Pensionszahlungen	-255	-255
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust	-54	389
Währungsveränderungen	-80	0
Anwartschaftsbarwert am 31.12.	3.986	4.013

Der versicherungsmathematische Gewinn des Geschäftsjahres beruht maßgeblich auf dem Anstieg des Zinssatzes.

TEUR	2006	2005
Planvermögen am 1.1.	1.265	1.248
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	59	58
Geleistete Fondsdotierungen	-42	-42
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	-1	1
Planvermögen am 31.12.	1.281	1.265

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

TEUR	2006	2005
Barwert der Pensionsverpflichtungen	3.986	4.013
Zeitwert des Planvermögens	-1.281	-1.265
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	2.705	2.748
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste	-109	-167
Rückstellung	2.596	2.581

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von TEUR 1.861 (2005: TEUR 1.770) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

TEUR	2006	2005
Dienstzeitaufwand	225	108
Personalaufwandskomponente	225	108
Zinsaufwand	137	164
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-59	-58
Zinsaufwandskomponente	78	106

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von TEUR 152 (2005: TEUR 31) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von TEUR 73 (2005: TEUR 77) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts und des Planvermögens zeigt folgende Tabelle:

TEUR	2006	2005	2004
Anwartschaftsbarwert	3.986	4.013	3.607
Planvermögen	1.281	1.265	1.248
Deckungsstatus	2.705	2.748	2.359

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 Ap waren im Betrachtungszeitraum aufgrund des im Rahmen der Bewertung unveränderten Mengengerüsts nicht notwendig.

Beitragsorientierte Pläne („Defined contribution plans“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von 6 Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2006 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2005 TUSD 0) und für den 401 (k) Plan TUSD 389 (2005 TUSD 148).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von TEUR 1.737 (2005: TEUR 1.633) abgeführt.

(25) Sonstige langfristige Rückstellungen

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

TEUR	Stand 01.01.2006	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2006
Altersteilzeit	455	-86	0	217	586

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(26) Finanzverbindlichkeiten

Die Fälligkeitsstruktur der Anleihen, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2006 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31. Dezember 2006				
TEUR	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.860	1.628	401	4.889
Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	335	0	335
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	256	313	0	569
Gesamt	3.116	2.276	401	5.793

31. Dezember 2005				
TEUR	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.114	4.581	569	14.264
Verbindlichkeiten aus Anleihen	3.457	373	0	3.830
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	261	434	0	695
Gesamt	12.832	5.388	569	18.789

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich in Höhe von TEUR 1.276 (2005: TEUR 3.611) aus der Inanspruchnahme eingeräumter Kreditlinien sowie in Höhe von TEUR 3.613 (2005: TEUR 10.653) aus langfristigen Darlehensverträgen zusammen.

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

TEUR	2006	2005
Kreditlinie	16.638	5.158
Inanspruchnahme	1.276	3.611
Verfügbare Kreditlinie	15.362	1.547

Der Anstieg der Kreditlinie im Geschäftsjahr resultiert aus einer Inlandskreditlinie in Höhe von TEUR 12.000, die von einem Bankenkonsortium bereitgestellt wurde. Die Linie ist mit der Verpfändung von Umlaufvermögen der betroffenen Inlandsgesellschaften verbunden. Zum Bilanzstichtag ist diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 4,55 % (2005: 3,83 %).

Der zum Vorjahresstichtag von der IBM Deutschland Kreditbank GmbH im Rahmen eines Darlehensvertrags zur Verfügung gestellte Darlehensbetrag in Höhe von TEUR 2.500 wurde im Geschäftsjahr vollständig zurückgeführt. Die Darlehensmittel dienten zur Finanzierung der Entwicklung einer Produktionsmaschine gemäß Joint Development Agreement mit der IBM Corporation, USA. Es wurde ein variabler Zinssatz in Höhe des Ein-Monats-Euribors zuzüglich eines risikoadäquaten Aufschlages vereinbart. Die Effektivverzinsung im Geschäftsjahr lag bei 7,79 % p.a. (2005: 7,75 % p.a.).

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

Konzerngesellschaft	2006	2005	Zinssatz	Fälligkeit
SUSS MicroTec Test Systems GmbH	953	2.542	3,25 %	30.9.2009
SUSS MicroTec Lithography GmbH	814	2.556	3,75 %	30.9.2009
SUSS MicroTec Lithography GmbH	0	441	3,75 %	30.12.2008
Image Technology Inc.	107	474	9,81 %	11.4.2007
Image Technology Inc.	25	134	8,75 %	11.4.2007
Image Technology Inc.	82	436	8,75 %	11.4.2007
Image Technology Inc.	332	0	9,27 %	26.3.2011
SÜSS MicroTec AG	0	2.516	variabel	30.6.2006
SUSS MicroTec S.A.S.	437	487	4,21 %	11.3.2014
SUSS MicroTec S.A.S.	48	112	4,11 %	20.7.2007
SUSS MicroTec S.A.S.	399	454	4,29 %	11.3.2014
SUSS MicroTec S.A.S.	399	454	4,42 %	11.3.2014
Sonstige Darlehen < 1 Mio EUR	17	47		
Gesamt	3.613	10.653		
...davon kurzfristig fällig	1.584	5.503		
...davon langfristig fällig	2.029	5.150		
... fällig in 2007	1.584			
2008	927			
2009	247			
2010	258			
2011	196			
...später	401			
	3.613			

Alle Angaben in TEUR

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Nach der am 30. April 2006 geleisteten Rückzahlung in Höhe von TEUR 3.622 beläuft sich der offene Gesamtbetrag der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe zum Bilanzstichtag noch auf TEUR 335 und entfällt in voller Höhe auf die Optionsanleihe.

Die Optionsanleihe wird mit 6 % p.a. verzinst und ist – vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien – am 31. Oktober 2008 rückzahlbar. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt EUR 10,0561. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von EUR 9,0561 je Aktie. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die Ausübung von 33 1/3 % der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135 % über dem Bezugspreis liegt. Die komplette Ausübung des Bezugsrechte kann ab 4. November 2004 verlangt werden, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200 % über dem Bezugspreis liegt.

Die Verzinsung der getilgten Wandelanleihe betrug im Geschäftsjahr ebenfalls 6 % p.a.

Der Bilanzausweis der Wandel- und Optionsanleihe erfolgt nach Verrechnung mit den über die Laufzeit der Anleihe zu amortisierenden Ausgabekosten.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, Technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrundeliegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden. Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

TEUR	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehenden Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 2006	206	2.533	1.663
Abschreibungen / Aufwendungen 2005	470	2.640	1.630
Künftige Verpflichtungen ...fällig in 2007	269	2.424	1.815
2008	241	2.158	1.768
2009	97	720	638
2010	1	347	339
2011	0	343	339
...später	0	339	339
Gesamt zukünftig	608	6.331	5.238
Zinsanteil	39		
Verbindlichkeit 31.12.2006	569		
... davon kurzfristig	256		
... davon langfristig	313		

(27) Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

TEUR	2006	2005
Darlehen von Mitarbeitern	46	96
Sonstiges	149	149
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	195	245

(28) Sonstige kurzfristige Rückstellungen

Die sonstigen kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Garantierückstellungen	1.694	1.350
Abfindungen	456	435
Übrige Rückstellungen	2.880	2.183
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	5.030	3.968

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die sonstigen kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

TEUR	Stand 01.01.2006	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2006
Garantierückstellungen	1.350	-1.247	-103	1.694	1.694
Abfindungen	435	-328	-84	433	456
Übrige Rückstellungen	2.183	-521	-230	1.448	2.880
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.968	-2.096	-417	3.575	5.030

(29) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Steuerverbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

TEUR	2006	2005
Erhaltene Anzahlungen	20.981	25.009
Abgegrenzte Personalkosten	5.563	5.730
Prämien und Provisionen	1.447	1.220
Fremdleistungen	1.195	2.572
Umsatzsteuer	427	206
Passive Rechnungsabgrenzung	275	604
Aufsichtsratsvergütung	164	55
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	16	536
Abgegrenzte Fördermittel	0	127
Sonstiges	363	42
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	30.431	36.101

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände, Gleitzeitguthaben, Erfolgsbeteiligungen sowie für Tantiemen enthalten.

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von TEUR 1.226 (2005: TEUR 60) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von TEUR 112 (2005: TEUR 334).

Sonstige Angaben

(30) Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommenen wirtschaftlichen Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

Originäre Finanzinstrumente

Die geschätzten Marktwerte der originären Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde.

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Flüssige Mittel: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Finanzverbindlichkeiten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt. Bei variabel verzinsten Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte annähernd ihren Marktwerten, da die Zinssätze auf variablen Zinsen basieren, die sich an den Marktsätzen orientieren.

Wandel- und Optionsanleihe: Zur Ermittlung des Marktwerts der auf Basis der Wandel- und Optionsanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden würde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Wandelanleihe berücksichtigt. Ebenso wurden Annahmen für das aktuelle Rating des Konzerns getroffen.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Marktwerte der originären Finanzinstrumente sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:

TEUR	2006		2005	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.889	3.593	14.264	13.911
Verbindlichkeiten aus Anleihen	335	412	3.830	4.116
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	569	560	695	688

Für sonstige originäre Finanzinstrumente entsprechen die Zeitwerte den zu den jeweiligen Stichtagen bilanzierten Buchwerten.

Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen. Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des USD und des YEN, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem EURO-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt, ihr Ansatz erfolgt zu Marktwerten gemäß den Bankenmitteilungen.

Zum 31. Dezember 2006 und 2005 bestanden folgende Devisentermingeschäfte:

	2006		2005	
	Nominalvolumen	Marktwert in TEUR	Nominalvolumen	Marktwert in TEUR
Verkauf von US-Dollar (in TUSD)	13.200	260	13.730	-534
...davon bis zu einem Jahr	13.200	260	13.730	-534
Verkauf von Yen (in Mio JPY)	364,0	94	272,3	90
...davon bis zu einem Jahr	364,0	94	272,3	90
Kauf von US-Dollar (in TUSD)	500	0	2.000	15
...davon bis zu einem Jahr	500	0	2.000	15

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen ermittelt. Zum jeweiligen Bilanzstichtag wurden die Devisentermingeschäfte mit ihren Marktwerten bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die dargestellten Kontraktwerte stellen die Summe der zum jeweiligen Bilanzstichtag bestehenden Verpflichtungen dar. Die potentiellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

(31) Nahe stehende Personen

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der Konzern wird im Geschäftsjahr 2006 von den Angabepflichten nach IAS 24 in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG und deren nahen Familienangehörigen berührt.

SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains

Verschiedene Konzerngesellschaften (SÜSS MicroTec Lithography GmbH, SÜSS MicroTec Test Systems GmbH, SÜSS MicroTec Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR oder der Grundstücksgesellschaft Hungar Mountains, USA. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Verträgen ergebenden zukünftigen Mindestleasingraten sind unter Textziffer (26) dargestellt.

TEUR	2006	2005
Mietaufwendungen	1.663	1.630

Familie Süß

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süß dar. Die Pensionsansprüche sind unter Textziffer (24) dargestellt.

TEUR	2006	2005
Gehälter und Pensionen	404	330

CMS Hasche Sigle

Das Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Schücking ist Gesellschafter der Rechtsanwaltssozietät CMS Hasche Sigle. Die Gruppe nimmt Rechtsberatung von dieser Sozietät in Anspruch.

TEUR	2006	2005
Beratungsaufwendungen	23	74

Hinsichtlich der Vergütungen an den Aufsichtsrat und den Vorstand verweisen wir auf Textziffer (35).

(32) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Bestellobligo	17.705	13.465
Mietverpflichtungen	5.619	7.277
Sonstiges	59	160
Summe	23.383	20.902

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Verpflichtungen aus Mietverträgen beinhalten in Höhe von TEUR 5.238 (2005: TEUR 5.515) Verpflichtungen gegenüber nahe stehenden Unternehmen bzw. Personen.

Die Gesellschaft ist im Mai 2004 im Zusammenhang mit der Einbringung von Geschäftsanteilen in die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2000 vom Rechtsbeistand der einbringenden Partei darauf hingewiesen worden, bei der steuerlichen Behandlung der Einbringung eine angeblich im Zusammenhang mit dem Einbringungsvertrag geschlossene Abrede nicht beachtet zu haben. Gegenwärtig ist nicht abzusehen, ob es in dieser Angelegenheit zu einer streitigen Auseinandersetzung kommt. Der Vorstand, der sich auf die Angaben seines Rechtsbeistandes stützt, sieht die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage der Gegenpartei eher gering und hat daher keine Rückstellung für ein mögliches Prozessrisiko gebildet.

(33) Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cash Flow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Teil von TEUR 200 (2005: TEUR 1.907) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für Finanztermingeschäfte bei Banken.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von TEUR 2.400 (2005: TEUR -1.835) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte aus Fremdwährungsdarlehen, die von der SÜSS MicroTec AG ausgereicht wurden. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist auf den deutlich schwächeren Dollarkurs zum Bilanzstichtag zurückzuführen.

(34) Segmentberichterstattung

Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IAS 14 („Segment Reporting“) nach Produktlinien als primärem Berichtsformat und nach Regionen als sekundärem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder, Device Bonder und Test Systeme aufgeteilt. Zudem werden im Segment Sonstige weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansässig. Insbesondere der sogenannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wesentliches Standbein dieses Segments dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6 und 8 Zoll Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment Device Bonder befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb der Produktlinie Device Bonder. Die Segmentaktivitäten sind in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Aufgrund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes sind keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Das Segment Test Systeme ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z. B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. Infolge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Im Geschäftsjahr 2006 wurden von der SÜSS MicroTec AG TEUR 2.732 (2005: TEUR 2.814) an das Segment Lithografie, TEUR 806 (2005: TEUR 685) an das Segment Substrat Bonder, TEUR 333 (2005: TEUR 377) an das Segment Device Bonder und TEUR 1.194 (2005: TEUR 1.272) an das Segment Test Systeme weiterbelastet.

Die dargestellte Ergebnisgröße stellt den jeweiligen Ergebnisbeitrag der Segmente dar. Das Segmentergebnis entspricht dabei dem Ergebnis vor Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung und aus Anlagenabgängen vor Zinserträgen und Zinsaufwendungen sowie vor Ertragsteuern.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Wertminderungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Wertminderungen des Vorjahres enthalten insgesamt außerplanmäßige Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von TEUR 1.839. Sie sind vollständig dem Segment Device Bonder zuzuordnen.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standorts der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

(35) Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstands der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2006 waren:

Herr **Dr. Stefan Schneidewind**, Dipl.-Ingenieur, Moritzburg/OT Reichenberg, Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche: Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Materialwirtschaft und Logistik, Produktion und Facility Management, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz, Vertrieb und Marketing, Konzernstrategie

Herr **Stephan Schulak**, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach, Mitglied des Vorstands

Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Investor Relations, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal

Die Bezüge des Vorstands enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr TEUR 1.161. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak insgesamt TEUR 82 bzw. TEUR 65 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt.

Herr Schulak wird mit Wirkung vom 31. März 2007 sein Amt als Vorstandsmitglied der Gesellschaft niederlegen. Im Rahmen seines Ausscheidens wurde mit Herrn Schulak eine Abfindung in Höhe von insgesamt TEUR 483 vereinbart, welche im Fixum für 2006 enthalten ist. Hiervon wurde die Hälfte bereits im Berichtsjahr ausgezahlt. Für die andere Hälfte, die mit Ausscheiden zur Auszahlung fällig wird, wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet.

Für Herrn Dr. Schneidewind hat die Gesellschaft zusätzlich Kosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung in Höhe von TEUR 12 getragen.

Für den Jahresbonus 2006 von Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von TEUR 158 gebildet.

Zudem wurden an Herrn Dr. Schneidewind und Herrn Schulak 2006 jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Der Marktwert pro Option betrug bei Ausgabe EUR 2,9513. Im Rahmen der im Dezember 2006 getroffenen Aufhebungsvereinbarung hat Herr Schulak auf die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr erhaltenen Optionen mit sofortiger Wirkung verzichtet.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

TEUR	2006		2005	
	Dr. Stefan Schneidewind	Stephan Schulak	Dr. Stefan Schneidewind	Stephan Schulak
Barvergütung				
Fixum	285	717	288	234
Erfolgsbezogen	92	67	83	67
Summe	377	784	371	301
Aktioptionen				
Anzahl	40.000	0	40.000	0
Ausübungspreis	7,53	n/a	4,95	n/a

Weiterhin wurden aufgrund der 2004, 2005 und 2006 an Vorstände gewährten Optionen TEUR 85 als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von TEUR 5 (2005: TEUR 6).

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2006:

Dr. Winfried Süß, München, Aufsichtsratsvorsitzender

Thomas Schlytter-Henrichsen, Kronberg/Taunus, Geschäftsführer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
(bis 20. Juni 2006)

Gerhard Rauter, Dresden, Geschäftsführer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender (ab 20. Juni 2006)

Dr. h. c. Horst Görtz, Neu-Anspach, Kaufmann

Peter Heinz, Waterbury, Vermont, USA, Diplom-Kaufmann

weitere Mandate: H&H Associates Inc., Waterbury, Vermont, USA (Mitglied im Aufsichtsrat)

Prof. Dr. Anton Heuberger, München, Professor an der TU CAU Kiel

weitere Mandate: IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)

Sensor Dynamics, Graz, Österreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

Dr. Christoph Schücking, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar

weitere Mandate: Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M.

(stellvertretender Vorsitzender im Gesellschafterausschuss)

Kennametal GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Kennametal Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)

Freudenberg & Co., Weinheim/Bergstraße (Mitglied im Gesellschafterausschuss)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung in Höhe von EUR 15.000 pro Geschäftsjahr. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den dreifachen Betrag, sein Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

2006 (Angaben in EUR)	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	Gesamt
Dr. Winfried Süß	ganzjährig	45.000,00	10.500,00	9.344,29	64.844,29
Thomas Schlytter-Henrichsen	bis 20.6.2006	11.250,00	3.000,00	3.109,32	17.359,32
Gerhard Rauter	ab 20.6.2006	11.250,00	6.000,00	961,37	18.211,37
Dr. h.c. Horst Görtz	ganzjährig	15.000,00	10.500,00	7.614,62	33.114,62
Peter Heinz	ganzjährig	15.000,00	7.500,00	3.759,00	26.259,00
Prof. Dr. Anton Heuberger	ganzjährig	15.000,00	7.500,00	6.071,96	28.571,96
Dr. Christoph Schücking	ganzjährig	15.000,00	7.500,00	4.027,82	26.527,82

Im Vorjahr haben die Aufsichtsratsmitglieder aufgrund der wirtschaftlichen Situation der SÜSS MicroTec AG auf die Sitzungsgelder sowie auf die in der Hauptversammlung 2002 beschlossene Erhöhung der Vergütung verzichtet. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Süß, hat in voller Höhe auf seine Vergütung verzichtet, so dass sich folgende Vergütungssituation ergab:

2005 (Angaben in EUR)	Zeitraum der Zugehörigkeit	Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	Gesamt
Dr. Winfried Süß	ganzjährig	--	--	1.052,37	1.052,37
Thomas Schlytter-Henrichsen	ganzjährig	11.504,06	--	1.915,88	13.419,94
Dr. h.c. Horst Görtz	ganzjährig	7.669,37	--	2.680,43	10.349,80
Peter Heinz	ab 21.6.2005	3.834,69	--	7.804,89	11.639,58
Prof. Dr. Anton Heuberger	ganzjährig	7.669,37	--	3.541,05	11.210,42
Dr. Christoph Schücking	ganzjährig	7.669,37	--	1.744,78	9.414,15
Dr. Thomas Sesselmann	bis 21.6.2005	3.834,69	--	-64,45	3.770,24

Aus seiner Zeit als Geschäftsführer der heutigen SUSS MicroTec Lithography GmbH besteht für Herrn Dr. Süß, den Aufsichtsratsvorsitzenden, zum Bilanzstichtag eine Pensionsrückstellung in Höhe von TEUR 2.126 (2005: TEUR 2.243).

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende

	2006		2005	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind	13.278	80.000	6.571	69.648
Stephan Schulak	25.000	0	13.000	80.286
Dr. Winfried Süß	1.131.000	0	1.131.000	0
Thomas Schlytter-Henrichsen (bis 20.6.2006)	--	--	6.909	0
Gerhard Rauter (ab 20.6.2006)	0	0	--	--
Dr. h.c. Horst Görtz	17.216	0	3.894	0
Peter Heinz	1.338	0	1.338	0
Dr. Christoph Schücking	500	0	500	0
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	0	0	0

(36) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 724 Mitarbeiter (2005: 684 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2006	2005
Verwaltung	99	92
Marketing und Vertrieb	278	250
Produktion und Technik	383	332
Summe	760	674

In den At-equity bewerteten Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter 0 (2005: 0 Mitarbeiter) tätig.

(37) Honorare des Abschlussprüfers

Der im Geschäftsjahr 2006 für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honoraraufwand nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB beträgt TEUR 329 (2005: TEUR 456) und setzt sich wie folgt zusammen:

TEUR	2006	2005
Abschlussprüfung	243	359
Steuerberatung	86	52
Sonstige Leistungen	0	45
Gesamt	329	456

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften.

In der Position Steuerberatung ist das Honorar für die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen enthalten.

(38) Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 12. Juni 2006) im Dezember 2006 abgegeben und im Internet unter www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

(39) Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der SÜSS MicroTec AG keine Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht.

Am 5. März 2007 hat Global Opportunities Capital Asset Management N.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Capital Asset Management N.V., Amsterdam, an der SÜSS MicroTec AG die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,91 % beträgt.

Ebenfalls am 5. März 2007 hat das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA an der SÜSS MicroTec AG am 27. Februar 2007 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und 4,30 % beträgt.

(40) Freigabe des Abschlusses

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 16. März 2007

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Stephan Schulak

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der Süss MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 19. März 2007

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schumacher
Wirtschaftsprüfer

Querfurth
Wirtschaftsprüfer

Glossar

300mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (mehr als 90 %) der heute verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 200 Millimeter. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können (und je mehr Chips auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip). Aktuell vollzieht sich der Übergang von 200 mm zu 300 mm Durchmesser der Wafer. Dies erfordert eine Anpassung der Herstellungs- und Prozesstechnologien in der Halbleitertechnik.

Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Bei neueren Chipdesigns ist die Zahl der Anschlusskontakte pro Chip inzwischen auf über 1.000 angestiegen. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im so genannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

Atom

Kleinstes stabiles Element, das in der Natur vorkommt. Je nach Größe und Eigenschaft werden Atome in verschiedenen Elementen geordnet (Periodensystem der Elemente).

Backend

Zweiter (hinterer) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen durchführen lassen (Packaging Foundries).

Biochip

Kleiner Chip aus Silizium, Glas, Kunststoff oder Papier, der in zahlreiche Mikrostrukturen unterteilt ist, auf denen sich spezielle Sonden aus biologisch aktiven Molekülen befinden.

Bluetooth

Technologie zur drahtlosen Übermittlung von Sprache und Daten über kurze Distanzen durch kurze Radiowellen. Wird überwiegend zur drahtlosen Kommunikation von verschiedenen elektronischen Geräten untereinander eingesetzt, z.B. Mobiltelefon mit Kopfhörer oder PC mit Drucker etc.

Bonden

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafers mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z.B. „adhesives Bonden“ bedeutet das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist), „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Bei einem anschließenden Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

Bump

(Engl.: Unebenheit); Metallische (Lot, Gold o.Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugelnchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlusskontakte, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen, die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafers beschickt wird.

Compound Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

Cost of Ownership (CoO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders in Rahmen von Massenproduktionen von größter Bedeutung.

C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ bedeutet Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation des bewährten C4-Prozesses. „NP“ steht dabei für New Process.

Die

„Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse eingebaut wurden. Sie entstehen auf dem Wafer, indem der Die die vielen Prozessschritte durchläuft. Die Dies befinden sich also während des gesamten Fertigungsprozesses auf dem Wafer. Erst wenn sie fertig sind, wird der Wafer in die einzelnen ICs zerschnitten und diese werden dann in die Gehäuse gesetzt. Diese gehäuseten Dies werden dann oft Chips genannt. „Die“, „IC“ und „Chip“ werden oft synonym verwendet.

DRAM

Dynamic Random Access Memory. Weltweit verbreitetster Speicherchip.

Fab

Fabriken, in denen ICs auf Wafers produziert werden. Die Errichtung einer großen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden Dollar.

Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h., der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

Fotoresist

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese veränderten Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

Foundry

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für Vertrieb und Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

Frontend

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Hier werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

GaAs

Galliumarsenid; Halbleiterwerkstoff, der für die Herstellung von Mikrochips für optoelektronische und Hochfrequenz-Anwendungen verwendet wird. Aufgrund der gegenüber Silizium höheren Elektronenmobilität ermöglicht dieser Werkstoff die Realisierung schnellerer Mikrochips und damit leistungsstärkerer Geräte.

Halbleiter

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher integrierter Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

LCD-TFT

LCD (Liquid Crystal Display). TFT (Thin-Film Transistor).
 LCDs sind Flüssigkristalldisplays, bestehend aus zwei Glasplatten mit stromführenden Leiterbahnen. Das Flüssigkristall zwischen den Platten lässt normales Licht durch. Wird ein elektrisches Feld in den Glasplatten erzeugt, lassen die Kristalle an dieser Stelle kein Licht mehr durch, es entsteht ein schwarzer Punkt. TFT ist eine spezielle Technologie der elektrischen Ansteuerung der LCDs. Hier ist – anders als bei den alternativen „Passiv Matrix LCD“ – jeder einzelne Bildpunkt (Pixel) über einen Transistor ansteuerbar. Diese sog. aktive Matrix ermöglicht eine bessere Bildqualität als die Passiv Matrix LCDs.

LED

Light Emitting Diode; Leuchtdiode. LEDs sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmal so große Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.

Lithografie

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Silizium-Wafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske entsprechen den Strukturen, die in diesem Schritt auf die ICs gebracht werden sollen. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet, an lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Die Belichtung des Fotoresist führt zu einer chemischen Veränderung, die ein Auflösen des Fotoresist in einem Entwicklungsbad erlaubt. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in der Größenordnung von 0,13 bis 0,6 Mikrometer. Im Backend, beim Advanced Packaging, werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis zu einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z.B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs gebraucht werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise. Die Maske wird dann beim Lithografie-Schritt eingesetzt, um bestimmte Bereiche zu belichten und so die zu ätzenden Bereiche zu definieren.

MEMS

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektrische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

Mikrometer/Mikron

Metrisches Längenmaß. Symbol: μm . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 μm .

Mikrosystem

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

Mikrosystemtechnik (MST, MEMS, MOEMS)

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z.B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

Molekül

Mehrere Atome können sich zu einem Molekül verbinden und dadurch völlig andere Eigenschaften annehmen.

Nanoimprinting

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

Nanotechnologie

(Griech.: *nānos* = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometer-Bereich zu schaffen.

Optoelektronik

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit so genannten III/V-Materialien wie z.B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

Packaging Foundries

Siehe Backend.

PDA

Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch.

Plasma(behandlung)

Ein Plasma ist ein Gas, in dem Atome, Ionen und freie Elektronen gleichzeitig nebeneinander existieren. Durch elektrische Felder können Elektronen und Ionen beschleunigt werden und beim Auftreffen auf eine Oberfläche Veränderungen bewirken. Darüber hinaus können Plasmen Strahlung erzeugen, die, je nach Wellenlänge, zur Strahlungsbehandlung von Materialien eingesetzt werden kann.

Sensor

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

Silizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

Systems-on-Chip

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturweiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem

Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht Systems-on-Chips immer größere Wichtigkeit.

Tool

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

Verbindungshalbleiter

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

Wafer

Runde Scheiben aus Reinst-Silizium, auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 Millimeter vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

Wire-Bonding

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

Wireless LAN (W-LAN)

Direkt in Deutsch übersetzt bedeutet der Begriff „Kabelloses lokales Netzwerk“. Damit wird Bezug genommen auf die in jedem Bürogebäude vorhandenen Computernetzwerke. Beim Wireless LAN werden die Kabel durch eine Technik ähnlich des Handynetzes ersetzt.

Yield

Die Ausbeute – ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

Finanzkalender 2007

30. März	Jahresabschluss 2006
03. Mai	Quartalsbericht 2007
04. Mai	DVFA-Analystenkonferenz, Frankfurt am Main
06. Juli	Hauptversammlung
07. August	Halbjahresbericht 2007
06. November	Neunmonatsbericht 2007

Impressum

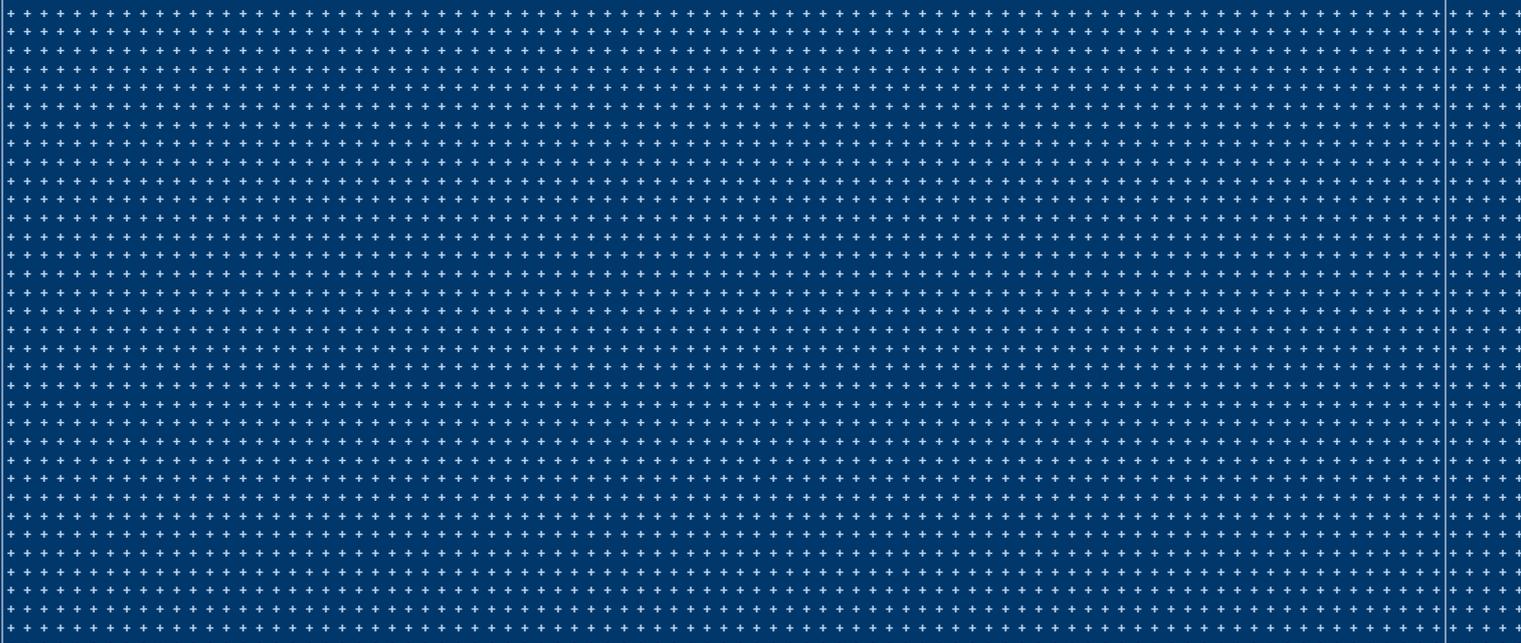
Herausgeber: SÜSS MicroTec AG
Redaktion: Investor Relations, Group Accounting & Financial Reporting
Wirtschaftsprüfer: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung: IR-One AG & Co., Hamburg
Druck: Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

Kontakt

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Fon: +49 (0)89-32007-0
E-mail: info@suss.de

Investor Relations
Fon: +49 (0)89-32007-454
E-mail: ir@suss.de

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.



SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Fon: +49 (0)89-32007-0
E-mail: info@suss.de

www.suss.com